

股票代號：3374

精材科技股份有限公司

Xintec Inc.

民國一一二年度年報

中 華 民 國 一 一 三 年 四 月 一 日 刊 印

台灣證券交易所公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

精材公司年報網址：<http://www.xintec.com.tw>

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人

姓名：林恕敏

職稱：副總經理

電話：(03) 433-1818

電子郵件信箱：invest@xintec.com.tw

代理發言人

姓名：馬中文

職稱：協理

電話：(03) 433-1818

電子郵件信箱：invest@xintec.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

1. 總公司：

桃園市中壢區吉林路 23 號 9 樓

電話：(03) 433-1818

2. 工廠：

Line-A：桃園市中壢區吉林路 25 號 電話：(03) 433-1818

Line-B：桃園市中壢區自強二路 1 號 電話：(03) 433-1818

Line-C：桃園市中壢區中園路 188 號 電話：(03) 433-1818

三、辦理股票過戶機構：

名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市建國北路一段 96 號地下一樓

網址：<https://www.tssco.com.tw/>

電話：(02) 2504-8125

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：蔡美貞、黃裕峰

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市松仁路 100 號 20 樓

網址：<http://www2.deloitte.com/tw>

電話：(02) 2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所：無。

六、公司網址：<http://www.xintec.com.tw>

## 目錄

	<u>頁次</u>
壹、致股東報告書.....	1
貳、公司簡介	
一、設立日期.....	3
二、公司沿革.....	3
參、公司治理報告	
一、組織系統.....	5
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	7
三、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	14
四、公司治理運作情形.....	18
五、會計師公費資訊.....	46
六、更換會計師資訊.....	47
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會 計師所屬事務所或其關係企業之期間.....	48
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之 十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	48
九、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊.....	49
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	49
肆、募資情形	
一、股本來源.....	50
二、股東結構.....	52
三、股權分散情形.....	53
四、主要股東名單.....	53
五、最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料.....	54
六、公司股利政策及執行狀況.....	54
七、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響.....	55
八、員工分紅及董事、監察人酬勞.....	55
九、公司買回本公司股份情形.....	55
十、公司債、特別股、海外存託憑證及併購之辦理情形.....	55
十一、員工認股權憑證辦理情形.....	55
十二、限制員工權利新股.....	55
十三、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	55
十四、資金運用計畫執行情形.....	55

伍、營運概況	
一、業務內容	56
二、市場及產銷概況	62
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均 年齡及學歷分布比率	74
四、環保支出資訊	74
五、勞資關係	75
六、資通安全管理	76
七、重要契約	79
陸、財務概況	
一、最近五年度簡明資產負債表、綜合損益表及會計師姓名及其查核意見	80
二、最近五年度財務分析	83
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告	85
四、最近年度財務報告	86
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告	137
六、最近年度及截至年報刊印日止本公司及關係企業之財務週轉情形	137
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況	138
二、財務績效	139
三、現金流量	140
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	140
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計 畫	140
六、風險事項	141
七、其他重要事項	143
捌、特別記載事項	
一、關係企業相關資料	144
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	144
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形	144
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第二項第二款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項	144
五、其他必要補充說明事項	144

# 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

民國 112 年在歷經新冠疫情期間的過度消費與供應鏈超額庫存後，全球電子產品銷售不佳。於此同時又有國際地緣政治紛爭與高通膨等因素，導致成本上升且抑制消費者購買意願。公司除 12 吋晶圓測試小幅成長，在 3D 感測零組件及車用影像感測器封裝營收皆下滑，整體獲利表現低於前一年度。

## 經營實績

精材公司 112 年全年營收為新台幣 63.9 億元，較前一年營收減少 17.4%。淨利為新台幣 13.8 億元，較前一年度大幅減少 30.6%。每股淨利為新台幣 5.07 元。財務收支及獲利能力分析如下：

單位:新台幣佰萬元

分析項目		112年度	111年度	增減比率	
財務 收支	營業收入	6,387	7,732	-17.4%	
	營業毛利	2,179	2,867	-24.0%	
	稅後淨利	1,376	1,984	-30.6%	
獲利 能力	資產報酬率(%)	14.16%	22.53%	-8.4%	
	股東權益報酬率(%)	17.93%	29.16%	-11.2%	
	占實收資本比率(%)	營業利益	62.83%	90.61%	-27.8%
		稅前利益	64.51%	92.16%	-27.7%
	純益率(%)	21.54%	25.66%	-4.1%	
稅後基本每股盈餘(元)	5.07	7.31	-30.6%		

## 技術與創新

112 年度起，公司研發能量與投資主要聚焦在 12 吋所需的先進技術。利用高深寬比的銅穿孔(Cu-TSV)製程平台，除了提供影像感測器晶圓級封裝之外，也發展可供一般晶圓級的超薄封裝應用。而其他已經開發完成的 8 吋各項特殊封裝技術，亦逐步應用至更多的客戶產品上，例如行動裝置用之薄化玻璃微型感測器、微機電晶圓級封裝、超薄玻璃精密加工服務等。

著眼未來微型化與多晶粒整合趨勢所需，精材正積極發展 SiP 晶圓級封裝(System in WL CSP)所需的各項關鍵技術，如覆晶接合(Flip chip bonding)、銅柱精細凸塊(Cu pillar)、晶粒與晶圓對接(Chip to wafer bonding)、晶圓模封(Molding)等。113 年將持續建構所需的各項設備，並加速製程整合開發。

## 企業治理與社會責任

公司自 109 年即設立公司治理主管，逐步強化實務面執行與管理。於 110 年導入 ESG，從環境保護、社會責任與公司治理三大面向提出具體的計畫及績效目標。112 年董事會通過成立 ESG 指導委員會，指導與監督公司 ESG 工作開展。

因應氣候變遷，確保地球環境永續發展，公司於 112 年已購買每年約 180 萬度的再生能源，規劃 114 年將再增購約 100 萬度，並逐年增加。去年執行減碳計畫超過 3 萬噸，並通過 ISO50001 能源管理系統認證，今年預估可再減少碳排放 1.5 萬噸。在降低水資源消耗部分，公司持續提升製程用水效能及擴充廢水回收再利用系統，去年減少自來水用水超過 11 萬噸，有效降低季節性缺水對營運的影響。

舉辦廠區愛心義賣、募集物資及善款捐助弱勢團體，已是精材同仁熱心參與公益的日常，去年金額超過新台幣 120 萬元。

公司持續建構尊重人權、多元、平等、包容、安全與環保的工作環境，連續第 4 年達成零災害工時。去年已通過責任商業聯盟(RBA)的稽核認證，並榮獲 SGS 環境管理制度典範獎。

精材在 ESG 方面的努力，去年榮獲第 4 屆國家企業環保銅級獎、桃園市金牌企業卓越獎 - 性平獎、愛地球獎，分別接受了總統及市長的表揚。

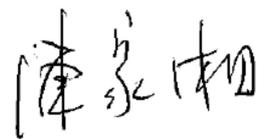
## 前景與展望

精材過去著重在 8 吋 CIS 晶圓級封裝與微機電元件技術的發展。去年進行 12 吋 Cu-TSV 製程開發，首個車用 CIS CSP 專案已順利量產。113 年起會積極爭取客戶新專案導入，盡快擴大業務規模貢獻效益。公司持續努力為客戶提供更輕薄短小的封裝方案，SiP 晶圓級封裝(System in WL CSP)的開發即是我們要邁向的下一個里程碑。

新廠房(LineC-P2)預計於今年底完工，第 1 季董事會已通過資本支出約新台幣 25 億，用於興建無塵室及廠務、IT 等設施，預計 114 年開始根據業務規劃加入營運。

展望 113 年，全球電子業景氣稍有復甦，不過依然有高度不確定性，營運方面必須審慎以對。為強化公司的競爭力，符合客戶及市場所需，先進封裝技術建構與研發的投資必須加速，及時開拓新的成長契機。最後，感謝各位股東長期對精材科技的支持與信任。

董事長暨總經理 陳家湘



## 貳、公司簡介

一、設立日期：中華民國 87 年 9 月 11 日

二、公司沿革：

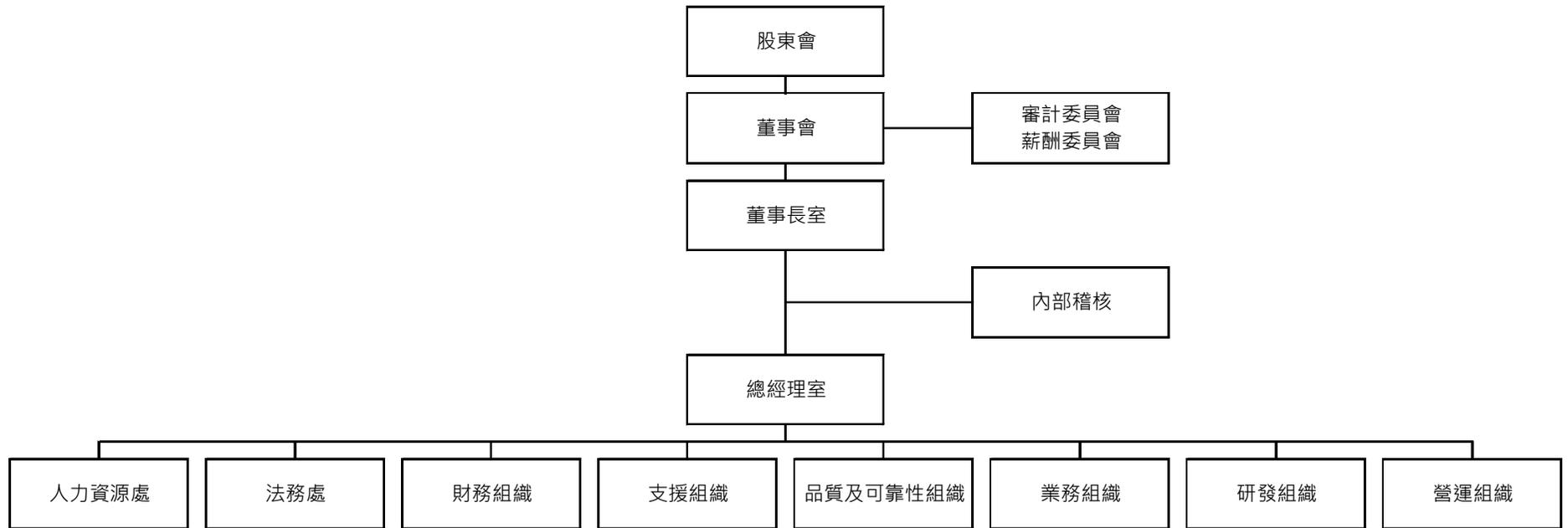
年度 / 月份	重 要 紀 事
87/09	精材科技股份有限公司成立，實收資本額新台幣 280,000 仟元。
89/05	與 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. (原以色列商雪兒凱斯 ShellCase Ltd.) 簽定技術授權合約，引進晶圓級封裝技術，並開始從事積體電路封裝業務。
89/10	獲准進駐桃園縣中壢工業區設廠。
90/10	開始進入試產、量產階段。
91/03	通過 ISO9000 品質驗證。
92/02	通過 QS9000 品質驗證。
92/12	經向證期會申報生效後，為股票公開發行公司。
93/07	獲准成立保稅工廠。
93/09	經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准登錄為興櫃股票。
94/01	通過 ISO14001 環境管理系統驗證。
94/12	通過 TL9000 品質管理系統驗證。
94/12	英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company 持有本公司股份 30% 成為最大股東。
94/12	中壢 Line-A 廠的 8 吋 CSP 月產能達 10,000 片。
95/09	中壢 Line-A 廠的 8 吋 CSP 月產能達 20,000 片。
95/12	取得中壢 Line-B 廠。
96/01	辦理私募現金增資，策略性引進台灣積體電路製造股份有限公司投資持有本公司股份 43% 成為最大股東。
96/09	8 吋 CSP 月產能達 40,000 片。
96/12	通過 OHSAS18001 職業健康安全管理系統驗證。
96/12	新竹廠 12 吋月產能達 2,000 片。
98/01	通過 TOSHMS 台灣職業安全衛生管理系統驗證。
99/11	中壢廠 Line-A 榮獲勞委會勞安衛管理單位績效認證。
99/12	通過 ISO/TS16949 品質管理系統驗證。
100/02	取得中壢 Line-C 廠。
100/03	中壢廠 Line-B 榮獲勞委會勞安衛管理單位績效認證。
100/06	車規 CSP 圖像感測器量產。
100/07	撤銷新竹分公司並將新竹廠辦遷回中壢廠。
101/07	中壢廠區通過 GHG 溫室氣體排放盤查及外部認證機構的查證。
101/09	中壢廠區通過重要產品的碳足跡盤查及外部認證機構的查證。
102/08	建置 8 吋生物辨識感測器產能。

104/03	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准掛牌上櫃。
106/04	榮獲第三屆「公司治理評鑑」上櫃組排名前 5% 公司。
107/04	榮獲第四屆「公司治理評鑑」上櫃組排名前 5% 公司。
107/08	通過 ISO/IATF16949 品質管理系統認證。
108/04	榮獲第五屆「公司治理評鑑」上櫃組排名前 5% 公司。
108/08	榮獲「108 年統一發票績優營業人獎」。
108/11	通過 ISO45001/TOSHMS 職業安全衛生管理系統改版驗證。
109/05	榮獲第六屆「公司治理評鑑」上櫃組排名前 5% 公司。
109/06	取得無災害工時紀錄證明。
109/06	建置 12 吋高階晶圓測試產能。
109/08	獲得 SGS ISO45001 Plus Awards。
110/05	榮獲第七屆「公司治理評鑑」上櫃組排名前 5% 公司。
110/11	中壢 Line-C 廠通過勞動部職安衛管理系統績效審查。
111/05	榮獲第八屆「公司治理評鑑」上櫃組排名前 5% 公司。
111/11	中壢 Line-C 廠榮獲第四屆國家企業環保銅級獎
112/07	中壢 Line-B 廠通過勞動部職安衛管理系統績效審查。
112/11	獲得 SGS ISO14001 Plus Awards。
112/11	中壢 Line-C 廠榮獲第五屆國家企業環保銅級獎。
112/11	榮獲桃園市金牌企業卓越獎 - 性平獎、愛地球獎。

## 參、 公司治理報告

### 一、組織系統

#### (一) 組織結構



(二) 主要部門所營業務：

內部稽核：協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及做為檢討修正內部控制制度之依據。

人力資源處：人力規劃、招募任用、薪酬管理、訓練發展、員工服務及員工關係。

法務處：智權法律事務處理及智權授權談判處理、合約審閱談判管理、公司法律事務處理、法律爭議或訴訟處理。

財務組織：財務及會計帳務服務、稅務管理、投資管理、財務規劃、資金調度及年度成效評估。

支援組織：擬訂物料需求計劃、採購業務管理、進出口及倉儲管理、工廠產能及規劃。規劃、發展及維護企業所需之資訊基礎建設、通訊與後勤資訊系統、營運相關支援系統，並制定公司資訊安全相關政策以確保落實資訊安全。

品質及可靠性組織：品質與可靠性管理。

業務組織：業務發展、客戶協商、訂價指導方針提案與核決、業務支援、生產計劃及管制。

研發組織：專案導入、新製程開發、研發專案技術及光罩模具設計、中長程需求預測與市場情報蒐集、策劃新產品/事業與定義產品發展藍圖。

營運組織：製造封裝、產品工程、設備維護、製程整合、廠務、環安衛及風險管理。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事及監察人資料

1. 董事及監察人資料

113年4月1日

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	初次選 任日期	選任 日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持 有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人			備註
							股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	陳家湘	男 61~70歲	106/6/30	111/5/26	3年	0	0	300,000	0.11	0	0	0	0	台積公司先進封測三廠資深處長 台積固態照明公司總經理 台積太陽能公司總經理 台積公司上海松江廠總經理 台積公司三廠廠長 新加坡 SSMC 合資廠營運副總 台積公司產品工程處處長 台積公司七廠廠長 交通大學光電工程研究所碩士 交通大學電子物理系學士	本公司總經理及 ESG 指導委員會召集人	無	無	無	註 1
	中華民國	台灣積體電路製造股份有限公司 代表人		96/3/5	111/5/26	3年	111,281,925	41.01	111,281,925	41.01	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
董事	中華民國	汪業傑	男 61~70歲	107/11/1	111/5/26	3年	0	0	0	0	0	0	0	0	台積公司智能工程中心處長 台積公司三廠廠長 清華大學材料科學與工程碩士	台積公司營運組織人力資源業務夥伴處處長	無	無	無	
	中華民國	台灣積體電路製造股份有限公司 代表人		96/3/5	111/5/26	3年	111,281,925	41.01	111,281,925	41.01	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
獨立 董事	中華民國	王文字	男 61~70歲	102/6/13	111/5/26	3年	0	0	0	0	0	0	0	0	創意電子公司獨立董事 凱基銀行獨立董事 統一超商公司獨立董事 臺灣大學法律學院教授 前行政院公平交易委員會委員 美國史丹福大學法學博士	本公司薪酬委員會召集人 尼得科超眾科技獨立董事 臺灣大學法律學院兼任教授 國際比較法學會(IACL)台灣分會召集人 開南大學法律學院榮譽講座教授兼院長	無	無	無	

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	初次選 任日期	選任 日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持 有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人			備註
							股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中華民國	謝徽榮	男 71~80 歲	102/6/13	111/5/26	3 年	0	0	0	0	0	0	0	0	茂達電子股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員 寶勝國際(控股)有限公司獨立非執行 董事及薪酬委員會主席 世界先進積體電路股份有限公司財務 副總經理 美商美國銀行台北分行副總經理 臺灣大學商研所碩士 清華大學核子工程學士	本公司審計委員會召集人、薪酬委員會 委員及 ESG 指導委員會委員	無	無	無	
獨立 董事	中華民國	溫環岸	女 61~70 歲	105/6/14	111/5/26	3 年	0	0	0	0	0	0	0	0	交通大學研究發展處副研發長 及電機學院副院長 成功大學電機工程學系博士、碩士及 學士	本公司薪酬委員會委員 南茂科技股份有限公司獨立董事 陽明交通大學電子研究所教授、社會責 任推展辦公室執行長	無	無	無	
獨立 董事	中華民國	梁明成	男 61~70 歲	112/5/29	112/5/29	2 年	0	0	0	0	0	0	0	0	美光科技副總裁 國立台灣大學國際企業學系研 究所 EMBA 碩士 國立成功大學物理系學士	本公司 ESG 指導委員會委員 台灣光罩集團群豐科技董事長 台灣光罩集團美祿科技董事 建騰創達科技獨立董事 昇陽半導體獨立董事	無	無	無	

註1：本公司董事長陳家湘先生為法人董事台灣積體電路製造股份有限公司之代表人，陳家湘先生經董事會任命為總經理。6席董事中僅1席具兼任經理人身份，4席為獨立董事，符合過半數董事未具員工或經理人之規定。依109年1月2日發佈之「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，上櫃公司董事長與總經理或相當職務者為同一人者，應於112年12月31日前設置獨立董事人數不得少於4人。本公司已於112年5月29日增選一席獨立董事。

## 2.法人股東之主要股東

法人名稱	法人之主要股東	持股比
台灣積體電路製造股份有限公司 (註 1)	花旗託管台積電存託憑證專戶	20.50%
	行政院國家發展基金管理會	6.38%
	花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶	3.10%
	花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	1.64%
	新制勞工退休基金	1.31%
	大通託管先進星光先進總合國際股票指數	1.25%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	1.11%
	中國信託商業銀行受託保管元大台灣卓越50證券投資信託基金專戶	1.02%
	渣打託管 iShares 新興市場 ETF	0.86%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管歐洲太平洋成長基金	0.69%

註1：基準日為112年9月20日。

## 3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：不適用

#### 4. 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：陳家湘		具商務及公司業務所須之五年以上工作經驗，且無公司法第三十條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。	1.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	無
台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：汪業傑		具商務及公司業務所須之五年以上工作經驗，且無公司法第三十條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。	1.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	無
王文宇		具法務及公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上之五年以上工作經驗，且無公司法第三十條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務且取得報酬。	1
謝徽榮		具財務、會計及公司業務所須之五年以上工作經驗，且無公司法第三十條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務且取得報酬。	0
溫環岸		具公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上之五年以上工作經驗，且無公司法第三十條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務且取得報酬。	1
梁明成		具商務及公司業務所須之五年以上工作經驗，且無公司法第三十條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務且取得報酬。	2

## 5. 董事會多元化及獨立性：

### (1) 董事會多元化：

#### 董事會多元化政策：

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員宜普遍具備執行職務所需之知識、技能及素養，如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力等。獨立董事之選任，宜考量其成員是否具備誠信踏實、公正判斷、專業知識、豐富之經驗與閱讀財務報表能力等條件。

本公司獨立董事之資格及選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。本公司董事之選任，依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

除以上多元化政策外，本公司董事會多元化目標為獨立董事席次過半及至少包含一名女性董事。

### (2) 董事會多元化管理目標與目前達成情形：

董事會成員目前已達成多元化的要求；未來於董事改選提名時，將持續考量公司長期發展目標、董事專業的互補性等；或透過董事課程等訓練，以強化董事會成員多元化之目標。

### (3) 董事會成員多元化落實情形：

本公司現任董事會由六位董事組成，其中獨立董事為四席，超過半數，且六位董事間不具有配偶及二等親以內親屬關係，因此本公司董事會具獨立性。董事長陳家湘先生兼任本公司總經理，亦符合兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一規定。另外，六位董事中包含一位女性董事。本公司董事會成員具備跨產業領域之多元互補能力，也各自具有產業經驗與相關技能，如法律、財務會計、產業科技研發、經營管理、專業技能及產業經歷，本公司個別董事落實董事會成員多元化政策之情形如下：

董事姓名	多元化核心項目								
	性別	國籍	年齡	年資	經營管理	領導決策	產業知識	財會專業	法律專業
陳家湘	男	中華民國	61~70歲	6-9年	✓	✓	✓		
汪業傑	男	中華民國	61~70歲	3-6年	✓	✓	✓		
王文宇	男	中華民國	61~70歲	9年以上	✓	✓			✓
謝徽榮	男	中華民國	71~80歲	9年以上	✓	✓		✓	
溫瓊岸	女	中華民國	61~70歲	6-9年	✓	✓	✓		
梁明成	男	中華民國	61~70歲	1年以下	✓	✓	✓		

(4)董事會獨立性：

本公司現任董事會由6位董事組成，其中包含4位獨立董事成員(佔66%)，並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，且董事間並無配偶及二親等以內親屬關係之情形。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

113 年 4 月 1 日

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關係之 經理人			備註
					股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職 稱	姓 名	關 係	
總 經 理	中華民國	陳家湘	男	106/7/1	300,000	0.11	0	0	0	0	台積公司先進封測三廠資深處長 台積固態照明公司總經理 台積太陽能公司總經理 台積公司上海松江廠總經理 台積公司三廠廠長 新加坡 SSMC 合資廠營運副總 台積公司產品工程處處長 台積公司七廠廠長 交通大學光電工程研究所碩士 交通大學電子物理系學士	無	無	無	無	註 1
營 運 組 織 副 總 經 理	中華民國	朱美彥	女	107/12/3	0	0	0	0	0	0	輯方技術(股)公司顧問 精材科技(股)公司產品工程協理 采鈺科技(股)公司產品處長 台積公司製程整合經理 清華大學物理學博士	無	無	無	無	
財 務 組 織 副 總 經 理	中華民國	林恕敏	男	91/5/1	69,629	0.03	0	0	0	0	致福電子(股)公司會計經理 敦南科技(股)公司會計主任 東吳大學會計系學士	無	無	無	無	
支 援 組 織 協 理	中華民國	范振梅	男	108/8/2	16,787	0.01	0	0	0	0	本公司中壢廠區資深廠長/支援組織資深處長 台積公司副理 臺灣工業技術學院電機工程技術系學士	無	無	無	無	
研 發 組 織 協 理	中華民國	劉滄宇	男	108/8/2	20,025	0.01	0	0	0	0	本公司研發組織/資深處長 台積公司副理 臺灣大學化學研究所碩士	無	無	無	無	
業 務 組 織 協 理	中華民國	馬中文	男	111/11/4	0	0	0	0	0	0	本公司品質及可靠性組織/資深處長 本公司業務組織/資深處長 台積公司副理 美國密蘇里大學工業工程學系碩士	無	無	無	無	
法務處處長暨 公司治理主管	中華民國	周正德	男	109/8/4	5	0.00	0	0	0	0	冠群專利商標/合夥人 將群智權事務所/專利經理 東吳大學法律學系學士	無	無	無	無	
稽 核 處 長	中華民國	黃亮凱	男	103/3/6	675	0.00	0	0	0	0	本公司資材暨資訊處處長 瀚斯寶麗(股)公司供應鏈運籌總管理處處長 台積公司製造策略技術中心經理 清華大學工業工程研究所博士	無	無	無	無	

註 1：本公司董事長陳家湘先生為法人董事台灣積體電路製造股份有限公司之代表人，陳家湘先生經董事會任命為總經理。6 席董事中僅 1 席具兼任經理人身份，4 席為獨立董事，符合過半數董事未具員工或經理人之規定。依 109 年 1 月 2 日發佈之「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，上櫃公司董事長與總經理或相當職務者為同一人者，應於 112 年 12 月 31 日前設置獨立董事人數不得少於 4 人。本公司已於 112 年 5 月 29 日增選一席獨立董事。

### 三、最近年度(112)給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

#### (一) 董事之酬金

112年12月31日 單位：新台幣仟元；千股

職稱	姓名	董事酬金								兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及稅後純益之比例		有無領取自子公司以外資或母業公司酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註1)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額及稅後純益之比例		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司			本公司	財務報告內所有公司
董事長	陳家湘 台灣積體電路製造(股)公司代表人	0	0	0	0	990	990	120	120	1,110 / 0.08%	1,110 / 0.08%	4,995	4,995	0	0	3,369	0	3,369	0	9,474 / 0.69%	9,474 / 0.69%	無
董事	汪業傑 台灣積體電路製造(股)公司代表人	0	0	0	0	990	990	120	120	1,110 / 0.08%	1,110 / 0.08%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110 / 0.08%	1,110 / 0.08%	無
獨立董事	王文宇	990	990	0	0	0	0	120	120	1,110 / 0.08%	1,110 / 0.08%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110 / 0.08%	1,110 / 0.08%	無
獨立董事	謝徽榮	990	990	0	0	0	0	120	120	1,110 / 0.08%	1,110 / 0.08%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110 / 0.08%	1,110 / 0.08%	無
獨立董事	溫瓊岸	990	990	0	0	0	0	120	120	1,110 / 0.08%	1,110 / 0.08%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110 / 0.08%	1,110 / 0.08%	無
獨立董事	梁明成	596	596	0	0	0	0	80	80	676 / 0.05%	676 / 0.05%	0	0	0	0	0	0	0	0	676 / 0.05%	676 / 0.05%	無

\*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1：陳家湘及汪業傑為台積公司代表人，董事酬勞係由其所代表之法人股東領取。

註2：本公司獨立董事之報酬係依本公司章程及本公司「董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法」之規定辦理。董事會依獨立董事對公司營運參與程度及貢獻之價值，暨國內外業界水準後定之。本公司給付獨立董事每人每月報酬及車馬費。

註3：除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

#### (二) 監察人之酬金

業於102年6月13日由全體獨立董事組成審計委員會並取代監察人，故不適用。

(三) 總經理及副總經理之酬金

112年12月31日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B) (註1)		獎金及特支費等 等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四 項總額及占稅後純 益之比例(%)		有無領取來自 子公司以外轉 投資事業或母 公司酬金
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報 告內所 有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	陳家湘	25,040	25,040	660	660	928	928	13,109	0	13,109	0	39,737 / 2.9%	39,737 / 2.9%	無
副總經理	林中安 (註2)													
副總經理	朱美彥													
副總經理	林恕敏													
協理	范振梅													
協理	劉滄宇													
協理	馬中文													
處長暨公司 治理主管	周正德													

註1：退職退休金金額全數為提列提撥數，並無實際支付數。

註2：林中安副總經理於112年2月10日離職。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	林中安	林中安
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	馬中文、周正德	馬中文、周正德
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	陳家湘、朱美彥、林恕敏、 范振梅、劉滄宇	陳家湘、朱美彥、林恕敏、 范振梅、劉滄宇
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總 計	8 人	8 人

(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形  
元

單位：新台幣仟

	職 稱	姓 名	股 票 金 額	現 金 金 額	總 計	總額占稅後純 益之比例(%)
經 理 人	總經理	陳家湘	0	13,109	13,109	1.0%
	副總經理	朱美彥				
	副總經理	林恕敏				
	協理	范振梅				
	協理	劉滄宇				
	協理	馬中文				
	處長暨公司治理 主管	周正德				

(五) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

本公司 111 年度及 112 年度支付董事及監察人之酬金分別為 4,800 仟元及 6,226 仟元，其佔 111 年度及 112 年度稅後淨利比例分別為 0.2% 及 0.5%。本公司 111 年度及 112 年度支付總經理及副總經理之酬金分別為 52,340 仟元及 39,737 仟元，佔 111 年度及 112 年度稅後淨利比例分別為 2.6% 及 2.9%。

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1) 依公司章程規定，公司如有獲利，提撥不高於百分之二為董事酬勞，且董事酬勞給付之對象不包括擔任本公司經理人之董事。本公司董事之報酬係依本公司「董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法」給付之，且董事報酬給付政策係以其對公司營運參與程度及貢獻價值，依據「董事會績效評估辦法」定期評估董事績效，

評核範圍包括：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六項指標評估結果納入考量，暨參考國內外業界水準後訂定，並經薪資報酬委員會審議及董事會通過。

(2)本公司依公司章程規定，如有獲利提撥不低於百分之一為員工酬勞，本公司經理人之薪資報酬視其個人對本公司營運參與程度、個人績效貢獻與目標達成情況、職務、職級等因素而訂，評估項目如：目標達成率、獲利率、營運效益及貢獻度等綜合考量後，參酌市場同業水準訂定原則，經薪資報酬委員會審議及董事會通過後執行。

綜合以上，本公司給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險有一定之關聯性。

3.定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構：

本公司定期檢討董事及經理人績效評估，薪資報酬委員會於每年第四季報告及討論當年度董事會績效評估作業方式，於年度結束後進行評核，次年度第一季之薪資報酬委員會說明董事會績效評估結果，並於董事會中報告。

經理人之績效評估，於每年第四季由總經理依管理權責作成次年度之經理人績效目標及考核表，經薪資報酬委員會及董事會同意後，於次年度結束後進行考核，於每年第一季薪資報酬委員會中報告及檢視經理人績效評估結果。

薪資報酬委員會每年定期審議董事及經理人績效評估及薪資報酬情形，請參閱薪資報酬委員會開會資訊。

#### 四、公司治理運作情形

##### (一) 董事會運作情形：

本公司董事會於 112 年度共召開 5 次(A)董事會，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出席(列)席率(%) (B/A)	備註
董事長	陳家湘 台灣積體電路製造股份有限公司 代表人	5	0	100%	
董事	汪業傑 台灣積體電路製造股份有限公司 代表人	4	1	80%	
獨立董事	王文宇	5	0	100%	
獨立董事	謝徽榮	5	0	100%	
獨立董事	溫環岸	5	0	100%	
獨立董事	梁明成	2	0	100%	於 112.5.29 任職

其他應記載事項：

1. 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

開會日期 (期別)	議案內容	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
112 年 2 月 9 日 (第十屆第四次)	1. 核准本公司修訂「董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法」。 2. 核准本公司 111 年度董事報酬及酬勞及 112 年度董事報酬及酬勞政策。 3. 核准本公司具董事身分之經理人及經理人 111 年度之績效評估及 112 年度薪資調整。 4. 核准本公司具董事身分之經理人及經理人 111 年度之員工酬勞。 5. 核准本公司具董事身分之經理人及經理人 111 年度薪資報酬及 112 年度薪資報酬政策。 6. 核准本公司修訂「公司治理實務守則」。 7. 核准依據審計品質指標(AQIs)對簽證會計師進行評估。經評估後，勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞與黃裕峰會計師均符合獨立性及適任性要求。 8. 核准本公司修訂「永續發展實務守則」。	無	無
112 年 4 月 14 日 (第十屆第五次)	1. 核准解除新任獨立董事之競業禁止限制。	無	無
112 年 8 月 4 日 (第十屆第七次)	1. 核准修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」。	無	無
112 年 11 月 7 日 (第十屆第八次)	1. 核准本公司修訂「公司治理實務守則」。 2. 參考審計品質指標(AQIs)對簽證會計師進行評估。經評估後，勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞與黃裕峰會計師均符合獨立性及適任性要求，核准委任勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞與黃裕峰會計師擔任簽證會計師及 113 年度服務公費。	無	無

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

2. 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因及參與表決情形：

- (1) 112 年 2 月 9 日召開第十屆第四次董事會決議核准本公司修訂「董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法」，因關係到各董事自身利益，討論及決議時已依法各自迴避，其他全體出席董事同意照案通過。
- (2) 112 年 2 月 9 日召開第十屆第四次董事會決議核准本公司 111 年度董事報酬及酬勞及 112 年度董事報酬及酬勞政策，因關係到各董事自身利益，討論及決議時，已依法各自迴避，其他全體出席董事同意照案通過。
- (3) 112 年 2 月 9 日召開第十屆第四次董事會決議核准本公司具董事身分之經理人及經理人 111 年度之績

效評估及 112 年度薪資調整，因關係到董事長暨總經理陳家湘先生自身利益，討論及決議時已依法迴避，其他全體出席董事同意照案通過。

(4) 112 年 2 月 9 日召開第十屆第四次董事會決議核准本公司具董事身分之經理人及經理人 111 年度之員工酬勞，因關係到董事長暨總經理陳家湘先生自身利益，討論及決議時已依法迴避，其他全體出席董事同意照案通過。

(5) 112 年 2 月 9 日召開第十屆第四次董事會決議核准本公司具董事身分之經理人及經理人 111 年度薪資報酬及 112 年度薪資報酬政策，因關係到董事長暨總經理陳家湘先生自身利益，討論及決議時已依法迴避，其他全體出席董事同意照案通過。

### 3. 董事會自我(或同儕)評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日	董事會	董事會自評	對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。
		個別董事成員	董事成員自評	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。
		功能性委員會	功能性委員會自評	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。

### 4. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

(1) 本公司已於 100 年 11 月 11 日成立薪酬委員會，以協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策及經理人之報酬。

(2) 本公司 102 年度業經股東會通過設置審計委員會，目前由四位獨立董事組成，強化董事會公司治理職能。

## (二) 審計委員會運作情形

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括：

- 財務報表；
- 稽核及會計政策與程序；
- 內部控制制度暨相關之政策與程序；
- 重大之資產或衍生性商品交易；
- 重大資金貸與背書或保證；
- 募集或發行有價證券；
- 衍生性金融商品及現金投資情形；
- 法規遵循；
- 經理人與董事是否有關係人交易及可能性；
- 申訴報告；
- 防止舞弊計畫及舞弊調查報告；
- 資訊安全；
- 公司風險管理；
- 簽證會計師資歷、獨立性及績效評估；
- 簽證會計師之委任、解任或報酬；
- 財務、會計或內部稽核主管之任免；
- 審計委員會職責履行情形。

最近年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備 註
獨立董事	王文宇	4	1	80%	
獨立董事	謝徽榮	5	0	100%	
獨立董事	溫瓊岸	5	0	100%	
獨立董事	梁明成	2	0	100%	於 112.5.29 任職

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

開會日期 (期別)	議 案 內 容	獨立董事反對 意見、保留意見 或重大建議 項目內容	審計委員會 決議結果	公司對審計 委員會意見 之 處 理
112 年 2 月 9 日 (第四屆第四次)	1. 請同意本公司 111 年度之營業報告書及財務報表。 2. 請同意本公司 111 年度之盈餘分派案。 3. 請同意本公司修訂公司治理實務守則。 4. 因應「公司治理實務守則」修訂，請同意依據審計品質指標(AQIs)對簽證會計師進行評估。經評估後，勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞會計師與黃裕峰會計師均符合獨立性及適任性要求。 5. 請同意本公司修訂永續發展實務守則。 6. 請同意本公司 111 年度之「內部控制制度聲明書」。	無	出席委員一致同意照案通過	無
112 年 4 月 14 日 (第四屆第五次)	請同意本公司解除新任獨立董事之競業禁止限制。	無	出席委員一致同意照案通過	無
112 年 5 月 5 日 (第四屆第六次)	請同意本公司 112 年度第 1 季財務報告。	無	出席委員一致同意照案通過	無

112年8月4日 (第四屆第七次)	1. 請同意本公司112年度第2季財務報告。 2. 請同意本公司修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」。	無	出席委員一致同意照案通過	無
112年11月7日 (第四屆第八次)	1. 請同意本公司112年度第3季財務報告。 2. 本公司參考審計品質指標(AQIs)對簽證會計師進行評估。評估後，勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞會計師及黃裕峰會計師均符合簽證會計師獨立性及適任性要求。 3. 請同意本公司113年度委任勤業眾信聯合會計師事務所簽證服務公費。 4. 請同意本公司修訂「公司治理實務守則」。	無	出席委員一致同意照案通過	無

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1. 本公司內部稽核主管定期與審計委員會溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
2. 會計師定期與審計委員會溝通說明財務報表查核情形及其相關法令要求事項，且獨立董事得隨時要求會計師進行報告與溝通。
3. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要，請參考本公司網站：  
[https://www.xintec.com.tw/chi/Legal/CG\\_Committees\\_Audit.html](https://www.xintec.com.tw/chi/Legal/CG_Committees_Audit.html)

(三) 監察人參與董事會運作情形：

本公司於102年6月13日已設置審計委員會，故不適用監察人制度。

(四) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並於公開資訊關測站及公司網站揭露公司治理實務守則。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				無重大差異
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		(一) 本公司設有發言人制度，統一由發言人或代理發言人處理股東建議、疑義及糾紛等問題。	
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		(二) 本公司每月向董事及持股10%以上大股東取得持股變動申報書，以確實掌握實際控制公司之主要股東名單，不定期與主要股東保持密切聯繫，以掌握其最終控制者之名單。	
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		(三) 制定及落實內部控制制度及相關管理辦法，稽核單位並定期監督執行情形。	
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		(四) 公司訂有內部重大資訊處理作業程序，以規範內部重大資訊保密作業程序，訂定並宣導公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控制措施，包括(但不限於)不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易本公司股票。	
三、董事會之組成及職責				無重大差異
(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√		(一) 董事會多元化政策： 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員宜普遍具備執行職務所需之知識、技能及素養，如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力等。獨立董事之選任，宜考量其成	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>員是否具備誠信踏實、公正判斷、專業知識、豐富之經驗與閱讀財務報表能力等條件。</p> <p>本公司獨立董事之資格及選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。本公司董事之選任，依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。</p> <p>董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</p> <p>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。</p> <p>除以上多元化政策外，本公司董事會多元化目標為獨立董事席次過半及至少包含一名女性董事。</p> <p>董事會多元化管理目標與目前達成情形</p> <p>董事會成員目前已達成多元化的要求；未來於董事改選提名時，將持續考量公司長期發展目標、董事專業的互補性等；或透過董事課程等訓練，以強化董事會成員多元化之目標。</p> <p>董事會成員多元化落實情形</p> <p>本公司現任董事會由六位董事組成，其中獨立董事為四席，超過半數，且六位董事間不具有配偶及二等親以內親屬關係，因此本公司董事會具獨立性。董事長</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																																																															
	是	否	摘要說明																																																																																
			<p>陳家湘先生兼任本公司總經理，亦符合兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一規定。另外，六位董事中包含一位女性董事。本公司董事會成員具備跨產業領域之多元互補能力，也各自具有產業經驗與相關技能，如法律、財務會計、產業科技研發、經營管理、專業技能及產業經歷，本公司個別董事落實董事會成員多元化政策之情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">董事姓名</th> <th colspan="9">多元化核心項目</th> </tr> <tr> <th>性別</th> <th>國籍</th> <th>年齡</th> <th>年資</th> <th>經營管理</th> <th>領導決策</th> <th>產業知識</th> <th>財務會計</th> <th>法律</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>陳家湘</td> <td>男</td> <td>中華民國</td> <td>61~70歲</td> <td>6~9年</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>汪業傑</td> <td>男</td> <td>中華民國</td> <td>61~70歲</td> <td>3~6年</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>王文宇</td> <td>男</td> <td>中華民國</td> <td>61~70歲</td> <td>9年以上</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>謝徽榮</td> <td>男</td> <td>中華民國</td> <td>71~80歲</td> <td>9年以上</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>溫環岸</td> <td>女</td> <td>中華民國</td> <td>61~70歲</td> <td>6~9年</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>梁明成</td> <td>男</td> <td>中華民國</td> <td>61~70歲</td> <td>1年以下</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	董事姓名	多元化核心項目									性別	國籍	年齡	年資	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	陳家湘	男	中華民國	61~70歲	6~9年	✓	✓	✓			汪業傑	男	中華民國	61~70歲	3~6年	✓	✓	✓			王文宇	男	中華民國	61~70歲	9年以上	✓	✓			✓	謝徽榮	男	中華民國	71~80歲	9年以上	✓	✓		✓		溫環岸	女	中華民國	61~70歲	6~9年	✓	✓	✓			梁明成	男	中華民國	61~70歲	1年以下	✓	✓	✓			
董事姓名	多元化核心項目																																																																																		
	性別	國籍	年齡	年資	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律																																																																										
陳家湘	男	中華民國	61~70歲	6~9年	✓	✓	✓																																																																												
汪業傑	男	中華民國	61~70歲	3~6年	✓	✓	✓																																																																												
王文宇	男	中華民國	61~70歲	9年以上	✓	✓			✓																																																																										
謝徽榮	男	中華民國	71~80歲	9年以上	✓	✓		✓																																																																											
溫環岸	女	中華民國	61~70歲	6~9年	✓	✓	✓																																																																												
梁明成	男	中華民國	61~70歲	1年以下	✓	✓	✓																																																																												
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		(二) 本公司董事會於112年11月7日核准設立「ESG指導委員會」，由三名董事(含兩名獨立董事)組成，召集人為董事長陳家湘先生。委員會職權包括(1)負責擬定公司ESG願景及策略，(2)監督ESG執行委員會執行狀況。																																																																																
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(三) 本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於109年2月通過董事績效評估辦法，以提昇董事會功能，強化董事會運作效率。內部評估董事會整體績效自評涵蓋以下五大構面：A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制。董事成員績效評估之衡量項目則涵蓋以下六大面向：A. 公司目標與任																																																																																

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<p>務之掌握 B.董事職責認知 C.對公司營運之參與程度 D.內部關係經營與溝通 E.董事之專業及持續進修 F.內部控制。自民國102年起每年執行一次，定期辦理董事自評與同儕互評，自112年2月起增加功能性委員會績效評估，衡量項目包含以下五大面向：A.對公司營運之參與程度 B.功能性委員會職責認知 C.提升功能性委員會決策品質 D.功能性委員會組成及成員選任 E.內部控制。評估結果於第一季檢討並提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考，民國112年度本公司內部董事會績效評估結果為「良」，董事成員績效評估結果為「優」，審計委員會績效評估結果為「優」，薪資報酬委員會績效評估結果為「優」，足以顯示本公司強化董事會效能之成果。</p> <p>(四) 本公司每年依據審計品質指標(AQIs)定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，要求簽證會計師每年提供「超然獨立聲明書」外，另製作「會計師獨立性及適任性評估表」，針對可能影響獨立性項目逐一評估簽證會計師之獨立性，經本公司確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他財務利益及業務關係；會計師家庭成員亦不違反獨立性的要求，認為符合獨立性及適任性之要求，並提報審計委員會及董事會討論通過。</p>	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董	V		<p>本公司董事會於 109 年 8 月 4 日決議通過任命法務處處長周正德先生為公司治理主管。本公司所有董事皆可取得公司治理主管之協助，以確保董事會程序及所有適用法令、規則均獲得遵守，並確保董事會成員之間及董事與經理部門之間資</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因										
	是	否	摘要說明											
事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?			<p>訊交流良好。</p> <p>本公司公司治理主管已具備公開發行公司從事法務之主管經驗達三年以上。</p> <p>本公司董事會指定議事事務單位由董事會秘書單位負責，由財務組織副總經理林恕敏先生擔任董事會秘書。董事會秘書單位負責統籌提供董事執行業務所需資料及公司治理相關事務，包括：</p> <p>一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。</p> <p>二、製作董事會及股東會議事錄。</p> <p>三、協助董事、獨立董事就任及持續進修。</p> <p>四、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。</p> <p>五、協助董事、獨立董事遵循法令。</p> <p>六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章。</p> <p>七、辦理董事異動相關事宜。</p> <p>八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</p> <p>年度公司治理業務執行情形彙整如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜</th> <th>協助董事就任及完成持續進修時數</th> <th>協助董事遵循法令及執行職務</th> <th>辦理公司登記及變更登記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>5次董事會，1次股東會</td> <td>36小時</td> <td>每季評估內部程序或辦法是否符合法規要求。修訂「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」、「董事會績效評估辦法」、「董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法」、「風險管理政策與程序」、「內部控制制度」及「內部稽核制度」。</td> <td>完成公司變更登記共1次。</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司參加105年至110年主管機關之公司治理評鑑結果，均列於前5%。111年則列於6~10%。</p>	年度	依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜	協助董事就任及完成持續進修時數	協助董事遵循法令及執行職務	辦理公司登記及變更登記	112	5次董事會，1次股東會	36小時	每季評估內部程序或辦法是否符合法規要求。修訂「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」、「董事會績效評估辦法」、「董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法」、「風險管理政策與程序」、「內部控制制度」及「內部稽核制度」。	完成公司變更登記共1次。	
年度	依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜	協助董事就任及完成持續進修時數	協助董事遵循法令及執行職務	辦理公司登記及變更登記										
112	5次董事會，1次股東會	36小時	每季評估內部程序或辦法是否符合法規要求。修訂「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」、「董事會績效評估辦法」、「董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法」、「風險管理政策與程序」、「內部控制制度」及「內部稽核制度」。	完成公司變更登記共1次。										

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√		本公司設有發言人及代理發言人擔任公司對外溝通管道，並於公司網站設置違反從業道德行為舉報系統，提供客戶、廠商或其他利害關係人檢舉本公司人員不當行為之管道。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		本公司已委任台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等) (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	√ √ √		(一) 本公司已架設公司中英文網站，並責成相關部門維護及揭露公司財務業務等相關資訊。 (二) 本公司已指定專人負責定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財務業務資訊並依相關規定發佈重大訊息，並設有發言人及代理發言人制度，公司亦將定期召開法人說明會之簡報及影音檔放置於公司網站。 (三) 本公司年度財務報告均於會計年度終了後兩個月內公告並申報，第一、二、三季財務報告及各月份營運情形均於規定期限前提早公告。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	√		(一) 在環境保護方面，遵守環保、安全與綠色產品等永續發展相關之法令規章或要求，並持續關注國際環保發展趨勢，強化綠色環保責任，並致力規劃與執行各項節能減碳專案，以減少各項用電及溫室效應氣體排放量，降低地球溫室氣體效應，善盡地球公民職責。 (二) 在勞動權益方面，持續改善就業環境與安全衛生管理制度，以提供平等就業機會及預防傷害事故與職業疾病的發生。 (三) 在員工權益方面，成立職工福利委員會、實施退休金制度、	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>辦理員工團體保險及定期舉辦健康檢查，並提供各項員工訓練課程等持續進修管道。</p> <p>(四) 在供應商管理方面，本公司設有供應商考核制度確保供應商能符合本公司的品質及環境政策，訂有供應商評鑑制度以確保稽核之執行，並與供應商維持順暢的溝通管道，保持良好的上下游關係，促進產業鏈永續發展。</p> <p>(五) 在資訊保密方面，尊重與保護客戶之技術文件與資料。對外，本公司與客戶及供應商簽有保密協議，明訂具法律效力的權利及義務；對內，本公司設有機密資訊保護委員會，要求員工遵守相關保密規定，並落實保安全管理，以保障公司及客戶之機密資訊安全。</p> <p>(六) 本公司依法令規定公開公司資訊，以保障投資人及利害關係人之權利。</p> <p>(七) 本公司每年舉辦董事進修相關課程，雖未強制要求董事進修專業知識課程，但係以積極態度鼓勵董事依個人需求參與。</p> <p>(八) 本公司為落實公司治理，已為本公司董事投保責任保險。</p>	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。</p> <p>(一) 茲就 111 年度公司治理評鑑結果之改善項目包括：為保障股東平等，訂定禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之內部規範；訂定董事會成員多元化之政策與目標，以健全董事會結構；制訂董事會成員及重要管理階層之接班計畫；設置永續發展指導委員會，以健全董事會職能。</p> <p>(二) 針對 112 年度加強事項與改善措施說明如下： 本公司重視股東權益，擬議公開透明揭露股利政策及其分派情形，以利股東及時且平等獲取攸關訊息。</p>				

(五) 公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

薪資報酬委員會：

- 1.組成：本公司於 100 年 11 月 11 日成立薪酬委員會，並於 111 年 5 月 26 日改選後由王文宇先生(召集人)、謝徽榮先生及溫瓊岸女士三位獨立董事組成薪酬委員會。

身分別	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名			
獨立董事及薪資報酬委員會召集人	王文宇	(註一)	(註一)	0
獨立董事	謝徽榮	(註一)	(註一)	0
獨立董事	溫瓊岸	(註一)	(註一)	0

註一：參閱第 10 頁董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊之揭露。

2.職權範圍：

- (1)定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
- (2)定期評估並訂定公司整體薪酬政策。
- (3)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- (4)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- (1)董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- (2)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- (3)針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊：

- (1)本公司之薪資報酬委員會委員共計三人，每年至少開會 2 次。
- (2)本屆委員任期：111 年 5 月 26 日至 114 年 5 月 25 日，112 年度薪資報酬委員會共開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	王文宇	1	1	50%	
委員	謝徽榮	2	0	100%	
委員	溫瓊岸	2	0	100%	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

4.薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

開會日期	項次	議案內容及後續處理
112年2月9日 第五屆第三次	一	檢討本公司董事績效評估之政策、制度、標準與結構，審議修訂本公司「董事會績效評估辦法」，並提請董事會決議。
	二	檢討本公司董事薪資報酬之政策、制度、標準與結構，審議修訂本公司「董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法」，並提請董事會決議。
	三	審議本公司提撥111年度員工酬勞案，並提請董事會決議。
	四	審議本公司董事之111年度董事報酬及酬勞及112年度董事報酬及酬勞政策案，並提請董事會決議。
	五	請審議本公司經理人林中安先生之特別獎金案，並提請董事會決議。
	六	檢討本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以及審議本公司具董事身份經理人及經理人之111年度績效評估及112年度薪資調整案，並提請董事會決議。
	七	審議本公司具董事身份經理人及經理人之111年度員工酬勞，並提請董事會決議。
	八	審議本公司具董事身份經理人及經理人之111年度薪資報酬及112年度薪資報酬政策案，並提請董事會決議。
		薪酬委員會決議結果：除第四案各委員於有自身利害關係之事項皆已迴避，其餘委員會全體成員同意通過。
		公司對於薪酬委員會成員意見之處理：除第六案、第七案及第八案因陳家湘董事長涉及自身利害關係之事項，自行迴避討論及表決，第二案及第四案各委員於有自身利害關係之事項皆已迴避，所有議案經出席之董事一致無異議依薪資報酬委員會之建議通過。
112年11月7日 第五屆第四次	一	請審議本公司113年薪酬預算。
	薪酬委員會決議結果：委員會全體成員同意通過。	
	公司對於薪酬委員會成員意見之處理：經出席之董事一致無異議依薪資報酬委員會之建議通過。	

提名委員會：本公司並未設立提名委員會。

(六) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會督導情形？	V		<p>本公司董事會於 112 年 11 月 7 日核准設立「ESG 指導委員會」，由三名董事(含兩名獨立董事)組成，主席為董事長陳家湘先生。委員會職權包括(1)負責擬定公司 ESG 願景及策略 (2)監督 ESG 執行委員會執行狀況。原企業永續發展委員會更名為 ESG 執行委員會，每季定期召開會議，藉各部門代表於日常業務中與利害關係人持續溝通並收集反饋資訊，落實執行各項永續發展相關工作，並於會議中彙報與各部門間協調進度，以完成有關利害關係人關注之各項議題管控，促進經濟、環境與社會之間的平衡與確保企業永續發展策略充分落實於公司日常營運中。</p> <p>本公司訂有企業永續發展政策，以管理公司對經濟、環境及社會風險與影響，以俾追求提升公司競爭力，改善員工生活品質與回饋社會的理念，實踐企業應負之社會責任，並將實踐成果與利害關係人關注議題每年定期至董事會報告，董事會檢視策略的進展，並於需要時敦促經營團隊進行調整。</p> <p>委員會組織架構</p> <pre> graph TD     Board[董事會] --- Compensation[薪酬委員會]     Board --- ESG_Steering[ESG 指導委員會]     Board --- Audit[審計委員會]     ESG_Steering --- ESG_Execution[ESG 執行委員會]     ESG_Execution --- Business[經營治理組]     ESG_Execution --- Environment[環境保護組]     ESG_Execution --- Social[社會參與組]     Business --- Execution[相關切議題執行部門]     Environment --- Execution     Social --- Execution     </pre>	無重大差異

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展 實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			本公司ESG執行委員會於112年8月發行111年度永續報告書，請見網站： <a href="https://www.xintec.com.tw/chi/Legal/ESG.html">https://www.xintec.com.tw/chi/Legal/ESG.html</a>	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		ESG 執行委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，詳閱永續報告書第 1 章企業永續營運。 本公司之風險管理委員會，於每季召開一次會議。相關風險管理策略請參見永續報告書第 3.4 風險管理及第 39 頁之附表。	無重大差異
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V V V		(一) 公司已建立健全環境管理程序及制度，並已於94年1月取得ISO14001環境管理系統驗證迄今。 (二) 公司致力於提升資源使用及再利用之效能，已訂定相關資源使用管理程序及設置水資源回收再利用系統。112年共執行29項節水節電相關措施，均已完成，節省效益為新台幣22.68百萬元。 (三) 嚴格遵守法規，定期實施環保法令規定查核，掌握最新法規，依法實施環境檢測與污染防治對策，同時採用 ISO14001 環境管理系統策略，針對環境考量面進行評估並擬定預防措施，藉由定期內、外部稽核與第三方覆核檢視是否符合持續改善之目的，提升員工環境保護意識。 引用國際標準ISO/CNS14064-1建立、實施及維持溫室氣體盤查管理系統，以掌握更精確的溫室氣體排放現況，有效地執行溫室氣體減量措施，期能落實環境正義並善盡地球公民之責，確保環境永續發展。 公司以優化製程，逐年更換節能設備為目標，訂立廠	無重大差異

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展 實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		<p>區與辦公室各項節能規範，形成人員節能減碳意識，期望減少溫室氣體的排放總量。</p> <p>(四) 公司於101年度完成GHG溫室氣體排放盤查、重要產品的碳足跡盤查及外部認證機構的查證，並以104年度為基準年。</p> <p>每年度持續執行溫室氣體排放量盤查與查證，公司全廠區 110 年及 111 年溫室氣體排放量分別為 172,579 及 145,485 ton-CO<sub>2</sub>e，其排放密集度分別為 22.51 及 18.82(ton-CO<sub>2</sub>e/百萬營收) (因 112 年溫室氣體排放量尚未經外部認證機構的查證，故未揭露相關數據)，並通過不斷提高資源循環利用，減少溫室氣體排放、廢棄物產生、廢水排放和化學品的使用，以提高製程的生態效益，預計在 119 年達到範疇一溫室氣體排放量較基準年減少 80%之目標。</p> <p>公司全廠區於 111 年及 112 年用水量(包含自來水、井水及回收水)分別為 2,257,780 公噸及 1,683,762 公噸，較前一年度減少 574,018 公噸用水，用水量減量 25.42%。公司全廠區於 111 年及 112 年廢棄物分別為 1,125 公噸(有害廢棄物 573 公噸，非有害廢棄物 552 公噸)及 1,046 公噸(有害廢棄物 449 公噸，非有害廢棄物 597 公噸)，廢棄物密集度分別為 0.146 公噸/百萬營收及 0.164 公噸/百萬營收，較前一年度廢棄物減量 7.1%。</p> <p>我們以 ISO 14001 環境管理系統為基礎並採用了「P-D-C-A」的管理模式，以推動我們於污染防治上持續進步。每年達成節能減碳 1%、廢棄物減量 2%及減少用水 3%之量化管理目標，直至合理可行水位。</p>	

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展 實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	V		<p>(一) 公司為樹立制度，健全組織，保障員工合法權益，特遵照勞動基準法、政府法令、『上市上櫃公司企業社會責任實務守則』及『責任商業聯盟及其行為準則』，訂定工作規則及招募聘僱政策，以作為全體同仁管理與遵守之依據，對求職者或受僱者之招募、甄試、進用、考核、升遷等，不因性別而有差別待遇(但工作性質僅適合特定性別者，不在此限)。本公司不得雇用童工從事工作，招募員工不得有歧視之行為，視實際業務需要而遴用，並以公開甄選方式力求機會均等，使人盡其才為選用原則。新進同仁需先經甄試或審核合格，再依公司新人進用規定，經簽呈核准後正式僱用之。本公司禁用被強迫、抵押、契約約束或非自願勞工，所有的工作必須自願的，並且員工基於適切告知擁有自由離職之權利。本公司承諾營造杜絕騷擾與虐待的工作環境。不得威脅或令其工作人員遭受嚴酷或非人道待遇。</p> <p>112年度RBA責任商業聯盟行為守則訓練(含誠信經營、法律和客戶要求、勞動人權、無不正當利益、公平交易、禁止內線交易等相關宣導)，計1,416人次，共849.6人時。</p>	無重大差異
<p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>	V	<p>(二) 公司已訂定及實施合理員工福利措施，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依規定比例提撥員工酬勞。</p>		

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		<p>本公司員工之薪資報酬，乃依據個人工作績效表現、對公司的貢獻度、職務、職級等因素而訂，與經營績效成果之關聯性成正相關，主要包含基本薪資、津貼、獎金、員工酬勞及福利等。基本薪資主要以員工所擔任職位之同業市場水準及公司政策予以釐薪；津貼部分主要考量工作相關事項；獎金與員工酬勞則是連結員工工作績效、部門目標達成及公司經營成果計算發給；福利項目主要以符合法令規定為前提，並兼顧員工的需求。</p> <p>本公司女性員工超過50%，女性高階經理人占比為14.3%。</p> <p>公司提供優於勞基法的特別休假制度，員工到職滿兩個月即可享有特別休假，方便員工於一年中排定假期。我們並依法給予各種假別，當同仁有請假需求時，能夠更無後顧之憂。此外，員工補助津貼包含婚喪喜慶補助、三節禮券、生日禮券及社團經費補助。</p> <p>(三) 公司每年定期舉辦員工健檢與特殊作業體檢，依法設置駐廠醫師與專任護理師，規劃健康促進活動及配合政府推展防癌、戒菸、傳染病預防等相關活動，以符合員工健康需求，亦提供的良好的職場環境，並獲頒企業健康職場自主認證標章；每月參與全廠環安衛會議，以稽查、追蹤、檢討與改善部門環安衛相關議題，以確保同仁身心健康及防範於未然。</p> <p>112年度廠內職業災害人/次數為6件，共占員工總人數0.4%，針對各項職業災害，皆已完成相關改善措施，詳細內容已揭露於公司網站永續報告書中。112年度火災之件數為零。</p>	

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		(四) 為增進員工工作技能、讓員工快速融入工作環境、改善產品與服務品質、提升組織整體競爭力，本公司透過系統化的訓練藍圖展開教育訓練計畫，讓員工與公司一同成長。 本公司年度訓練計畫包含主管及同仁訓練，112年共舉辦了110個班次的實體訓練課程。	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√		(五) 公司遵循品質系統要求，建有完善之缺陷防範機制及客訴反應系統，配合上下游整套供應鏈檢核機制為消費者層層把關且迅速回應。並秉持誠信正直的理念來對待客戶，以客戶為導向，提供客戶所需的技術、嚴謹的生產、優良的品質和優質的服務。	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	√		(六) 公司在供應商企業社會責任行為準則中有相關規定。並於供應商責任條款中要求供應商之營運應透明、公開，注重股東權益，並努力達到企業的社會責任。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	√		本公司永續報告書依據全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, 簡稱 GRI) 西元 2021 年版及 SASB 準則，並經第三方驗證機構英國標準協會(British Standards Institution, 簡稱 BSI)查證，查證結果符合 AA 1000 保證標準 v3 中度保證等級。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定「永續發展實務守則」，運作情形皆依循永續發展實務守則辦理。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 其他本公司企業永續發展運作情形請參閱本公司網站永續發展專區。 <a href="https://www.xintec.com.tw/chi/Legal/ESG.html">https://www.xintec.com.tw/chi/Legal/ESG.html</a>				

氣候相關資訊執行情形

1、氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</li> <li>2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</li> <li>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</li> <li>4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</li> <li>5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</li> <li>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</li> <li>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</li> <li>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</li> <li>9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 將氣候變遷議題納入公司全面風險管理範疇中，由董事會指派風險管理委員會，制定相關營運目標與計畫，定期執行檢討改善，並向董事會報告氣候變遷相關議題。</li> <li>2. 經由風險管理委員會為核心，由高階主管和各部門代表組成，根據氣候變遷相關財務揭露專案小組(TCFD)發佈的「氣候相關財務揭露建議書」指南，識別和盤點公司營運中潛在的氣候變遷風險、機會和財務影響，依據治理、政策、風險管理、指標和目標四個範疇下揭露相關資訊，並繪製風險機會重大議題矩陣圖，再根據矩陣分析結果，針對重大風險，提交董事會或高階管理階層，討論並制定風險管理策略，作為應對氣候變遷的行動措施。詳細內容請參閱本公司網站之永續報告書。</li> <li>3. 詳細內容請參閱本公司網站之永續報告書。</li> <li>4. 各功能單位除依循董事會所通過的風險管理政策展開外，也結合廠區所建置之氣候行動機制(各項ISO管理系統)，依風險管理步驟整合至營運管理流程。詳細內容請參閱本公司網站之永續報告書。</li> <li>5. 詳細內容請參閱本公司網站之永續報告書。</li> <li>6. 詳細內容請參閱本公司網站之永續報告書。</li> <li>7. 尚未使用內部碳定價作為規劃工具。</li> <li>8. 詳細內容請參閱本公司網站之永續報告書。</li> <li>9. 請參閱下表1-1、1-2。</li> </ol>

## 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

### 1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO<sub>2</sub>e)、密集度(公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

公司全廠區 110 年及 111 年溫室氣體排放量分別為 172,579 及 145,485 ton-CO<sub>2</sub>e，其排放密集度分別為 22.51 及 18.82(ton-CO<sub>2</sub>e/百萬營收)，資料範圍涵蓋精材各廠區之直接排放量與能源間接排放量。

### 1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

110 年溫室氣體排放量由立恩威國際驗證股份有限公司進行查證並於 111 年 5 月 10 日核發查證聲明，其查證範圍包含精材科技中壢廠、中壢二廠及中壢三廠，查證準則依據行政院環境保護署發布之國家溫室氣體登錄平台之相關最新規定，CNS 14064-1 溫室氣體-第 1 部：組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告附指引之規範，確信意見為依據查證者所執行之查證過程與程序，有充分證據顯示精材科技股份有限公司之溫室氣體主張不具實質差異，且係根據協議之查證準則規範的溫室氣體量化、監測與報告的標準予以準備，並公正地呈現溫室氣體數據及相關資訊。

111 年溫室氣體排放量由立恩威國際驗證股份有限公司進行查證並於 112 年 7 月 27 日核發查證聲明，其查證範圍包含精材科技中壢廠、中壢二廠及中壢三廠，查證準則依據溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法(105.01.05)、溫室氣體排放量盤查作業指引(2022.05)等法令規章，行政院環境保護署發布之事業溫室氣體排放量資訊平台之相關最新規定，確信意見為依據查證者所執行之查證過程與程序，有充分證據顯示精材科技股份有限公司之溫室氣體主張不具實質差異，且係根據協議之查證準則規範的溫室氣體量化、監測與報告的標準予以準備，並公正地呈現溫室氣體數據及相關資訊。

### 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

精材科技 2015 年度係首次因法令規範執行盤查溫室氣體排放，故為便利未來盤查工作，故以使用以 2015 年度為基準年，其總排放量為 204,883 tons-CO<sub>2</sub>e，精材設定減碳目標，承諾於 2050 年達成淨零排放，其策略及具體行動如下：

- 1.尾氣削減設備安裝計畫：精材已於 112 年底完成氟類氣體尾氣削減設備安裝計畫，推估可減少 44,000 tons-CO<sub>2</sub>e 碳排放量
- 2.使用再生能源：精材已於 2023 年採購太陽能再生能源憑證，年採購 1,800 千度再生能源，可減少約 900 tons-CO<sub>2</sub>e 碳排放量
- 3.提升能源使用效率：精材每年皆執行各項節能專案，例如汰換高效率照明燈具、汰換節能空調設備及空調溫度調整等節能措施，且部分廠區已通過 ISO 50001 能源管理驗證，以實現每年節能減碳 1%環境管理目標，逐步降低廠區能耗。

## 風險管理策略

面向	風險項目	說明	因應策略
財務風險	匯率變動	本公司營收主要係以美元計價，部分製造成本亦以外幣支付，因此，任何顯著的國際匯率變動均可能對公司損益造成不利之影響。	本公司主要以進貨所產生之應付帳款(外幣負債)與收入所產生之應收帳款(外幣資產)相互沖抵，發揮自然避險之效果，以降低匯率變動風險。同時密切注意匯率趨勢，定期檢視非功能性貨幣計價之資產及負債之部位變化，使用遠期外匯合約等衍生金融工具或買賣即期外匯管理匯率風險，以降低匯率波動對損益的影響。
	利率變動	利率的變動對公司損益影響可分為兩部分，營業外收入部分，約當現金利息收入隨利率上升而增加，利息費用則將因利率上升而增加。	為避免未來利率走高，增加融資成本之不確定性，本公司持續關注利率走勢，未來將視市場狀況及中長期負債部位，決定是否向銀行簽定利率交換交易，以部份規避利率波動之風險，降低升息之不利影響。
	技術開發	半導體業技術發展速度快，客戶需求快速變動，同業間競爭激烈，對於先進製程之需求不斷提高。	1.配合市場以及客戶感應器(Sensor)的新產品技術需求，持續開發晶圓級新的製程技術並購入相關設備，應用於多樣生物辨識感測器、影像感測器、環境光源感測器、微機電(MEMS)、功率場效電晶體等產品，提供包括晶圓級封裝以及中後端晶圓級製程的技術服務。 2.針對 System in package，投入開發 Liquid Molding、through molding via 相關製程以提供多樣性封裝選擇。
	供應商管理	原物料供應商及生產設備有單一供應商之情形，可能造成營運生產之斷料或不穩定之風險。	透過新供應商開發及現有供應商生產及品質系統的稽核，減少單一供應商比例，同時降低現有供應商缺料及品質不穩定風險。
營運風險	業務風險	客戶過於集中。	積極開發多元化的產品與客戶群，以分散業務集中風險。
	法律風險	遵循所有適用的法規。 法令法規修正。	各部門須就其業務範圍內適用之法規進行監控，法務部門亦會不定期至相關網站下載適用法規之最新法律規定，並轉寄給有關單位以利各單位進行風險辨識、評估，訂定策略並為風險處理。
環境風險	氣候變遷	氣候變遷所導致之影響不容小覷，全球隨著溫室氣體排放量日趨益增，溫室效應明顯加劇導致全球暖化，使全球地表平均溫度升高、海洋酸化、冰層消融、海平面上升等顯著環境變遷，影響範圍涵蓋海洋與陸地，全球暖化所引發極端氣候近年來更是頻繁易見，首當其衝者為周遭環境生態遭受破壞，進而甚至可能波及社會經濟活動與人類安全。	1.嚴格遵守法規，定期實施環保法令規定查核，掌握最新法規，依法實施環境檢測與污染防治對策，同時採用 ISO14001 環境管理系統策略，針對環境考量面進行評估並擬定預防措施，藉由定期內、外部稽核與第三方覆核檢視是否符合持續改善之目的，提升員工環境保護意識。 2.引用國際標準 ISO/CNS14064-1 建立、實施及維持溫室氣體盤查管理系統，以掌握更精確的溫室氣體排放現況，有效地執行溫室氣體減量措施，期能落實環境正義並善盡地球公民之責，確保環境永續發展。 3.評估氣候變遷對公司可能帶來之機會與風險，於營運策略規劃和決策過程中納入氣候變遷因子；積極推動綠色製程及各項環保節能減碳措施，評估綠電購買，提升尾氣削減設備安裝率，逐年更換節能設備，並訂立廠區各項節能規範，形成人員節能減碳意識，期望減少溫室氣體的排放總量，以減緩與調適氣候變遷所帶來之營運衝擊。
	水資源	極端型氣候造成水資源匱乏	1.透過回收設備建立與改善，增加水回收次數並減少自來水用量。 2.改善製程用水量，降低生產時對於水的使用量。

面向	風險項目	說明	因應策略
社會風險	員工招募	受限臺灣人口少子化衝擊與半導體產業人力市場需求大於供給，造成人才招募不易。	依據公司營運計畫定期檢視人力需求，結合公立就業服務機關與其他招募管道適時招募合適之人才，並且在符合政府法規按比例聘僱外籍人員，加速補足所需之人力缺口。
	勞動安全	精材公司重視職業安全，認為做好安全與衛生管理是照顧員工及其家庭應有的作為，也是對社區與社會承諾的直接回饋。 公司制定環安衛政策，以風險管理精神為基礎，持續進行改善，杜絕可預見的危險與損失控制，以保障員工安全與健康，並建構良好安全衛生工作環境。	精材所有廠區均取得職業安全衛生管理系統（ISO 45001:2018）及「臺灣職業安全衛生管理系統CNS 45001:2018」驗證通過。透過持續改善安全衛生管理系統，達成預防意外事故、促進員工安全、衛生及保護公司資產的目標。

(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>		<p>(一) 本公司訂有「誠信經營守則」，並在「工作規則」明定所有員工均應清楚了解且遵守從業道德規範及個人誠信，並秉持誠實、嚴謹及敬業之精神執行職務。</p> <p>(二) 本公司「工作規則」規定不得要求、接受或給予任何可能損及忠於職守或專業判斷之餽贈、招待或任何形式的賄賂。</p> <p>(三) 誠信正直係本公司企業文化中最重要核心價值，會於新進員工教育訓練及全體在職員工訓練中宣導，並建立完善的違規懲戒及申訴制度。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專職單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>		<p>(一)本公司與他人簽訂契約時，均儘可能充分了解對方誠信經營情形，並宜將誠信經營納入商業契約中。</p> <p>(二)本公司為健全與落實誠信經營之管理，由人力資源處負責誠信經營政策與行為指南之制定及監督執行，且每年一次向董事會報告。</p> <p>(三)本公司已於「工作規則」明訂應迴避任何可能造成個人利益與公司利益之間的衝突，並完成年度迴避利益衝突申報。董事會各項議案，有利益衝突時，皆依迴避原則，不參與討論，並離席不參與表決。</p> <p>(四)本公司透過建立會計制度及內部控制制度之規範，落實誠信經營理念。內部稽核亦依法遵及風險評估訂定年度稽核計畫，並據以查核以確保各項控制作業之正確性、健全性及有效性，結果並無發現舞弊、不法或違背受託義務等不誠信行為。</p> <p>(五)公司每年均定期舉辦誠信經營之教育訓練，以落實誠信價值，並將重點宣導事項製作宣導DM，宣導於同仁執行業務時應注意。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	√		<p>本公司已於「工作規則」明訂懲戒制度，並於公司網站中載明若有任何人發現本公司員工或利害關係人進行任何疑似或可能違反本公司從業道德之行為時，請務必通知本公司；且此舉報行為，將交由董事長或其指定之高階主管直接進行調查、處理及預防再發之對策，對於檢舉人均予以保密，免於遭受不當之處置。</p>	無重大差異
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p>	√		<p>(一) 已於本公司架設之網站中，揭露公司之經營理念係以誠信/創新/客戶導向為宗旨，並於年報及公開說明書中揭露誠信經營情形。</p>	無重大差異
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定誠信經營守則，與上市上櫃公司誠信經營守則並無差異。</p>				
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：無。</p>				

(八) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：請參閱公開資訊觀測站或至本公司網站查詢。

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：無。

(十) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書：

精材科技股份有限公司  
內部控制制度聲明書

日期：113 年 2 月 6 日

本公司民國 112 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 112 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 113 年 2 月 6 日董事會通過，出席董事六人中，有零人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

精材科技股份有限公司



董事長：陳家湘



簽章

總經理：陳家湘



簽章

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

本公司股東會於112年度至年報刊印日止共召集一次常會，重要決議及執行情形如下：

1.盈餘分配或盈虧撥補：核准111年度盈餘分派案。

執行情形：決議通過。本公司民國111年度稅後淨利為新台幣1,983,736仟元，加列確定福利計劃之再衡量數新台幣4,356仟元後，民國110年度可分配盈餘為新台幣1,988,092仟元，經提撥法定盈餘公積新台幣198,809仟元後，加計以前年度未分配保留盈餘新台幣1,913,566仟元後，期末未分配盈餘為新台幣3,702,849仟元。考量111年獲利、資本預算、中期營運規劃及財務狀況後，擬自111年度可分配盈餘中提撥新台幣814,093仟元，每股分派現金股利新台幣3.0元。其配息基準日訂定為民國112年6月30日。

2.章程修訂：無。

3.營業報告書及財務報表：承認111年度營業報告書及財務報表。

執行情形：承認民國111年度營業報告書及財務報表，其中全年營收為新台幣7,731,797仟元，稅後淨利為新台幣1,983,736仟元，每股淨利為新台幣7.31元。

4.董監事選舉：增選一席獨立董事。

執行情形：當選名單如下：梁明成。

5.其他事項：核准解除新任董事之競業禁止限制

執行情形：決議通過，並已依股東會決議執行完成。

本公司於112年度至年報刊印日止共召開六次董事會，重要決議摘要有：

核准111年度之營業報告書及財務報表、核准本公司111年度員工現金酬勞及董事酬勞與報酬、核准本公司111年度盈餘分派案、核准本公司增選獨立董事1人，並於112年股東常會辦理選舉、核准召集本公司112年股東常會、核准本公司112年度財務計畫、核准本公司修訂「董事會績效評估辦法」、核准本公司修訂「董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法」、核准本公司111年度董事報酬及酬勞及112年度董事報酬及酬勞政策、核准本公司經理人林中安先生之特別獎金案、核准本公司具董事身分之經理人及經理人111年度之績效評估及112年度薪資調整、核准本公司具董事身分之經理人及經理人111年度之員工酬勞、核准本公司具董事身分之經理人及經理人111年度薪資報酬及112年度薪資報酬政策、核准本公司修訂「公司治理實務守則」、核准依據審計品質指標(AQIs)對簽證會計師進行評估，經評估後，勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞與黃裕峰會計師均符合獨立性及適任性要求、核准本公司修訂「永續發展實務守則」、核准本公司民國111年度之「內部控制制度聲明書」、核准梁明成先生為本公司第十屆增選之獨立董事被提名人、核准解除新任獨立董事之競業禁止限制，並提請股東會討論、核准本公司112年度第一季財務報表、核准本公司112年度第二季財務報表、核准本公司修訂「風險管理政策與程序」、核准修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」、核准取得銀行額度、核准本公司112年度第3季財務報表、核准資本支出預算、核准修訂本公司「公司治理實務守則」、核准設置「永續發展指導委員會」、核准113

年度委任勤業眾信聯合會計師事務所簽證服務公費、核准本公司113年度稽核計畫、核准112年度之營業報告書及財務報表、請核准本公司112年度員工現金酬勞及董事酬勞與報酬、核准本公司112年度盈餘分派案、核准召集本公司113年股東常會、核准本公司113年度財務計畫、核准本公司修訂「處理董事所提要求之標準作業程序」、核准本公司修訂「董事會績效評估辦法」、核准本公司112年度董事報酬及酬勞及113年度董事報酬及酬勞政策、核准本公司具董事身份之經理人及經理人之112年特別激勵獎金、核准本公司具董事身分之經理人及經理人112年度之績效評估及113年度薪資調整、核准本公司具董事身分之經理人及經理人112年度之員工酬勞、核准本公司具董事身分之經理人及經理人112年度薪資報酬及113年度薪資報酬政策、核准本公司112年度之「內部控制制度聲明書」。

(十三) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十四) 最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

#### 五、簽證會計師公費資訊：

(一) 給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名		會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	蔡美貞	黃裕峰	112年度	2,380	690	3,070	

註：本年度非審計公費為稅務簽證590仟元、覆核年報80仟元及出具非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表20仟元。

(二) 更換會計師事務所且更換年度給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無。

六、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更換日期	不適用		
更換原因及說明	不適用		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師
	情況		委任人
	主動終止委任		不適用
不再接受(繼續)委任			
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	√	
說明	無		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	不適用
會計師姓名	不適用
委任之日期	不適用
就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三) 前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	112 年 度		113 年 度 截 至 4 月 1 日 止	
		持 有 股 數 增 ( 減 ) 數	質 押 股 數 增 ( 減 ) 數	持 有 股 數 增 ( 減 ) 數	質 押 股 數 增 ( 減 ) 數
董 事	台灣積體電路製造股份有限公司	0	0	0	0
	代表人-陳家湘	0	0	0	0
	代表人-汪業傑	0	0	0	0
獨立董事	王文宇	0	0	0	0
獨立董事	謝徽榮	0	0	0	0
獨立董事	溫環岸	0	0	0	0
獨立董事	梁明成(註1)	0	0	0	0
總 經 理	陳家湘	0	0	0	0
副總經理	朱美彥	0	0	0	0
副總經理	林恕敏	0	0	0	0
協 理	劉滄宇	0	0	0	0
協 理	范振梅	0	0	0	0
協 理	馬中文	0	0	0	0
處 長 暨 公 司 治 理 主 管	周正德	0	0	0	0
大 股 東	台灣積體電路製造股份有限公司	0	0	0	0

註 1：112/5/29 選任為獨立董事。

(二) 股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三) 股權質押之相對人為關係人者：無。

九、持股比例占前十名股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

113年4月1日；單位：千股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	名稱	關係	
台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：劉德音	111,282	41.01	0	0	0	0	無	無	
何宗翰	2,700	0.99	0	0	0	0	無	無	
湯文萬	2,482	0.91	0	0	0	0	無	無	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	2,166	0.80	0	0	0	0	無	無	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	2,095	0.77	0	0	0	0	無	無	
莊明郎	1,742	0.64	0	0	0	0	無	無	
渣打國際商業銀行營業部受託保管 ISHARES 核心 MSCI 新興市場 ETF 投資專戶	1,551	0.57	0	0	0	0	無	無	
花旗託管 DFA 新興市場核心證券投資專戶	1,106	0.41	0	0	0	0	無	無	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進信託公司法人完全國際股票市場指數信託 II 投資專戶	1,074	0.40	0	0	0	0	無	無	
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	796	0.29	0	0	0	0	無	無	

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：不適用。

## 肆、募資情形

### 一、股本來源

單位：新台幣仟元；千股 113年4月1日

年/月	發行價格 新台幣 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款 者(仟元)	其他
87/9	10	64,000	640,000	28,000	280,000	創立 216,000	技術股 64,000	87/9/11 經(○八七)商字第 087127301 號核准在案
88/7	10	64,000	640,000	43,250	432,500	現增 152,500	無	88/7/26 經(○八八)商字第 088127212 號核准在案
89/9	10	64,000	640,000	55,000	550,000	現增 117,500	無	89/9/20 經(○八九)商字第 089134667 號核准在案
91/8	12	64,000	640,000	64,000	640,000	現增 90,000	無	91/8/19 經授商字第 09101336780 號核准在案
92/3	12	88,000	880,000	73,000	730,000	現增 90,000	無	92/3/19 經授商字第 09201078970 號核准在案
92/4	11	88,000	880,000	83,000	830,000	現增 100,000	無	92/4/30 經授商字第 09201130010 號核准在案
92/9	15	120,000	1,200,000	103,000	1,030,000	現增 200,000	無	92/9/1 經授商字第 09201260090 號核准在案
92/12	20	120,000	1,200,000	115,000	1,150,000	現增 120,000	無	92/12/4 經授商字第 09201327560 號核准在案
95/4	10	120,000	1,200,000	120,000	1,200,000	現增 50,000	無	95/4/10 經授商字第 09501063960 號核准在案
95/7	-	180,000	1,800,000	120,000	1,200,000	核定股本變更	無	95/7/4 經授商字第 09501131570 號核准在案
96/2	15	260,000	2,600,000	210,526	2,105,260	私募現增 905,260	無	96/2/16 經授商字第 09601036790 號核准在案
96/8	-	260,000	2,600,000	215,739	2,157,391	盈餘轉增資： 27,368 員工紅利轉增資： 24,763	無	96/8/6 經授商字第 09601184170 號核准在案
97/7	-	260,000	2,600,000	221,279	2,212,794	盈餘轉增資： 21,574 員工紅利轉增資： 33,829	無	97/7/24 經授商字第 09701180530 號核准在案
97/11	-	260,000	2,600,000	221,909	2,219,091	行使員工認股權 憑證 6,297	無	97/11/27 經授商字第 09701302390 號核准在案
98/3	-	260,000	2,600,000	222,225	2,222,251	行使員工認股權 憑證 3,160	無	98/3/30 經授商字第 09801056560 號核准在案
98/6	-	260,000	2,600,000	222,660	2,226,601	行使員工認股權 憑證 4,350	無	98/6/26 經授商字第 09801127190 號核准在案
98/7	-	260,000	2,600,000	224,629	2,246,289	盈餘轉增資：11,111 員工紅利轉增資： 8,577	無	98/7/22 經授商字第 09801153270 號核准在案
98/9	-	260,000	2,600,000	225,533	2,255,327	行使員工認股權 憑證 9,038	無	98/9/9 經授商字第 09801206430 號核准在案
98/12	-	260,000	2,600,000	225,766	2,257,657	行使員工認股權 憑證 2,330	無	98/12/18 經授商字第 09801290970 號核准在案
99/4	-	260,000	2,600,000	226,529	2,265,287	行使員工認股權 憑證 7,630	無	99/4/8 經授商字第 09901068120 號核准在案

年/月	發行價格 新台幣 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款 者(仟元)	其他
99/7	-	260,000	2,600,000	227,275	2,272,746	行使員工認股權 憑證 7,459	無	99/7/16 經授商字第 09901144980 號核准在案
99/9	-	260,000	2,600,000	227,367	2,273,666	行使員工認股權 憑證 920	無	99/9/2 經授商字第 09901200650 號核准在案
99/12	-	260,000	2,600,000	227,968	2,279,684	行使員工認股權 憑證 6,018	無	99/12/6 經授商字第 09901271820 號核准在案
100/4	-	260,000	2,600,000	228,561	2,285,607	行使員工認股權 憑證 5,923	無	100/4/11 經授商字第 10001069460 號核准在案
100/7	-	260,000	2,600,000	229,026	2,290,265	行使員工認股權 憑證 4,658	無	100/7/1 經授商字第 10001142280 號核准在案
100/8	-	260,000	2,600,000	233,256	2,332,557	盈餘轉增資: 22,883 員工紅利轉增資: 19,410	無	100/8/10 經授商字第 10001184920 號核准在案
100/9	-	260,000	2,600,000	233,396	2,333,962	行使員工認股權 憑證 1,405	無	100/9/6 經授商字第 10001207740 號核准在案
100/12	-	260,000	2,600,000	233,579	2,335,794	行使員工認股權 憑證 1,831	無	100/12/2 經授商字第 10001274670 號核准在案
101/4	-	260,000	2,600,000	233,581	2,335,811	行使員工認股權 憑證 17	無	101/4/2 經授商字第 10101055600 號核准在案
101/6	-	260,000	2,600,000	233,785	2,337,846	行使員工認股權 憑證 2,035	無	101/6/27 經授商字第 10101120250 號核准在案
101/7	-	260,000	2,600,000	236,121	2,361,209	盈餘轉增資: 23,363	無	101/7/30 經授商字第 10101155880 號核准在案
101/9	-	260,000	2,600,000	236,153	2,361,526	行使員工認股權 憑證 317	無	101/9/13 經授商字第 10101188740 號核准在案
101/12	-	260,000	2,600,000	236,205	2,362,046	行使員工認股權 憑證 520	無	101/12/12 經授商字第 10101253820 號核准在案
102/4	-	260,000	2,600,000	236,208	2,362,079	行使員工認股權 憑證 33	無	102/04/01 經授商字第 10201058510 號核准在案
102/8	-	260,000	2,600,000	236,267	2,362,667	行使員工認股權 憑證 588	無	102/08/06 經授商字第 10201152570 號核准在案
102/8	-	260,000	2,600,000	236,290	2,362,896	行使員工認股權 憑證 229	無	102/08/30 經授商字第 10201179150 號核准在案
102/12	-	260,000	2,600,000	236,371	2,363,714	行使員工認股權 憑證 818	無	102/12/11 經授商字第 10201249330 號核准在案
103/3	-	260,000	2,600,000	236,402	2,364,019	行使員工認股權 憑證 305	無	103/03/28 經授商字第 10301053810 號核准在案
103/7	-	260,000	2,600,000	236,474	2,364,739	行使員工認股權憑 證 720	無	103/7/8 經授商字第 10301136750 號核准在案
103/9	-	260,000	2,600,000	236,481	2,364,814	行使員工認股權憑 證 75	無	103/9/4 經授商字第 10301184300 號核准在案
103/12	-	260,000	2,600,000	238,051	2,380,508	行使員工認股權憑 證 15,694	無	103/12/5 經授商字第 10301253830 號核准在案
104/3	-	260,000	2,600,000	238,121	2,381,207	行使員工認股權憑 證 699	無	104/3/6 經授商字第 10401033070 號核准在案
104/4	42	300,000	3,000,000	268,121	2,681,207	現增 300,000	無	104/4/15 經授商字第 10401064200 號核准在案
104/6	-	300,000	3,000,000	268,427	2,684,265	行使員工認股權憑 證 3,059	無	104/6/8 經授商字第 10401105400 號核准在案

年/月	發行價格 新台幣 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款 者(仟元)	其 他
104/12	-	300,000	3,000,000	268,768	2,687,680	行使員工認股權憑證 3,414	無	104/12/2 經授商字第 10401254910 號核准在案
105/3	-	300,000	3,000,000	268,876	2,688,761	行使員工認股權憑證 1,082	無	105/3/3 經授商字第 10501040250 號核准在案
105/5	-	300,000	3,000,000	269,195	2,691,948	行使員工認股權憑證 3,187	無	105/5/31 經授商字第 10501108730 號核准在案
105/11	-	300,000	3,000,000	269,590	2,695,901	行使員工認股權憑證 3,953	無	105/11/30 經授商字第 10501277360 號核准在案
106/3	-	300,000	3,000,000	269,853	2,698,534	行使員工認股權憑證 2,633	無	106/3/16 經授商字第 10601032450 號核准在案
106/3	-	300,000	3,000,000	271,353	2,713,534	發行限制員工權利新股 15,000	無	106/3/30 經授商字第 10601037310 號核准在案
106/6	-	300,000	3,000,000	272,149	2,721,493	行使員工認股權憑證 7,959	無	106/6/2 經授商字第 10601069300 號函
106/8	-	300,000	3,000,000	272,109	2,721,093	行使員工認股權憑證 1,480, 註銷限制員工權利新股 1,880	無	106/8/17 經授商字第 10601111270 號函
106/11	-	300,000	3,000,000	271,919	2,719,193	註銷限制員工權利新股 1,900	無	106/11/28 經授商字第 10601158830 號函
107/2	-	300,000	3,000,000	271,695	2,716,949	註銷限制員工權利新股 2,244	無	107/2/22 經授商字第 10701019760 號函
107/8	20	300,000	3,000,000	271,795	2,717,949	發行限制員工權利新股 1,000	無	107/8/22 經授商字第 10701106860 號
108/3	20	300,000	3,000,000	271,744	2,717,441	發行限制員工權利新股 2,000, 註銷限制員工權利新股 2,508	無	108/3/15 經授商字第 10801026540 號函
108/6	-	400,000	4,000,000	271,744	2,717,441	變更額定股本	無	108/6/18 經授商字第 10801072960 號函
108/8	-	400,000	4,000,000	271,723	2,717,225	註銷限制員工權利新股 216	無	108/8/26 經授商字第 10801115200 號函
109/3	-	400,000	4,000,000	271,364	2,713,643	註銷限制員工權利新股 3,582	無	109/3/12 經授商字第 10901031500 號函

單位：股 113年4月1日

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	271,364,316	128,635,684	400,000,000	

## 二、股東結構

單位：股 113年4月1日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個 人	外國機構 及 外 人	合 計
人 數	4	25	115	43,158	148	43,450
持有股數	1,022,810	1,371,745	114,012,892	133,567,086	21,389,783	271,364,316
持股比例	0.38%	0.51%	42.01%	49.22%	7.88%	100.00%

註：本公司無陸資持股。

### 三、股權分散情形

113年4月1日

持 股 分 級	股 東 人 數	持 有 股 數	持 股 比 例(%)
1 至 999	6,995	1,285,166	0.47
1,000 至 5,000	32,004	57,987,208	21.37
5,001 至 10,000	2,604	20,383,663	7.51
10,001 至 15,000	673	8,678,450	3.20
15,001 至 20,000	429	7,937,054	2.92
20,001 至 30,000	295	7,570,609	2.79
30,001 至 40,000	125	4,546,597	1.68
40,001 至 50,000	82	3,821,468	1.41
50,001 至 100,000	134	9,456,711	3.48
100,001 至 200,000	53	7,484,098	2.76
200,001 至 400,000	34	9,034,686	3.33
400,001 至 600,000	10	4,763,212	1.76
600,001 至 800,000	3	2,217,530	0.82
800,001 至 1,000,000	0	0	0.00
1,000,001 以上	9	126,197,864	46.50
合 計	43,450	271,364,316	100.00

### 四、主要股東名單

(股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比率佔前十名之股東名稱、持有股數及比例)

單位：股 113年4月1日

主 要 股 東 名 稱	持 有 股 數	持 股 比 例
台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：劉德音	111,281,925	41.01
何宗翰	2,700,000	0.99
湯文萬	2,482,000	0.91
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光 基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基 金投資專戶	2,165,714	0.80
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集 團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投 資專戶	2,095,225	0.77
莊明郎	1,742,000	0.64
渣打國際商業銀行營業部受託保管 ISHARES 核心 MSCI 新興市場 ETF 投資專戶	1,551,000	0.57
花旗託管 DFA 新興市場核心證券投資專戶	1,106,000	0.41
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進信託 公司法人完全國際股票市場指數信託 II 投資專 戶	1,074,000	0.40
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行 投資專戶	796,000	0.29

五、最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元；千股

項 目		年 度		當年度截至 113年4月1日	
		111年	112年		
每股 市價	最 高	152.50	148.50	138.00	
	最 低	85.10	95.40	120.00	
	平 均	123.84	124.19	126.90	
每股 淨值	分 配 前	27.23	29.31	-	
	分 配 後	24.23	27.31(註 1)	-	
每股 盈餘	加權平均股數	271,364	271,364	-	
	每股盈餘	7.31	5.07	-	
每股 股利	現 金 股 利	3.0	2.0(註 1)	-	
	無 償 配 股	盈餘配股	-	-	-
		資本公積配股	-	-	-
	累 積 未 付 股 利	-	-	-	
投資報 酬分析	本益比	16.94	24.50	-	
	本利比	41.28	62.10(註 1)	-	
	現金股利殖利率	2.42%	1.61%(註 1)	-	

註 1：尚待 113 年度股東會決議分配

六、公司股利政策及執行狀況

(一) 股利政策說明：

公司股利政策係依據本公司營運狀況、資金需求、資本支出預算、內外部整體環境變化並兼顧股東利益，由董事會予以訂定，在無其它特殊情況考量下，以當年度稅後盈餘 35%~85% 為分派原則。

本公司章程第廿七條內容如下：

本公司年度決算如有盈餘，應先依法完納稅捐，彌補累積虧損後，次提撥百分之十為法定盈餘公積，如法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，得不提列，其餘再依法令或主管機關規定應提列及迴轉特別盈餘公積後；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議分派之。

本公司章程第廿七條之一內容如下：

本公司股利發放政策係依據公司資本預算、中長期營運規劃及財務狀況，依下列原則經股東會決議後分派之：

1. 公司得依財務、業務及經營面等因素之考量將當年度可分配盈餘全數分派。盈餘之分派得以股票股利或現金股利之方式為之，但因本公司目前正處於營運成長期，未來將視擴充計劃及投資資金之需求，於分派當年度可分配盈餘時，現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之五十。

2.於當年度公司無盈餘可分派，或雖有盈餘但盈餘數額遠低於公司前一年度實際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或一部依法令或主管機關規定分派。

(二) 本次股東會擬議股利分配之情形：

盈餘分配議案業經 113 年 2 月 6 日董事會決議分派現金股利 542,728,632 元(每股 2.0 元)。

七、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

八、員工、董事及監察人酬勞：

(一) 本公司章程第廿七條內容如下：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞，且董事酬勞給付之對象不包括擔任本公司經理人之董事，員工酬勞及董事酬勞應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依規定比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

(二) 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司 112 年度估列員工酬勞 227,024 仟元、董事酬勞 1,980 仟元及董事報酬 3,566 仟元，係依稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之利益為基礎按一定比率估列。若上述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

(三) 董事會通過分派酬勞情形：

1.以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

113 年 2 月 6 日董事會決議通過員工酬勞 227,024 仟元、董事酬勞 1,980 仟元及董事報酬 3,566 仟元，與認列費用年度估列金額並無差異。

2.以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

本期無擬議配發員工股票酬勞之情事，故不適用。

(四) 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際配發情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司 111 年度配發員工酬勞 324,207 仟元及董事酬勞 1,680 仟元，實際配發情形與估列之費用並無差異。

九、公司買回本公司股份情形：無。

十、公司債、特別股、海外存託憑證及併購或受讓他公司股份發行新股情形：無。

十一、員工認股權憑證辦理情形：無。

十二、限制員工權利新股：無。

十三、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

十四、資金運用計畫執行情形：無。

## 伍、營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍

##### 1. 所營業務之主要內容及其營業比重：

單位：新台幣仟元

項 目	112 年度營業額	營 業 比 重 (%)
晶圓級尺寸封裝	4,178,957	65.43
晶圓測試	1,700,493	26.62
晶圓級後護層封裝	428,283	6.71
其 他	79,135	1.24
合 計	6,386,868	100.00

##### 2. 公司目前之服務項目：

###### (1) 目前服務項目：

###### a. 晶圓級尺寸封裝 (Wafer Level Chip Scale Packaging)

- 影像感應器 (Image Sensor)
- 光學感應器 (Optical Sensor)
- 慣性感測器 (IMU)
- 新型生物辨識器 (Biometric Sensor)

###### b. 晶圓級後護層封裝 (Wafer Level Post Passivation Interconnection)

- 3D 後護層互連 (3D Post Passivation Interconnection)
- 指紋辨識器 (Finger Print Sensor)
- 微機電系統 (MEMS)

###### c. 晶圓級測試 (Wafer Level Chip Probing Test)

- 300mm 晶圓測試 (300mm Wafer CP Testing)

###### (2) 計劃開發之新服務：

- 開發新的晶圓級封裝技術應用於手機、筆記型電腦、個人行動電子裝置、穿戴式裝置、先進駕駛輔助系統、汽車環景安全、倒車影像、安全監測裝置、醫療、健康科技及光學影像感測器、AR/VR 裝置等。
- 供應晶圓級封裝測試技術及資源，應用於各類輕薄短小之消費性電子、電腦、通訊、資訊電子、光學元件、各類微機電系統、環境、氣壓元件製造及 IoT (物聯網)。
- 應用晶圓級封裝技術，提供微機電系統、射頻元件、功率元件與指紋辨識器、新型生物辨識器的封裝服務。

## (二) 總體經濟環境

依據聯合國報告 World Economic Situation and Prospects(WESP)report 2024 (2024 世界經濟形勢與展望)，預計全球經濟增長將從 2023 年的 2.7%放緩到 2024 年的 2.4%，主要原因是高利率、投資減少及就業市場的疲軟，儘管全球通膨率預估從 2023 年的 5.7%降到 2024 年的 3.9%，但是高利率、地緣衝突升級、國際貿易低迷及氣候災害日益增多，仍對全球經濟成長構成重大挑戰。

就台灣經濟研究院的觀察，美國的零售銷售在 2023 年底表現強勁，製造業景氣已出現好轉。歐元區在 12 月經濟信心指數已連續三個月回升。中國的固定資產投資增速仍受到房地產景氣低迷拖累，但工商業活動持續復甦。日本製造業景氣繼續呈現下跌趨勢，但服務業景氣則出現小幅成長。

## (三) 產業概況

### 1. 產業之現況與發展

#### (1) 半導體產業分析及機會

##### a. 全球半導體市場

根據 Gartner 數據顯示，2023 年全球半導體市場規模約為 5,340 億美元，年衰退 10.9%。疲軟的原因來自於終端需求正從消費者蔓延至企業，造成不確定的投資環境。而晶片供過於求導致庫存增加、價格下降，晶圓廠產能利用率表現不如以往，導致 2023 年全球半導體市場呈現衰退態勢。然而全球半導體市場將在 2024 年恢復成長趨勢，主要是由於人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)及電動化等需求帶動下，年成長率 16.8%，市場規模有望到達 6,240 億美元。

##### b. 汽車半導體市場(ADAS(高級駕駛輔助系統)和資訊娛樂系統)

依據工研院 IEK 產業情報網的資訊，2023 年全球晶片荒緩解及疫情降溫帶動汽車整車銷量成長 6.1%，回到 8500 萬輛水平，前五大車市的中國、美國、印度、日本、德國均有望成長。前三大品牌集團占比均小幅下滑，比亞迪進入前 10。全球電動車銷量在價格逐漸親民下呈成長態勢，電動車預計突破 2000 萬輛，占比估計超過 23%。

智慧化和電動化是半導體汽車市場的成長主因。據 IDC media center 的報導，ADAS 到 2027 年複合年增長率(CAGR)為 19.8%，資訊娛樂的 CAGR 則為 14.6%，然而中國地區電動車爆發式成長是否能夠持續，世界其他地區(如歐美)是否保護主義抬頭則有待觀察。

##### c. 先進封裝市場

依據 IEK 產業情報網 2023 年第三季全球 IC 封測業現況與展望報告，半導體市場捎來反轉訊息，大部份 IC 業者存貨天數開始下降，庫存調整將告一段落，雖然 2023 年封測廠第三季傳統旺季效應不顯著，然而車用與特定消費電子領域需求回暖，預估將帶動產值上調。但由於前半年的庫存積壓，預估全球 IC 封測產業在 2023 全年產值將下滑至 374.5 億美元，年減 12.1%。

據 Yole 報告 Status of the advanced package 2023，先進封裝產業的市值在 2022 年為 443 億美元，預計到 2028 年將超過 780 億美元，複合年增長率為 10%，

在封裝技術方面，市場的主要貢獻者是 flip chip (覆晶封裝)、2.5D/3D 和 SiP(系統級封裝)，預計到 2028 年，這三樣技術的市佔率合計將超過 90%。

據 IDC media center 的報導，2.5/3D 封裝市場從 2023 年到 2028 年將以 22% 的複合年增長率成長，它成為封裝市場的成長主力。

此外，隨著各種新型應用的增加，半導體在異質整合封裝應用更加廣泛。它有助於在更小的空間內結合多款元件，促進效能、減少功耗及成本降低。在高階消費晶片，高速運算晶片的應用領域，Chiplet(小晶片)異質整合與先進的封裝技術，將提供更佳的可靠性及效能。

## (2) 半導體產業發展面臨之挑戰

### a. 半導體轉向去全球化，人才缺口短期難補足

美國前總統川普上任之後，對中國半導體進行的管制措施，在疫情之後更逐漸由自由貿易，進入去全球化的時代。各國用國家安全角度重新審視重要經濟產業，要求在地化生產，近岸生產或是友岸生產，包括美國、日本、歐洲均有打造晶圓廠的計劃，然而各國半導體人才均不足以應付大量新建的工廠，這將影響新建晶圓廠的量產進度。

### b. 美中貿易戰所引發的地緣政治

據 DIGITIMES Research 的資訊，台灣與中國業者在數位與類比 IC 產品線高度重疊，尤其在數位 IC 領域，中國晶圓製造業者在成熟製程的中低階產品價格比台廠更有競爭力；至於類比 IC，台灣業者在中低階產品已難與中國業者競爭。伴隨中國業者受到地緣政治壓力，中國半導體自主化力道增加，將促使中國電子供應鏈採用中國半導體的比例持續提升。

在晶圓製造部分，美國持續提升對中國半導體出口管制，拖延中國在半導體製造技術的發展步調，但也陸續出現中國半導體業者逐漸突破美國封鎖，實現先進半導體生產的零星案例，隱含中國半導體技術持續發展。

在封裝技術部分，台廠於扇外型(Fanout)、2.5D/3D 等先進封裝技術仍具有競爭優勢，不過中國業者也已開始佈局相關技術。至於晶圓級晶片尺寸封裝(Wafer Level Chip Scale Package；WL CSP)、覆晶封裝(Flip Chip)及其他傳統封裝技術部分，在中國業者低價競爭下，中國業者將在中低階 IC 封裝市場佔有優勢。因此台廠仍需持續加強發展封裝技術，擴大領先優勢。

### c. 地緣衝突影響

儘管全球物價都有緩漲態勢，也稍抑制原物料價格上漲，不過東歐及中東戰事仍未落幕，再加上紅海風波，這些衝突因素都可能再次影響大宗商品和能源價格，並阻礙全球運輸路線。按照經合會與聯準會預測，美國 2024 年成長率將低於 2023 年，原因就是高利率環境持續衝擊消費和投資，加上中東、東歐和非洲等地的極端衝突。

## (3) 結論

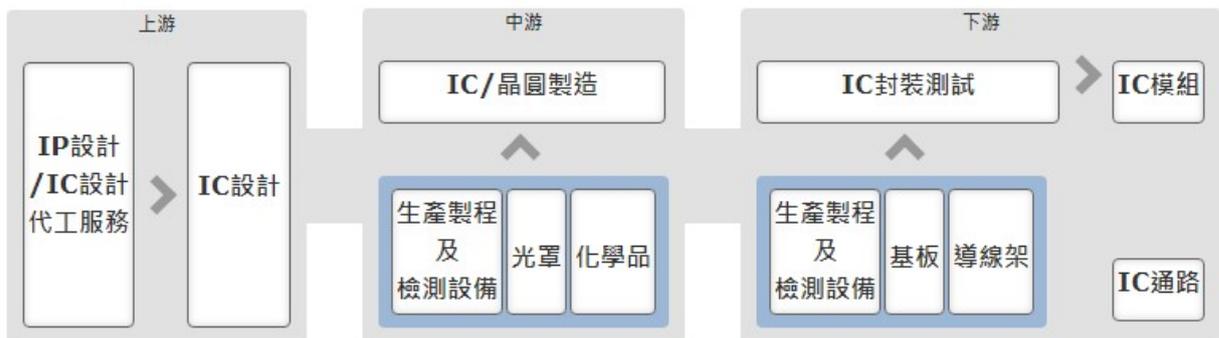
整體而言，全球半導體供應鏈近幾年均受到中美貿易戰、新冠疫情、東歐及中東戰事等長期因素影響下，半導體已和地緣政治密不可分，無獨有偶，烏俄、美中衝突

亦只是地緣政治的冰山一角，市場憂俄羅斯打開潘朵拉盒子後，軍事競賽、經濟落差、政治角力等都可成為保護主義的藉口，進而影響總體經濟的需求與成本，造成經濟趨緩。瑞銀於 2024 年 1 月的 2024 全球經濟與台灣產業趨勢媒體分享會指出，全球經濟成長率 2024 年將會減緩，但台灣受惠科技產業成長，將在 2024 年加速反彈，而半導體產業將迎接溫和復甦。瑞銀經濟研究團隊預測，全球經濟成長率 2024 年將會減緩到 2.7%，美國經濟甚至可能進入衰退期；亞洲經濟成長預估從去年的 5.15% 下滑到 4.7%，中國也會下滑，但台灣的經濟成長會在 2024 年加速，預估從 2023 年的 1.1%，今年快速反彈到 3.1%。預計今年將出現溫和反彈，個人電腦(PC)、智慧型手機、傳統伺服器經歷去年的下滑後，今年趨向穩定，預估 Android 智慧型手機的表現會比 iPhone 好，而 AI 雲端伺服器的需求仍大於供應，邊緣設備將推升新一代 AI 運算，成為未來幾年的成長主軸，全球經濟有望回溫。

國泰世華銀行於 2023 年 12 月 18 日針對 2024 年度全球經濟與市場展望發表最新看法也指出回溫速度取決於三大指標，一、消費性電子產業是否有機會迎來換機潮帶來的成長動能；二、中國經濟復甦動能偏緩，傳統產業要走出陰霾仍有待時日；三、貨幣緊縮政策的後座力，恐使政府和企業面臨較沉重的背債壓力。

## 2. 產業上、中、下游關聯

半導體產業鏈上游為 IP 設計及 IC 設計業，中游為 IC 製造、晶圓製造、相關生產製程檢測設備、光罩、化學品等業，下游為 IC 封裝測試、相關生產製程檢測設備、零組件（如基板、導線架）、IC 模組、IC 通路等業。台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，IC 設計公司在產品設計完成後，委由專業晶圓代工廠或 IDM 廠（整合型半導體廠，從 IC 設計、製造、封裝、測試到最終銷售都一手包辦）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給專業封裝廠進行切割及封裝，最後由專業測試廠進行後段測試，測試後之成品則經由銷售管道售予系統廠商裝配生產成為系統產品。



半導體產業鏈

在後摩爾定律時代，IC 產品的複雜度已難由單一半導體技術節點所實現。對 IC 設計業者而言，並不是每一個 IP 都能縮小技術節點。不同技術節點的 IP 或設計要混合使用，像系統單晶片（SOC）就是其中一種方法。但有時候因為不同節點成熟度不一，把不同技術的電路集合在同一顆晶片上不只成本上並不具優勢，連良率都會有影響；系統級封裝（SiP）為解決此問題而應運而生。產品 owner 可以把不同專長 design house 設計的 IC 運用 SiP 整合成同一個封裝。這種整合的彈性不只可以跨技術節點，甚至可以跨

平台，把矽基材的IC與非矽基材的元件（例如III-V族或被動元件）整合在一起，開創無限可能。

這種封裝的興起，讓介於前段（Front-End）和後段（Back-End）製程之間的中段（Mid-End）製程平台擴大，除了過往所知的晶圓凸塊技術（Wafer Bumping）、晶圓級封裝（Wafer Level Package），如扇外型晶圓級封裝技術（Fan-out Wafer Level Package, FOWLP）、晶圓級尺寸封裝（Wafer Level Chip Scale Package, WL CSP）、3D WLP、WL Optics 及 3D IC 等技術型態外，還能混合這些技術以客製化各種形式的SiP。本公司為專業晶圓層級封裝之領導者，也是第一家將三維晶圓層級封裝技術商品化的公司。

三維晶圓層級封裝技術可應用到各種不同的市場領域，包括消費性電子、通訊、可攜式電腦和汽車等。產品應用包括影像感測器、光學感測器、電源管理積體電路、功率分離式元件、類比積體電路、混合信號積體電路、微機電系統感測器、各項生物辨識晶片(如:指紋辨識器)和整合式被動元件等。

鑒於高階封裝製程的需求，如覆晶封裝（Flip Chip BGA or Flip Chip CSP）、晶圓層級封裝（Wafer Level CSP）、銅打線（Cu Wire Bond）、銅柱凸塊（Cu Pillar）等。尤其是在未來 2.5D/ 3D IC 整合矽穿孔（Through Silicon Via TSV）技術，晶圓層級封裝服務將持續在各相關的應用產品繼續扮演關鍵性角色。

### 3. 競爭情形：

本公司之主要產品為影像感測器、新型生物辨識器、指紋辨識器、微機電及電源控制元件之晶圓層級封裝，目前主要競爭對手如下：

主要產品	主要晶圓級封裝競爭對手
影像感測器/指紋辨識器	晶方、華天科技

### （四）技術及研發概況

#### 1. 最近年度及截至年報刊印日止之研究發展費用

單位：新台幣仟元

項目	年度	112 年度	截至 113 年 3 月 31 日止
研發費用		369,092	88,922
營業收入淨額		6,386,868	1,443,973
占當年度營業額比重(%)		5.78%	6.16%

#### 2. 所營業務之技術層次與研究發展

- (1) TSV(矽穿孔封裝)封裝技術：成功導入 CIS(CMOS Image Sensor)產品量產，並應用於 MEMS 等相關封裝製程且已完成封裝驗證導入量產。
- (2) CIS-CSP 製程改善技術：導入車規影像封裝產品，已完成車規封裝驗證導入量產。
- (3) 導入特殊光學鍍層玻璃，並應用於各式先進光學感測器。
- (4) 開發厚銅製程，成功應用於整合式被動元件產品及射頻元件產品。
- (5) 導入紅外線鍍層玻璃，並應用於手機之先進光學感測器元件。

- (6) 新一代改良矽穿孔封裝(TSV CSP)晶圓級封裝技術研發。
- (7) 開發 GaN 功率元件封裝製程，已完成客戶打樣樣品。
- (8) 新一代生物辨識感測器封裝製程開發完成，通過可靠度測試並量產。
- (9) 利用核心技術開發應用於客戶 IR sensor 特殊需求之 Si 載板蓋，並完成客戶打樣進入可靠度測試階段。
- (10) 持續利用核心 TSV 技術，搭配 Cu 導線技術啟動 12 吋封裝平台建立。未來可應用於 CIS、MEMS 等相關領域。
- (11) 截至 112 年底，本公司已取得 275 件台灣專利、203 件大陸專利、8 件日本專利、1 件德國專利及 268 件美國專利。於 112 年度，本公司新取得之專利數為：台灣專利數 9 件，中國專利數 1 件，美國專利數 5 件。

### 3. 最近年度成功開發之技術或產品

年度	研發成果	主要功能/效益
111	1. 開發 MEMS 第二代產品封裝方式，通過客戶測試進入試產階段。 2. 將 8 吋 TSV 銅導線技術，應用於環境感測器產品封裝	1. 搭配 module house 的打線封裝技術，可應用於麥克風、揚聲器等領域。 2. 產品可應用於手錶、手機等環境光源偵測
112	發展 Glassless CIS 封裝方式，成功提供客戶樣品	產品可應用於 AR/VR 相關應用

### (五) 長、短期業務發展計劃

因應市場快速變化及國內外同業競爭壓力不斷加劇，本公司特擬訂長、短期計畫如下：

#### 1. 短期計畫：

##### (1) 建立以客戶導向之專業封裝服務，強化顧客滿意度

提升本公司客戶值得信賴的高品質服務，以更快、更好的技術與服務，滿足客戶的需求；並在晶圓級製程平台上提供更多樣的封裝技術，以因應多元化產品的需求。

##### (2) 加強上、中、下游產業鏈之合作

先進製程需求越來越高，上、中、下游之合作與整合是先進高階製程能否成功之重要關鍵，精材科技致力與晶圓代工業者及測試大廠共同策略聯盟，並與國際整合元件製造大廠之技術合作開發，致力於成為先進晶圓級尺寸封裝技術服務之領導廠商。

##### (3) 健全公司經營體質，以職能為培育核心，提昇管理及經營績效

透過教育訓練達成公司經營策略目標，以提升管理及技術專業為訴求，有效發揮職能作為培育核心，並以改善工作成效為導向，進一步提升員工工作效率，使公司能因應環境的快速變化與不斷的挑戰。

## 2. 中長期計劃：

### (1) 注重客戶與供應商長期合作發展關係

強調與上下游廠商的長期合作，在產業專業分工的趨勢中，本公司將成為客戶信賴的封裝加工廠，提供客戶需要的品質與服務，同時也與供應商建立良好的合作關係。

### (2) 加強研發創新能力

致力於衍生製程與新製程之研究發展，如先進 3D 晶圓層級堆疊之應用、新生物辨識產品之應用、矽晶圓連接之載板、各種微機電產品之應用等。產品之類別將從消費、汽車、電腦等擴展至監控、醫療等電子產業。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1. 主要商品銷售地區

單位：新台幣仟元

地 區 \ 年 度	112年度	
	金 額	%
亞 洲	5,377,139	84
美 國	978,623	15
歐 洲	31,106	1
合 計	6,386,868	100

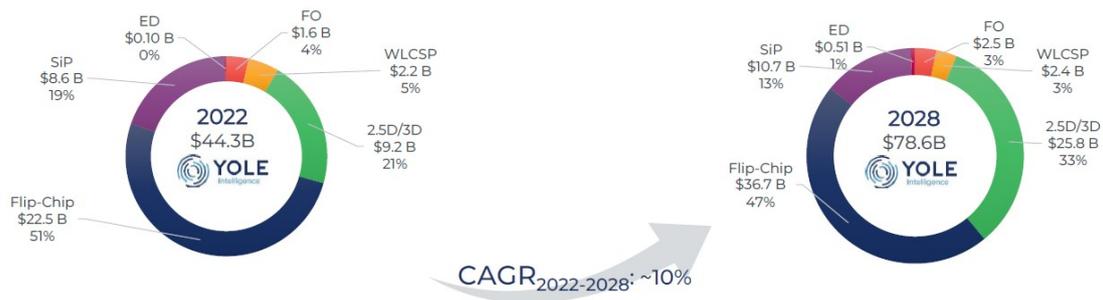
#### 2. 先進封裝市場分析與市佔率

半導體產業持續轉向先進封裝(AP)，將其作為創新的關鍵。AP增強產品功能性、提昇效能並降低成本。AP的趨勢包括小晶片分割(chiplet)和2.5D/3D封裝，以提高產量並降低成本。

據Yole Group報告(Statusof the Advanced Packaging 2023)指出，在2022~2028年間，先進封裝市場將以約10%複合年增率(CAGR)成長，到2028年時，先進封裝市場規模將超過780億美元。目前各種先進封裝技術中，2.5D/3D的營收將從92億美元提升到258億美元，以CAGR 33%成長。SiP的營收將從86億美元提昇到107億美元，以CAGR 13%成長。

本公司目前服務項目包含晶圓級尺寸封裝，晶圓級後護層封裝等均屬先進封裝市場範疇，後續配合前端晶圓製程微縮與客戶應用整合開發相對因應新封裝與製程，持續擴大先進封裝市場佔有率。

## ADVANCED PACKAGING REVENUE FORECAST 2022-2028



### 3. 市場未來之供需狀況與產品之各種發展趨勢

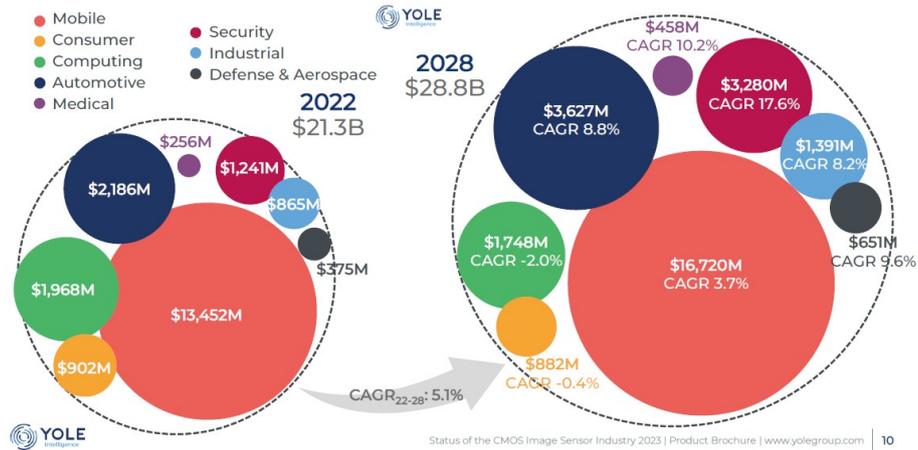
鑑於未來在智慧物聯（AIOT）趨勢帶動下，AI、5G、物聯網、工業4.0、自動駕駛等新的多元應用都是半導體的發展契機，全球專業封測產業來自先進應用與封裝製程產值仍將成為帶動產值成長重要動能。本公司主要服務為晶圓層級之封裝代工服務，應用產品包含行動裝置、5G通訊、汽車電子及穿戴式裝置等應用。其主要應用領域之供需狀況與成長性分析如下：

#### (1) 3D Sensing

根據 RationalStat analysis，3D Sensors Market Size，Share，Competitive Insights，Precise Outlook，and Forecasts 2023-2030 | Market Report by RationalStat，全球 3D 感測器市場規模預計 2023 年達到 90 億美元，到 2030 年將達到 280 億美元，年複合年增長率為 17.5%。3D 感測器在智慧型手機、平板電腦和遊戲機中的應用推動了該產業的發展。這些感測器支援臉部辨識、手勢控制和擴增實境(AR)等功能，從而改善用戶體驗並增加市場需求。

#### (2) CMOS Image Sensor 影像感測器 (CIS)

依據 Yole Intelligence 報告: Status of the CMOS Image Sensor Industry 2023，也是預估 CIS 市場的成長，它估計全球 CIS 市場規模從 2022 年起，將以 5.1 % 的年複合成長率(CAGR)，至 2028 年將達到 288 億美元的規模。其中，最大宗的行動裝置領域，CAGR 只有 3.7%，而醫療領域 CAGR 則達 10.2%，車用為 8.8%，安防監控為 17.6%，國防與航太是 9.6%，工業用是 8.2%。



智慧型手機是影像感測器市場的主要推動力。由於消費者在選擇智慧型手機時越來越重視相機質量，因而推升更高解析度的感測器、多鏡頭相機和先進的成像功能。

汽車產業廣泛採用影像感測器做為高級駕駛輔助系統(ADAS)、停車輔助和車載攝影機等應用中，此外自動駕駛趨勢更進一步推動了感知和視覺系統對影像感測器的需求，促進了影像感測器市場的成長。

醫學影像技術的進步導致高性能影像感測器整合到各種醫療設備中，醫療產業對影像感測器不斷增長的需求也持續推動影像感測器市場的發展，應用包括內視鏡檢查、診斷影像和穿戴式健康設備。

### (3)微機電感測器 (MEMS)

依據 GII Global information 報告”MEMS -市場佔有率分析、產業趨勢與統計、2024 年至 2029 年成長預測”，MEMS 市場規模預計到 2024 年為 168.1 億美元，預計到 2029 年將達到 251.9 億美元，在預測期內(2024-2029 年)複合年成長率為 8.43%。

從一開始的通訊和醫療生物技術應用，到家用電子電器中及智慧型手機及其他消費品的各種產品中，MEMS 並在人們的日常生活中無處不在。且仍在成長中。

許多 MEMS 製造商正在投資建造新的生產設施。例如，MEMS 大廠博世 (Bosch) 於 2022 年投資超過 4 億歐元(約新台幣 137 億元)於晶圓廠，2023 年投資 6,500 萬歐元(約新台幣 22 億元)設立晶片與感測器測試工廠。另外，再到 2030 年之前，博世還將增加 2.85 億歐元(約新台幣 96 億元的投資)，以因應當前汽車電子的相關需求與未來成長。

#### 4. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

##### (1) 競爭利基

###### (a) 生產效率提升，降低成本提升競爭優勢

近年積極加速設備自動化、產線流程優化以提升生產力產能稼動率，並整合資源利用各廠區產能機動調配之方式，快速提供產品及服務，取得客戶長期穩定之信賴。

###### (b) 技術領先暨產品應用多樣化

精材科技深耕晶圓層級封裝市場，致力技術研發及擴展產品應用，除品質優良、交期迅速、售後服務良好深受客戶信賴外，市場行銷與研發團隊建立完整的新技術專利，並配合客戶產品需求開發出多種先進之晶圓層級封裝，並獲得國際品牌大廠認證之合格供應商。

###### (c) 集團整合

本公司為台積電轉投資公司，不僅利用本身之技術與行銷能力，建立強大之客戶群，更結合台積電半導體製造技術與本公司在下游提供晶圓級封裝的專業技術，於半導體供應鏈中可提供客戶完整之一條龍服務(Turn-key service)，與客戶形成長期的伙伴關係，不斷正向循環。

###### (d) 國際分工之優勢

台灣封裝業的發展，扮演全球半導體業供應鏈的夥伴，藉先進技術發展策略，並整合品質、成本、交期、產能及服務之總體運籌優勢，締造在國際分工體系中的總體競爭地位。本公司為先進晶圓層級封裝服務之提供者，不僅提供國內外客戶封裝服務，並藉由與晶圓代工公司合作，提供完整之供應生產鏈體系，解決生產過程衍生之相關議題。

##### (2) 發展遠景之有利因素

###### (a) 先進晶圓層級封裝之成長

因應終端產品需求，晶圓層級封裝製程發展不斷往前推進，目前封裝產品追求的製程目標包括：尺寸縮小、功率降低、功能與頻寬增加，以期超越摩爾定律，希望將半導體元件與模組的功能性與整合度發揮到極致。從技術發展脈絡可以發現，半導體封裝產業不斷在追求可以減少晶片厚度及材料成本、提升晶片效能、降低電磁干擾與功率消耗的 3D 堆疊封裝技術。面對晶圓層級封裝趨勢所帶動的市場機會，臺灣因半導體產業鏈完整，因此具有晶圓層級封裝生態發展優勢。預計未來晶圓層級封裝技術應用領域將會十分寬廣。

###### (b) 開發新利基應用，持續投資中長期商機

鑑於產業需求變動快速，本公司持續拓展新客戶與新利基產品之開發，如拓展 5G GaN 通訊用高頻功率元件加工服務及新客戶、客製化微機電元件加工服務、持續開發元件薄化製程與新創模組技術，協助客戶新創產品需求，持續 12 吋晶圓測試業務。

### (c) 關鍵技術之自主研發

本公司持續強化研發能量，汽車電子相關之晶圓級後護層封裝及晶圓級尺寸封裝，由於產品品質優異，獲得多家國際級品牌大廠及汽車廠之合格供應商。另本公司近年亦開發多種微機電感測器、指紋辨識感測器、新型生物辨識感測元件之晶圓級後護層封裝及晶圓級尺寸封裝技術，此等技術可達成產品輕薄短小之需求，對新興之行動裝置及穿戴式裝置之輕量化有極大助益。

### (3)發展遠景之不利因素及因應之道

#### (a) 智慧手機趨於飽和，消費者換機週期延長

智慧型手機市場面臨產品成熟、產品差異化降低、市場滲透率已高，新興市場採購動能支撐成長等不利因素，讓手機產業經營相對困頓。

#### 因應對策：

因應電子產業及半導體產業市場與其技術的不斷變化，本公司的競爭利基為持續開發先進製程與新衍生技術並搭配新興應用之需求，強化與關鍵客戶合作並整合上游產業龍頭技術，提供客戶高附加價值之封裝解決方案，並確保客戶產品即時導入市場，持續精進製造管理以提高生產力並降低營運成本。

#### (b) 中美貿易戰與地緣政治牽動半導體產業

近來國際局勢變動，全球貿易壁壘加劇，為貿易協定及區域競爭關係增添變數，也讓半導體產業發展不確定性劇增。美中貿易戰若持續，長期將波及全球 ICT 產業，邏輯、類比以及記憶體晶圓半成品及模組受到的衝擊最大。

#### 因應對策：

聚焦發展先進晶圓層級封裝，因應各種功能應用來達到產品差異化的效果，導入自動化設備，提升生產力及品質，並有效降低成本。轉進利基應用市場，包括醫療、汽車、監控電子等領域。對於類比、感測器等晶片出現高度需求，強力佈局專利地圖，以提升並拉大競爭力之差異化。同時強化台美產業供應鏈整合、緊密雙方的經貿夥伴關係，並發展多元化的國際市場。

## (二) 主要產品之重要用途及產製過程

### 1. 主要產品之重要用途

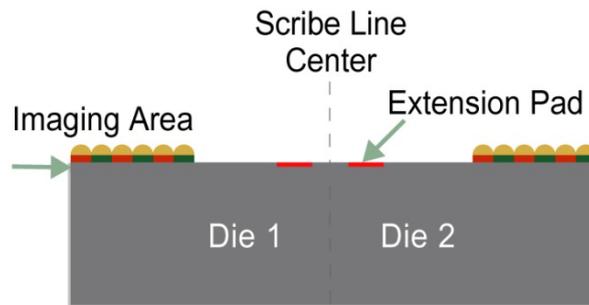
產品別	主要用途	主要應用領域
晶圓級尺寸封裝	影像感測器、環境感測器	手機、平板、筆記型電腦、汽車、醫療
晶圓級後護層封裝	指紋辨識器、作動感測器、微機電元件、功率、類比及 RF 元件	手機、平板、筆記型電腦、汽車

## 2. 主要產品產製過程

### (1) 晶圓級 CSP 封裝技術製程：

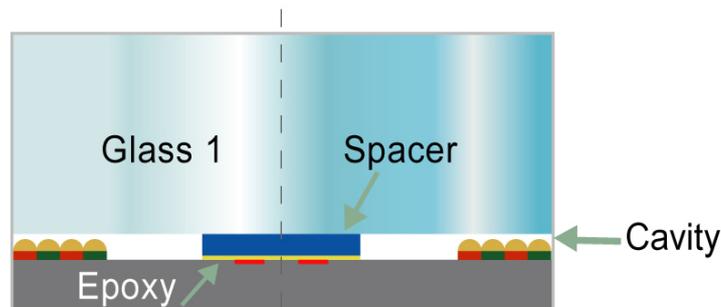
在晶片尚未切割前即進行，整片晶片經由薄膜，黃光及蝕刻等晶圓製程完成封裝，最後再切割成單顆的 IC，此種製程可視為前段半導體晶圓廠製程的延伸。最大優點是在封裝的過程中，藉由整片晶片的製程方式，但卻同時將個別的 IC 封裝完成來降低封裝過程中的支出。整個封裝製程的基本步驟如下列所述：

A. 以黏著劑將一片高透光性之薄玻璃黏貼於客戶晶片的正面，以保護晶圓表面不受污染。



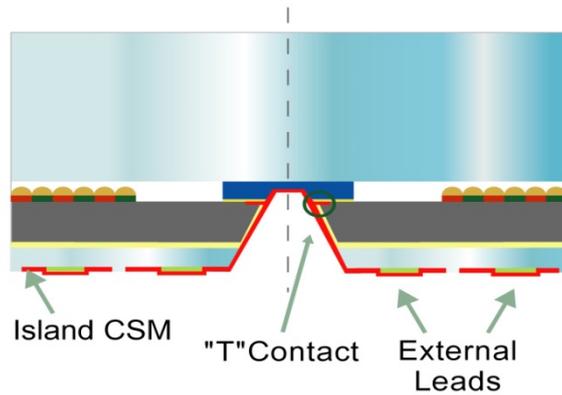
**Step A: Passivation and Pad Extension Layers**

B. 研磨黏有玻璃的晶片背面，使晶片的厚度變薄，藉此降低之後的封裝厚度，並以蝕刻的方式將晶片切割道背面的矽材料去除，使一顆顆獨立 IC 產生於黏著的玻璃保護片上。



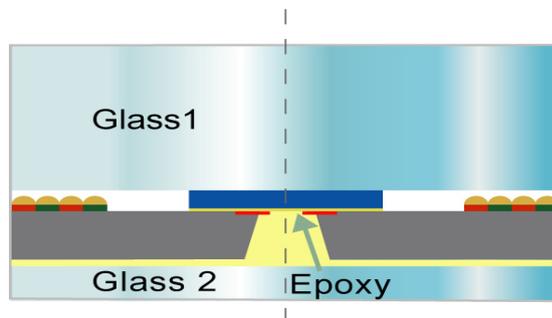
**Step B: Glass 1 Attachment**

C. 將玻璃保護層黏貼於晶片背面，以達到完全包覆 IC 的保護作用。



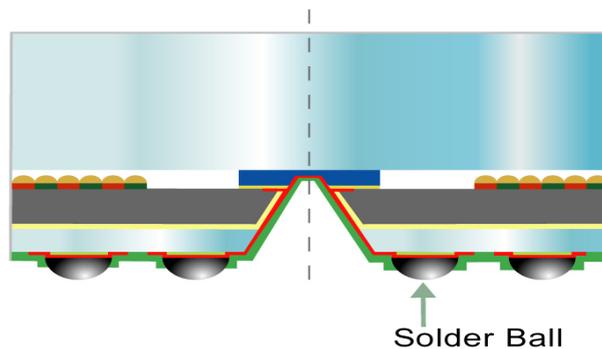
**Step C: Etching and Glass-2 bonding**

D. 在玻璃表面準備製作銲接點(Solder Joint)的所在位置覆上一層有機材料，以作為絕緣緩衝層。



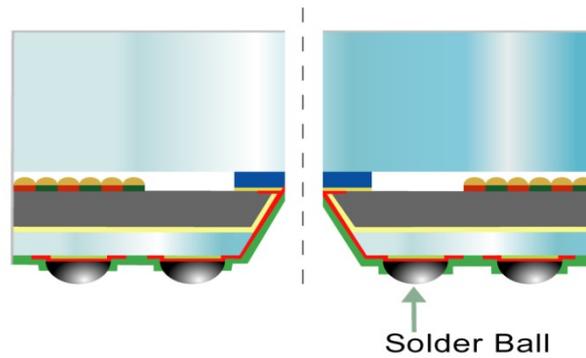
**Step D: Barrier deposition and T-contact formation**

E. 在個別的 IC 之間切割露出 IC 銲墊的截面並濺鍍上金屬層，再利用三度空間之曝光、顯影及蝕刻等製程完成所需的金屬線路，使線路與 IC 銲墊的截面相連通。



**Step E: Passivation coating and BGA formation**

F. 在金屬線路上覆蓋上一層保護層。



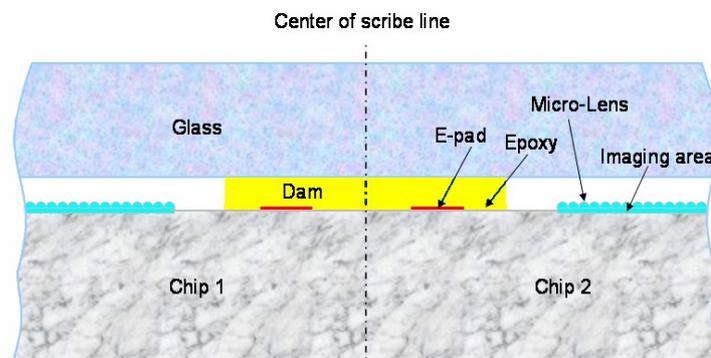
**Step F: Dicing and Final inspection**

G. BGA 型式的元件則以印刷的方式將錫膏印在整片晶片上銲接點的所在位置，再經過迴錫(Reflow)形成錫球。

H. 切割晶片成為單顆封裝完成的 IC。

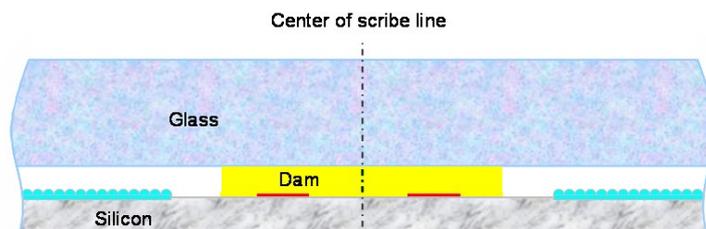
(2) TSV(矽穿孔封裝)技術步驟說明：

A. 以黏著劑將一片高透光性之薄玻璃黏貼於客戶晶片的正面，以保護晶圓表面不受污染。



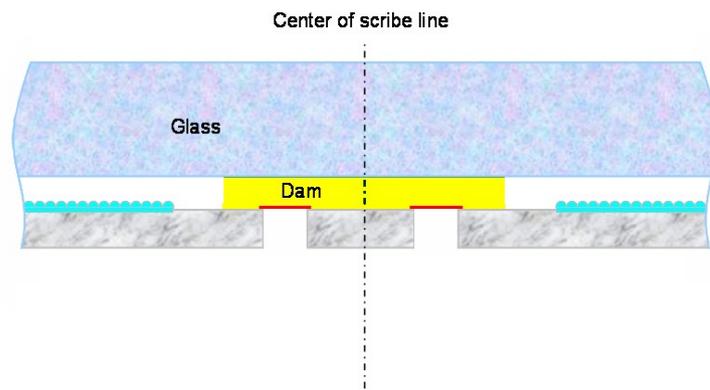
**Step A: Glass attachment**

B. 研磨黏有玻璃的晶片背面，使晶片的厚度變薄，藉此降低之後的封裝厚度。



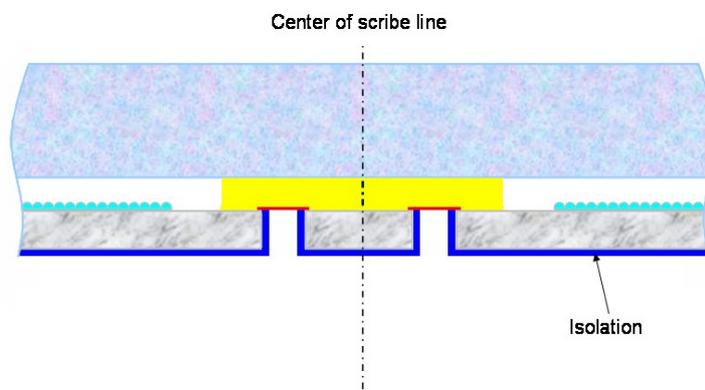
**Step B: Wafer thin down**

C.以蝕刻的方式從晶片背面的矽材料去除，作為 RDL 線路連接之孔洞。



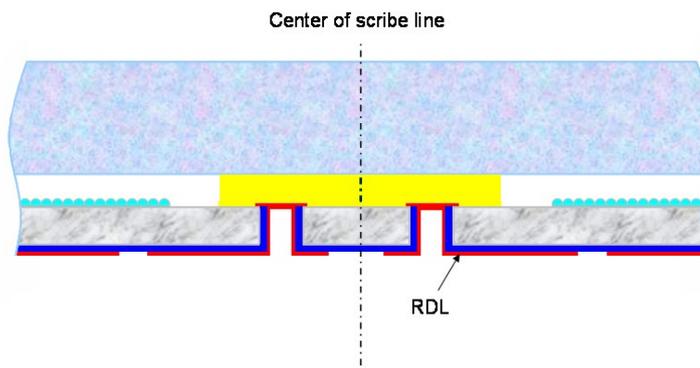
### Step C: TSV formation

D.在晶片表面覆上一層二氧化矽作為絕緣層。



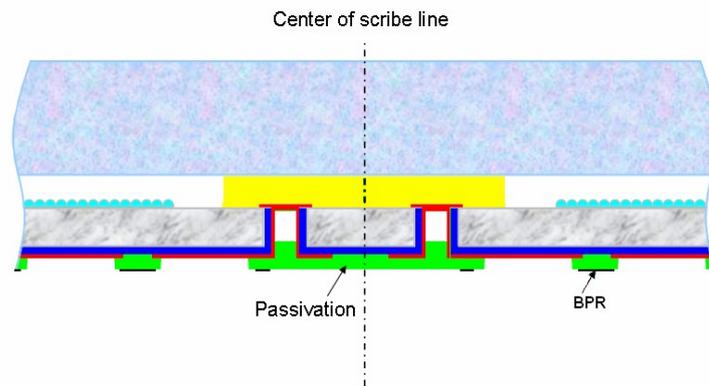
### Step D: Isolation formation

E.在晶片表面濺鍍上金屬層，再利用三度空間之曝光、顯影及蝕刻等製程完成所需的金屬線路，使線路與 IC 錫墊的截面相連通。



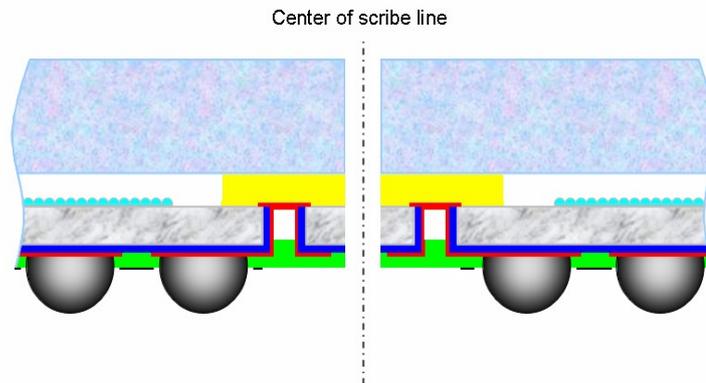
### Step E: RDL process

F.在金屬線路上覆蓋上一層保護層。



**Step F: Passivation process**

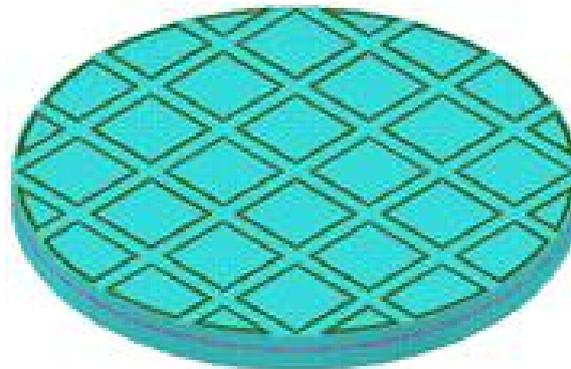
G. BGA 型式的元件則以印刷的方式將錫膏印在整片晶片上銲接點的所在位置，再經過迴錫(Reflow)形成錫球。最後切割晶片成為單顆封裝完成的 IC。



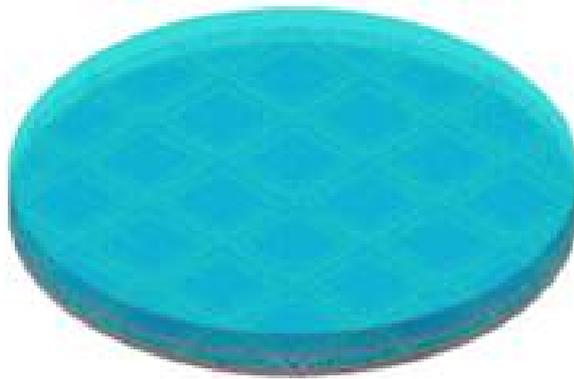
**Step G: BGA & Dicing processes**

(3) CIS IR glass 模組封裝步驟說明：

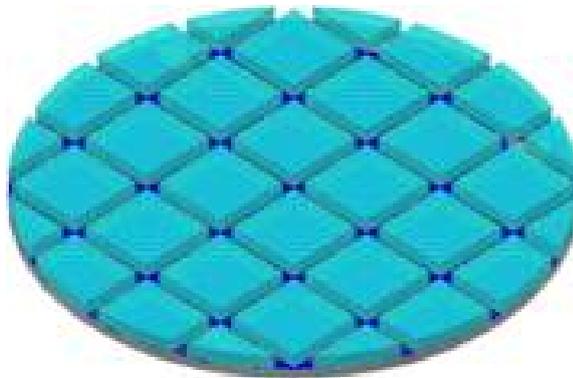
A. IR glass 模組化



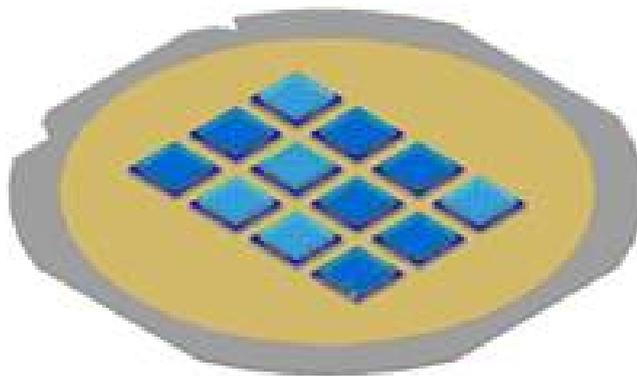
B. Si device 和模組化 glass 結合



C. Si device 薄化和切割



D. 重新排列後以 frame type 出貨



(4) Glassless TSV 技術說明：

配合 TSV(矽穿孔封裝)技術發展 Glassless & LGA 技術包裝出貨



### 3.未來研發計畫：

配合市場以及客戶感應器(Sensor 和 MEMS)的新產品技術需求，持續開發晶圓級新的製程技術，包括 Molding、TMV 等模組技術，應用於多樣生物辨識感測器、影像感測器、環境光源感測器、微機電(MEMS)、功率場效電晶體等產品，提供包括晶圓級封裝以及中後端晶圓級製程的技術服務。

### (三) 主要原料之供應狀況

主要原料	供應商名稱	國外	國內	供應情形
薄型玻璃	SCHOTT、NEG	✓		良好
靶材	優美科、有研、臺灣萬騰榮		✓	良好
鍍金液	OKUNO	✓		良好
鋁蝕刻液	思柏		✓	良好
研磨液	台灣艾杰旭、瀚軒		✓	良好

### (四) 最近二年度主要進、銷貨客戶名單：

#### 1.最近二年度占進貨總額百分之十以上之進貨廠商名稱、金額與比例：

單位：新台幣仟元

項目	111 年				112 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD.	193,856	19	無	NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD.	192,547	27	無
	其他	827,524	81		其他	523,226	73	
	進貨淨額	1,021,380	100		進貨淨額	715,773	100	

#### 2.最近二年度占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱、金額與比例：

單位：新台幣仟元

項目	111 年度				112 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A 公司	5,772,030	75	具重大影響力之投資者	A 公司	5,076,877	79	具重大影響力之投資者
2	B 公司	1,346,116	17	無	B 公司	958,343	15	無
	其他	613,651	8		其他	351,648	6	
	銷貨淨額	7,731,797	100		銷貨淨額	6,386,868	100	

(五) 最近二年度生產量值表：

單位：新台幣仟元、千片

年度 生產量值 主要商品	111 年度			112 年度		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
晶圓級尺寸封裝	372	248	3,379,399	401	169	2,654,100
晶圓級後護層封裝	488	260	330,076	269	119	245,913
晶圓測試及其他	645	484	1,052,052	689	511	1,107,607
合 計			4,761,527			4,007,620

註：晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝的產量與產能單位為千片約當八吋晶圓，晶圓測試則為千片十二吋晶圓。

(六) 最近二年度銷售量值表：

單位：新台幣仟元、千片

年度 銷售量值 主要商品	111 年度				112 年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	銷售量	銷售值	銷售量	銷售值	銷售量	銷售值	銷售量	銷售值
晶圓級尺寸封裝	111	3,943,757	136	1,540,780	87	3,165,201	81	1,013,756
晶圓級後護層封裝	129	441,031	131	175,806	116	408,994	3	19,289
晶圓測試及其他	484	1,621,240	-	9,183	511	1,770,460	-	9,168
合 計		6,006,028		1,725,769		5,344,655		1,042,213

註：晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝的銷售量單位為千片約當八吋晶圓，晶圓測試則為千片十二吋晶圓。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度		111 年度	112 年度	當 年 度 截 至 113 年 3 月 31 日
員 工 人 數	直 接 人 員	894	796	772
	間 接 人 員	625	615	608
	合 計	1,519	1,411	1,380
平 均 年 歲		38	39	39
平 均 服 務 年 資		8.0	9.0	9.1
學 歷 分 布 比 率	博 士	16	20	20
	碩 士	276	279	280
	大 專	828	740	724
	高 中	361	337	323
	高 中 以 下	38	35	33

四、環保支出資訊

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容）：111年度及112年度均無違反環保法令遭處分情事。

(二) 目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：不適用。

本公司除依環保法規規定操作與維護廢水處理設備、空氣污染防治設備與廢棄物分類

與管理外，並持續關注國際環保發展趨勢，致力規劃與執行各項節能減碳專案，以減少各項用電及溫室效應氣體排放量，以降低地球溫室氣體效應，善盡地球公民職責。

本公司除已獲得 ISO14001 及 ISO45001 等環安衛管理系統驗證多年，每年亦均持續推動與改善廠區環安衛制度及文化，更推動與獲得 TOSHMS 台灣職業安全衛生管理系統、GHG 溫室氣體排放及重要產品的碳足跡驗證通過，致力達成公司環安衛政策(客戶至高滿意、安全零事故、環境永續發展)。

## 五、勞資關係

(一) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

### 1. 員工福利措施：

- (1) 本公司已依照「職工福利金條例」之規定，提撥福利金，組織職工福利委員會，辦理職工福利事項，從業人員得享有各項福利措施及年節獎金。
- (2) 本公司從業人員一律參加全民健保、勞工保險及團體保險，享有各項保險給付權利等。
- (3) 本公司每年發放年終獎金，於年度結算時，如有盈餘，除繳納稅捐彌補虧損及提撥股息、公積金外，依年度考核之結果及相關制度配發員工酬勞。
- (4) 本公司訂有獎金發放制度，總經理會視實際營運成果，發放特別激勵獎金。

### 2. 員工學習與發展：

培育專業人才、改善人力素質一直是本公司秉持的信念。為增進員工工作技能、讓員工快速融入工作環境、改善產品與服務品質、提升組織整體競爭力，本公司透過系統化的訓練藍圖展開教育訓練計劃，讓員工與公司一同成長。

112 年度共舉辦了 110 個班次的實體訓練課程，總訓練時數為 308.82 小時，總參與人次為 3,189 人次。另外，錄製及重製共 72 堂專業技術的數位課程，總時數為 33.6 小時。訓練類別包含：

#### (1) 新進人員訓練

由人資單位安排新進人員訓練活動，內容包含公司簡介、環安衛介紹、品質與環境限用物質管理系統介紹。

#### (2) 個人效能訓練

為提升個人工作能力、加強工作技能，以提升工作效率，規劃個人效能提升課程，如簡報技巧、溝通技巧等相關課程。

#### (3) 技術訓練

為強化研發能力與改善產品技術以增加公司競爭力，提供技術類專業訓練課程，以強化工程與研發人員之專業技術能力。

#### (4) OJT 訓練

為使工程技術得以傳承，透過工作中學習，以培養技術人才，確保產品品質。

#### (5) 管理學習

根據不同階層的管理職能，系統化的規劃管理人員學習計劃，並依此展開相關的管理課程。

#### (6) 特定資格人員訓練

依相關法令規定或工作需求辦理特定資格人員訓練，並定期檢定，以增進工作技能，進而提升產品之品質。

### 3.退休制度：

依勞動基準法相關規定，按每月薪資總額百分之二提撥員工退休準備金，專戶存入臺灣銀行信託部。並依勞動基準法規定，辦理員工退休金支付。截至 112 年底本公司台灣銀行退休金專戶已存入新台幣 57,515 仟元。自 94 年 7 月 1 日起，員工選擇適用勞工退休金條例之退休金制度者，按其每月薪資百分之六提撥至勞工保險局之個人退休金專戶，於 112 年認列費用之金額為新台幣 52,287 仟元。

### 4.勞資間之協議情形：

本公司制訂工作規則、人事管理規則及人事作業準則，從員工進用、升遷至退休、撫卹福利皆有完整規劃，作為公司與員工共同的規範，勞資的協調均透過勞資會議、員工溝通會進行討論與協調，並積極促進勞資雙方和諧與共贏。

### 5.工作環境與員工人身安全保護措施：

公司的環境安全衛生政策重點是建立一個安全的工作環境，防止職業傷害與疾病，保持健康的員工，增強每一位員工的意識和責任意識。公司的出入口都設有門禁刷卡裝置，健身房及集乳室有緊急壓扣，主要出入口和公共區域亦有保全人員 24 小時守衛與巡邏，以保障員工人身安全。

積極推動職場健康促進活動，包括健身/運動/控制體重計劃、定期安排員工健康檢查、視障按摩服務、聘僱職場健康保護醫護人員追蹤關懷員工健康，並鼓勵員工兼顧健康與平衡的生活。符合員工健康需求及提供良好的職場環境，並獲得衛生福利部國民健康署頒發「企業健康職場自主認證標章」、2023 康健雜誌「CHR 企業公民許諾企業標章」、2023 年金牌企業卓越獎-愛地球獎及性平獎。

(二)最近年度及年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

## 六、資通安全管理：

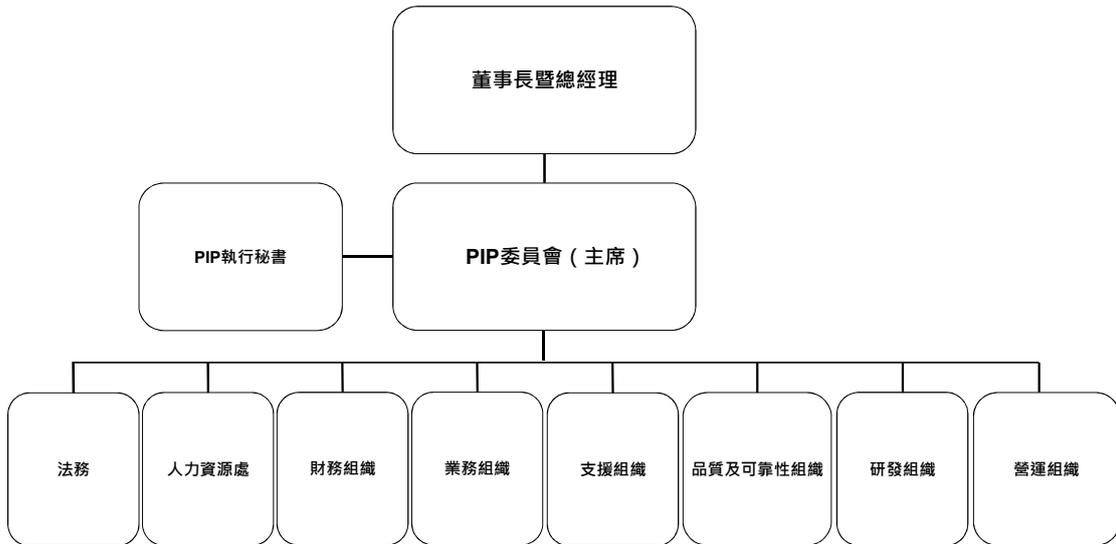
### (一) 資訊安全治理制度與策略

精材公司為保障公司及客戶之機密資訊安全，本公司自民國 97 年 1 月設置「機密資訊保護委員會(Proprietary Information Protection Committee, PIP Committee)」，負責機密資訊安全管理及監督，並制定「機密資訊保護政策」及「機密資訊保護作業管理辦法」，明定公司機密資訊保護的管理政策、程序及規範作業。同時，為建構完善的治理制度與全方位的資安防衛能力，PIP 委員會偕同資訊部門每季定期召開會議檢視資安政策及執行成果，且每年定期向董事會報告資安治理概況，透過資安技術運用識別資安風險與弱點預防及改善，提升同仁對資訊安全保護的正確觀念及警覺性，降低機密資訊外洩及網路病毒攻擊的風險，維持公司競爭優勢。並制定五大資訊安全行動目標，落實 PDCA 循環：

1. 建立與落實機密資訊及資訊安全管理系統。
2. 遵守法規與合約之機密資訊及資訊安全要求。
3. 落實員工與相關團體機密資訊保護及資訊安全教育及宣導。
4. 評估與鑑識風險並設定改善目標與控制措施。
5. 透過內部稽核活動持續改善機密資訊及資訊安全管理系統。

## 資訊安全組織架構

1. PIP 委員會：由各部門主管指派代表組成，負責全公司的機密資訊管制作業之研議、建置、稽核與推動等事項。
2. PIP 執行秘書：負責機密資訊管制、規劃、監督及推動執行。
3. 資訊部門：負責資訊安全系統建置與管理，並依 PIP 委員會決議及需求協助評估、建置及管理資訊安全軟、硬體，並進行資料通訊及儲存行為之異常分析，若有異常則以資安通報呈報 PIP 委員會處理。



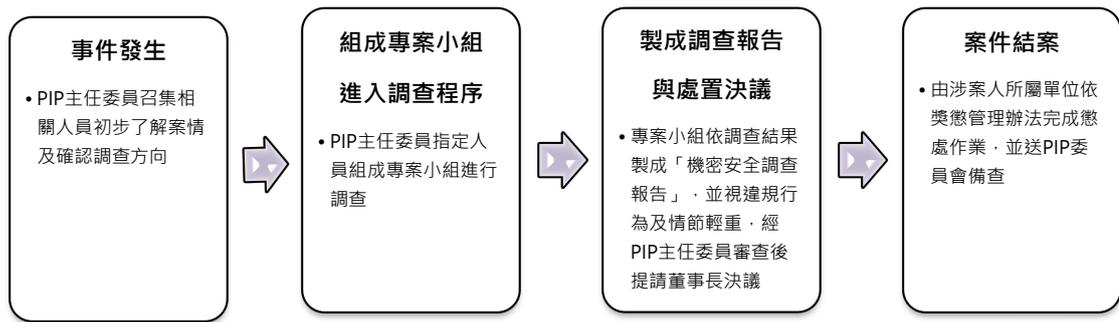
## 2023 年度資安風險管理對策及投入之資源

1. 強化資安防禦能力與第三方外網資安弱點評鑑及弱點改善。
2. 制定資訊系統企業持續營運及災害應變計劃及演練，並明確訂定核心業務之復原時間目標(RTO)及資料復原時間點目標(RPO)，設置適當之備份機制及備援計畫。
3. 定期展開危害鑑別、風險評估及改善作業。
4. 建置資訊安全監控中心 SOC，即時掌控公司資訊安全狀態，專注於資訊安全警訊、警戒提升處置及資安事故發生時之指揮中心。
5. 社交工程-釣魚郵件演練與案例宣導。
6. 定期宣導及進行查核活動，以確保公司的機密資訊保護措施的落實。
7. 機密資訊盤點、分類分級及標示，並且建置系統避免機敏資訊外流。
8. 強化外部資安防禦設備以預防零時差攻擊及阻斷釣魚郵件。

## 2023 年度教育訓練與稽核

1. 累計完成 12 次 PIP 管理會議及 4 次 PIP 委員會議。
2. 公司全員 2023 年完成 PIP 教育訓練及稽核。
3. 資訊安全人員 2023 年累計完成 22 個場次內外資安教育訓練。

## 資訊安全事件調查程序



(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

最近年度及截至年報刊印日止無因重大資通安全事件所遭受之損失。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
租賃契約	經濟部	113/2~118/2	中壢工業區 A 棟(A5-3)	不得轉租、出借或以其他方式供他人使用。
		113/2~118/2	中壢工業區 A 棟(A1-3,A1-4,A2-4)	
		110/4~116/4	中壢工業區 A 棟(A4-1,A4-2,A4-3)	
		102/1~115/10	中壢工業區 C 棟(C7-1,C7-2)	
		102/1~116/11	中壢工業區 C 棟(C9-1,C9-2)	
		101/3~117/02	中壢工業區 C 棟(C10-1,C10-2)	
		99/5~119/4	中壢工業區 A 棟(A5-4、A7-2、A8-3)	
		110/1~121/8	中壢工業區 A 棟(A1-1)	
	宏惠光電	109/11~119/12	中壢工業區 A 棟(A3-3, A3-4)	
	新創人工智能	112/4~115/3	中壢工業區 C 棟(C2-2)	
借款合約	遠東銀行	112/11~117/11	營運週轉	無
	遠東銀行	112/12~117/12	中期專案貸款	應遵守專案貸款要點，不得移用貸款。
	台北富邦銀行	113/03~118/02	中期專案貸款	應遵守專案貸款要點，不得移用貸款。
後段服務合約	台灣積體電路製造股份有限公司	102/6~(註 1)	後段封裝服務	保密責任
設備寄託合約	台灣積體電路製造股份有限公司	108/10~109/10(註 2)	寄託供後段測試封裝之設備	保密責任
Collaboration Agreement	台灣積體電路製造股份有限公司	108/11~113/11(註 3)	後段晶圓測試代工業務	保密責任 賠償責任

註 1：本契約至任一方重大違約，經他方終止為止。

註 2：本契約自生效日起算一年，除另有規定外，自動展延一年，其後亦同。

註 3：本契約自生效日起算五年，除提前終止外，自動展延一年。

## 陸、財務概況

### 一、最近五年度簡明財務資料

#### (一) 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

##### 1. 簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最近五年度財務資料(註1)					
	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	
流動資產	2,189,356	3,152,343	3,881,788	5,299,966	5,385,219	
不動產、廠房及設備	3,439,913	4,054,174	3,892,324	3,853,333	4,341,020	
無形資產	23,341	48,073	38,118	31,263	20,784	
其他資產	516,171	500,596	360,390	287,224	254,142	
資產總額	6,168,781	7,755,186	8,172,620	9,471,786	10,001,165	
流動負債	分配前	1,276,369	1,987,204	1,400,533	1,535,022	1,469,496
	分配後	1,276,369	2,665,615	2,214,626	2,349,115	(註2)
非流動負債	1,601,603	752,526	555,909	546,587	577,522	
負債總額	分配前	2,877,972	2,739,730	1,956,442	2,081,609	2,047,018
	分配後	2,877,972	3,418,141	2,770,535	2,895,702	(註2)
歸屬於母公司業主之權益	3,290,809	5,015,456	6,216,178	7,390,177	7,954,147	
股本	2,713,643	2,713,643	2,713,643	2,713,643	2,713,643	
資本公積	396,424	396,424	396,424	396,424	396,424	
保留盈餘	分配前	181,206	1,905,389	3,106,111	4,280,110	4,844,080
	分配後	181,206	1,226,978	2,292,018	3,466,017	(註2)
其他權益	(464)	-	-	-	-	
庫藏股票	-	-	-	-	-	
非控制權益	-	-	-	-	-	
權益總額	分配前	3,290,809	5,015,456	6,216,178	7,390,177	7,954,147
	分配後	3,290,809	4,337,045	5,402,085	6,576,084	(註2)

註1：以上各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註2：俟股東會決議後定案。

## 2. 簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最近五年度財務資料(註1)				
	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度
營 業 收 入	4,653,180	7,277,589	7,667,343	7,731,797	6,386,868
營 業 毛 利 ( 損 )	547,628	2,214,992	2,587,215	2,867,100	2,179,210
營 業 ( 損 ) 益	233,537	1,762,948	2,207,924	2,458,701	1,705,092
營 業 外 收 入 及 支 出	(51,559)	(35,503)	(9,208)	42,297	45,410
稅 前 淨 利 ( 損 )	181,978	1,727,445	2,198,734	2,500,998	1,750,502
繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 ( 損 )	181,978	1,727,445	1,877,082	1,983,736	1,375,774
停 業 單 位 損 失	-	-	-	-	-
本 期 淨 利 ( 損 )	181,978	1,727,445	1,877,082	1,983,736	1,375,774
本 期 其 他 綜 合 損 益 ( 稅 後 淨 額 )	(772)	(3,262)	2,051	4,356	2,289
本 期 綜 合 損 益 總 額	181,206	1,724,183	1,879,133	1,988,092	1,378,063
淨 利 ( 損 ) 歸 屬 於 母 公 司 業 主	181,978	1,727,445	1,877,082	1,983,736	1,375,774
淨 利 ( 損 ) 歸 屬 於 非 控 制 權 益	-	-	-	-	-
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主	181,206	1,724,183	1,879,133	1,988,092	1,378,063
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益	-	-	-	-	-
每 股 盈 餘 ( 淨 損 )	0.67	6.37	6.92	7.31	5.07

註1：以上各年度財務資料均經會計師查核簽證。

(二)最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見

年度	會計師事務所	會計師姓名	查核意見
108年	勤業眾信聯合會計師事務所	蔡美貞、林政治	無保留意見
109年	勤業眾信聯合會計師事務所	蔡美貞、林政治	無保留意見
110年	勤業眾信聯合會計師事務所	蔡美貞、林政治	無保留意見
111年	勤業眾信聯合會計師事務所	蔡美貞、黃裕峰	無保留意見
112年	勤業眾信聯合會計師事務所	蔡美貞、黃裕峰	無保留意見

## 二、最近五年度財務分析

年 度		最近五年度財務分析				
		108年	109年	110年	111年	112年
分析項目						
財務結構	負債占資產比率(%)	46.65	35.33	23.94	21.98	20.47
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	142.22	142.27	173.99	205.97	196.54
償債能力	流動比率(%)	171.53	158.63	277.17	345.27	366.47
	速動比率(%)	138.51	131.34	225.63	313.44	336.43
	利息保障倍數(倍)	6.03	72.05	307.10	566.96	428.68
經營能力	應收款項週轉率(次)	5.05	5.79	5.84	6.63	5.12
	平均收現日數	72.27	63.03	62.50	55.05	71.28
	存貨週轉率(次)	21.65	26.36	20.84	17.72	17.34
	應付款項週轉率(次)	14.39	17.72	18.24	23.55	25.58
	平均銷貨日數	16.85	13.84	17.51	20.59	21.04
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	1.26	1.94	1.93	2.00	1.56
	總資產週轉率(次)	0.72	1.05	0.96	0.88	0.66
獲利能力	資產報酬率(%)	3.25	25.09	23.64	22.53	14.16
	權益報酬率(%)	5.70	41.59	33.42	29.16	17.93
	稅前純益占實收資本額比率(%)	6.71	63.66	81.03	92.16	64.51
	純益率(%)	3.91	23.74	24.48	25.66	21.54
	基本每股盈餘(淨損)(元)	0.67	6.37	6.92	7.31	5.07
現金流量	現金流量比率(%)	74.63	118.61	219.81	195.86	128.47
	現金流量允當比率(%)	90.16	126.04	172.15	208.05	188.08
	現金再投資比率(%)	5.98	13.73	12.92	10.79	6.28
槓桿度	營運槓桿度	10.25	2.44	2.15	2.01	2.96
	財務槓桿度	1.18	1.01	1.00	1.00	1.00
請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達20%者可免分析)						
1.利息保障倍數減少，主要係稅前損益減少所致。						
2.應收帳款週轉率減少及平均收現日數增加，主要係銷貨淨額減少及平均應收帳款增加。						
3.不動產、廠房及設備週轉率減少，主要係銷貨淨額減少及平均不動產、廠房及設備增加所致。						
4.總資產週轉率減少，主要係銷貨淨額減少及平均資產總額增加。						
5.資產報酬率、權益報酬率及每股盈餘減少，主要係稅後損益減少所致。						
6.稅前純益占實收資本額比率減少，主要係稅前損益減少所致。						
7.現金流量比率減少，主要係營運活動淨現金流量減少所致。						
8.現金再投資比率減少，主要係營運活動淨現金流量減少及不動產、廠房及設備增加。						
9.營運槓桿度增加，主要係營業利益減少所致。						

計算公式如下：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告

## 審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四、第十四條之五及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

精材科技股份有限公司



審計委員會召集人

謝徽榮



中 華 民 國 一 一 三 年 二 月 六 日

四、一一二年度財務報告

## 精材科技股份有限公司

### 財務報告暨會計師查核報告 民國 112 及 111 年度

地址：桃園市中壢區吉林路23號9樓

電話：(03)4331818

## 會計師查核報告

精材科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

精材科技股份有限公司（以下簡稱精材公司）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達精材公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與精材公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對精材公司民國 112 年度財務報表之查核最為重要之事項。該事項已於查核財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

茲對精材公司民國 112 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 收入之認列

精材公司主要收入為封裝服務收入及測試服務收入，對財務報告之影響係屬重大。與收入認列相關會計政策及資訊，請參閱財務報告附註四、五及

十八。本會計師針對本年度銷售較前一年度顯著成長之客戶，對其相關晶圓測試收入認列列為本年度關鍵查核事項。

本會計師對於上述所述層面事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並測試營業收入認列之主要內部控制的設計及執行有效性。
2. 抽核晶圓測試收入明細，並核對至相關憑證，以確認收入認列金額之正確性，並核對實際收款金額及匯款證明是否相符；尚未收款者則檢視是否在授信期間內，如已逾授信期間則進一步了解有無異常情事。

#### **管理階層與治理單位對財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估精材公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算精材公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

精材公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核財務報表之責任**

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對精材公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使精材公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致精材公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對精材公司民國 112 年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 蔡 美 貞

蔡美貞



會計師 黃 裕 峰

黃裕峰



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 1 3 年 2 月 6 日

精材科技股份有限公司

資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 3,719,965	37	\$ 3,510,150	37	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註七)	\$ -	-	\$ 5,174	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註七)	20,932	-	4,551	-	2170	應付帳款	155,227	2	173,781	2
1140	合約資產 (附註十八及二九)	175,769	2	160,721	2	2201	應付薪資及獎金	176,553	2	136,865	2
1170	應收帳款淨額 (附註八)	178,461	2	247,702	3	2206	應付員工及董事酬勞 (附註二五)	229,004	2	325,887	3
1180	應收關係人款項淨額 (附註八及二九)	1,020,153	10	1,047,375	11	2213	應付工程及設備款	217,275	2	21,004	-
1310	存貨 (附註五及九)	211,195	2	273,986	3	2230	本期所得稅負債 (附註二三)	240,333	2	407,697	4
1476	其他金融資產	4,286	-	1,640	-	2280	租賃負債-流動 (附註十一及二七)	39,507	-	33,157	-
1479	其他流動資產 (附註十三及二九)	54,458	1	53,841	-	2399	應付費用及其他流動負債 (附註十五及二九)	411,597	4	431,457	5
11XX	流動資產合計	5,385,219	54	5,299,966	56	21XX	流動負債合計	1,469,496	14	1,535,022	16
	非流動資產						非流動負債				
1600	不動產、廠房及設備 (附註十及三十)	4,341,020	44	3,853,333	41	2550	負債準備 (附註十四)	404,913	4	368,483	4
1755	使用權資產 (附註十一)	208,335	2	208,108	2	2580	租賃負債-非流動 (附註十一及二七)	172,609	2	178,104	2
1780	無形資產 (附註十二)	20,784	-	31,263	-	25XX	非流動負債合計	577,522	6	546,587	6
1840	遞延所得稅資產 (附註二三)	22,300	-	60,383	1	2XXX	負債合計	2,047,018	20	2,081,609	22
1920	存出保證金	14,260	-	11,868	-		權益 (附註十七)				
1975	淨確定福利資產 (附註十六)	9,247	-	6,865	-		股本				
15XX	非流動資產合計	4,615,946	46	4,171,820	44	3110	普通股股本	2,713,643	27	2,713,643	29
						3200	資本公積	396,424	4	396,424	4
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	577,261	6	378,452	4
						3350	未分配盈餘	4,266,819	43	3,901,658	41
						3300	保留盈餘合計	4,844,080	49	4,280,110	45
						3XXX	權益合計	7,954,147	80	7,390,177	78
1XXX	資 產 總 計	\$ 10,001,165	100	\$ 9,471,786	100		負 債 與 權 益 總 計	\$ 10,001,165	100	\$ 9,471,786	100

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



精材科技股份有限公司

綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		112 年度		111 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註五、十 八及二九）	\$ 6,386,868	100	\$ 7,731,797	100
5000	營業成本（附註九、二五及 二九）	<u>4,207,658</u>	<u>66</u>	<u>4,864,697</u>	<u>63</u>
5950	營業毛利	<u>2,179,210</u>	<u>34</u>	<u>2,867,100</u>	<u>37</u>
	營業費用（附註二五）				
6100	行銷費用	50,595	1	55,896	1
6200	管理費用	122,021	2	133,126	1
6300	研究發展費用	<u>369,092</u>	<u>5</u>	<u>321,463</u>	<u>4</u>
6000	合 計	<u>541,708</u>	<u>8</u>	<u>510,485</u>	<u>6</u>
6500	其他營業收益及費損淨額 （附註十九、二五及二九）	<u>67,590</u>	<u>1</u>	<u>102,086</u>	<u>1</u>
6900	營業淨利	<u>1,705,092</u>	<u>27</u>	<u>2,458,701</u>	<u>32</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二十）	49,242	1	19,040	-
7050	財務成本（附註二一）	( 4,093)	-	( 4,419)	-
7020	其他利益及損失（附註 二二）	<u>261</u>	<u>-</u>	<u>27,676</u>	<u>1</u>
7000	合 計	<u>45,410</u>	<u>1</u>	<u>42,297</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	1,750,502	28	2,500,998	33
7950	所得稅費用（附註二三）	( <u>374,728</u> )	( <u>6</u> )	( <u>517,262</u> )	( <u>7</u> )
8200	本年度淨利	<u>1,375,774</u>	<u>22</u>	<u>1,983,736</u>	<u>26</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112 年度		111 年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註十 六)	\$ 2,289	-	\$ 4,356	-
8300	本年度其他綜合損益	<u>2,289</u>	<u>-</u>	<u>4,356</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,378,063</u>	<u>22</u>	<u>\$ 1,988,092</u>	<u>26</u>
	每股盈餘(附註二四)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 5.07</u>		<u>\$ 7.31</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 5.03</u>		<u>\$ 7.21</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



精材科技股份有限公司

權益變動表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	股數 ( 仟股 )	金額	資本公積	法定盈餘公積	留 盈	未分配盈餘	保留盈餘合計	權益合計
A1	111 年 1 月 1 日餘額	271,364	\$ 2,713,643	\$ 396,424	\$ 190,538	\$ 2,915,573	\$ 3,106,111	\$ 6,216,178
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	187,914	( 187,914)	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	( 814,093)	( 814,093)	( 814,093)
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	1,983,736	1,983,736	1,983,736
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	4,356	4,356	4,356
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,988,092	1,988,092	1,988,092
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	271,364	2,713,643	396,424	378,452	3,901,658	4,280,110	7,390,177
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	198,809	( 198,809)	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	( 814,093)	( 814,093)	( 814,093)
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	1,375,774	1,375,774	1,375,774
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	2,289	2,289	2,289
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,378,063	1,378,063	1,378,063
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	271,364	\$ 2,713,643	\$ 396,424	\$ 577,261	\$ 4,266,819	\$ 4,844,080	\$ 7,954,147

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



精材科技股份有限公司

現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112 年度	111 年度
	營業活動之現金流量：		
A10000	稅前淨利	\$ 1,750,502	\$ 2,500,998
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	651,866	777,171
A20200	攤銷費用	15,254	14,470
A20300	預期信用迴轉利益	( 69)	( 68)
A20900	財務成本	4,093	4,419
A21200	利息收入	( 49,242)	( 19,040)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨益	( 3,728)	( 31,926)
A29900	租賃修改利益	-	( 128)
A29900	迴轉負債準備	-	( 8,602)
A24100	外幣兌換淨(益)損	( 1,444)	656
A30000	營業資產及負債之淨變動數：		
A31110	衍生金融工具	( 21,555)	7,611
A31125	合約資產	( 15,027)	237,214
A31150	應收帳款淨額	69,289	65,238
A31160	應收關係人款項淨額	27,222	( 322,114)
A31200	存 貨	62,791	1,198
A31240	其他流動資產	( 2,815)	( 3,006)
A31250	其他金融資產	( 1,765)	2,445
A32150	應付帳款	( 18,554)	( 65,523)
A32180	應付員工及董事酬勞	( 96,883)	38,266
A32180	應付薪資及獎金	39,688	( 28,549)
A32230	應付費用及其他流動負債	( 19,860)	35,300
A32240	淨確定福利資產／負債	( 93)	( 653)
A33000	營運產生之現金	2,389,670	3,205,377
A33500	支付所得稅	( 501,811)	( 198,928)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,887,859</u>	<u>3,006,449</u>
	投資活動之現金流量：		
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 866,334)	( 796,482)
B02800	處分不動產、廠房及設備	3,728	31,953
B03700	存出保證金增加	( 3,692)	( 2,964)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112 年度	111 年度
B03800	存出保證金減少	\$ 1,300	\$ 3,550
B04500	購置無形資產	( 4,775)	( 7,615)
B07500	收取之利息	<u>48,361</u>	<u>17,567</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 821,412)</u>	<u>( 753,991)</u>
	籌資活動之現金流量：		
C04020	租賃本金償還	( 39,065)	( 36,700)
C04500	發放現金股利	( 814,093)	( 814,093)
C05600	支付之利息	<u>( 3,474)</u>	<u>( 3,796)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 856,632)</u>	<u>( 854,589)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加數	209,815	1,397,869
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>3,510,150</u>	<u>2,112,281</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,719,965</u>	<u>\$ 3,510,150</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



精材科技股份有限公司

財務報表附註

民國 112 及 111 年度

(除另註明外，金額以新台幣仟元為單位)

一、公司沿革

精材科技股份有限公司（以下簡稱本公司）於 87 年 9 月 11 日經經濟部核准設立，主要營業項目為半導體之晶圓級尺寸封裝、晶圓級後護層封裝及晶圓測試業務。本公司股票自 104 年 3 月 30 日起於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。本公司註冊地及業務主要營運據點為桃園市中壢區吉林路 23 號 9 樓。

二、通過財務報告之日期及程序

本財務報告業已於 113 年 2 月 6 日經本公司董事會核准並通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一) 首次適用金融監督管理委員會（以下稱「金管會」）認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告（以下稱「IFRS 會計準則」）

適用修正後之金管會認可並發布生效之 IFRS 會計準則將不致造成本公司會計政策之重大變動。

(二) 113 年適用之金管會認可之 IFRS 會計準則

新發布 / 修正 / 修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日(註1)
IFRS 16 之修正「售後租回中之租賃負債」	2024 年 1 月 1 日 (註 2)
IAS 1 之修正「負債分類為流動或非流動」	2024 年 1 月 1 日
IAS 1 之修正「具合約條款之非流動負債」	2024 年 1 月 1 日
IAS 7 及 IFRS 7 之修正「供應商融資安排」	2024 年 1 月 1 日 (註 3)

註 1：除另註明外，上述新發布 / 修正 / 修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

註 2：賣方兼承租人應對初次適用 IFRS 16 日後簽訂之售後租回交易追溯適用 IFRS 16 之修正。

註 3：第一次適用本修正時，豁免部分揭露規定。

1. IAS 1 之修正「負債分類為流動或非流動」（2020 年修正）及「具合約條款之非流動負債」（2022 年修正）

2020 年修正係釐清判斷負債是否分類為非流動時，應評估本公司於報導期間結束日是否具將負債之清償遞延至報導期間後至少 12 個月之權利。若本公司於報導期間結束日具有該權利，無論本公司是否預期將行使該權利，負債係分類為非流動。

2020 年修正另規定，若本公司須遵循特定條件始具有將負債之清償遞延之權利，本公司必須於報導期間結束日已遵循特定條件，即使貸款人係於較晚日期測試本公司是否遵循該等條件亦然。2022 年修正進一步釐清，僅有報導期間結束日以前須遵循之合約條款會影響負債之分類。報導期間後 12 個月內須遵循之合約條款雖不影響負債之分類，惟須揭露相關資訊，俾使財務報告使用者了解本公司可能無法遵循合約條款而須於報導期間後 12 個月內還款之風險。

2020 年修正規定，為負債分類之目的，前述清償係指移轉現金、其他經濟資源或本公司之權益工具予交易對方致負債之消滅。惟若負債之條款，可能依交易對方之選擇，以移轉本公司之權益工具而導致其清償，且若該選擇權依 IAS 32「金融工具：表達」之規定係單獨認列於權益，則前述條款並不影響負債之分類。

除上述影響外，截至本財務報告通過發布日止，本公司評估其他準則、解釋之修正將不致對財務狀況與財務績效造成重大影響。

(三) IASB 已發布但尚未經金管會認可並發布生效之 IFRS 會計準則

新發布 / 修正 / 修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日(註1)
IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未定
IFRS 17「保險合約」	2023 年 1 月 1 日
IFRS 17 之修正	2023 年 1 月 1 日
IFRS 17 之修正「初次適用 IFRS 17 及 IFRS 9—比較資訊」	2023 年 1 月 1 日
IAS 21 之修正「缺乏可兌換性」	2025 年 1 月 1 日 (註2)

註 1：除另註明外，上述新發布／修正／修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

註 2：適用於 2025 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間。首次適用該修正時，將影響數認列於首次適用日之保留盈餘。當本公司以非功能性貨幣作為表達貨幣時，將影響數調整首次適用日權益項下之國外營運機構兌換差額。

截至本財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

#### 四、重大會計政策之彙總說明

##### (一) 遵循聲明

本財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之 IFRS 會計準則編製。

##### (二) 編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具及按確定福利義務現值減除計畫資產公允價值認列之淨確定福利負債外，本財務報告係依歷史成本基礎編製。

##### (三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括：

1. 主要為交易目的而持有之資產；
2. 預期於資產負債表日後 12 個月內實現之資產；及
3. 現金及約當現金（但不包括於資產負債表日後逾 12 個月用以交換或清償負債而受到限制者）。

流動負債包括：

1. 主要為交易目的而持有之負債；
2. 於資產負債表日後 12 個月內到期清償之負債，以及
3. 不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少 12 個月之負債。惟負債之條款可能依交易對方之選擇，以發行權益工具而導致其清償者，並不影響分類。

非屬上述流動資產或流動負債者，係分類為非流動資產或非流動負債。

#### (四) 外 幣

編製財務報告時，以功能性貨幣以外之貨幣（外幣）交易者，係按交易日匯率予以換算認列。於報導期間結束時，外幣貨幣性項目以該日即期匯率重新換算，兌換差額於發生當年度認列為損益；以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目係以決定公允價值當日之匯率換算，所產生之兌換差額列為當年度損益，惟屬公允價值變動認列於其他綜合損益者，其產生之兌換差額列於其他綜合損益；以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算，不再重新換算。

#### (五) 約當現金

約當現金係可隨時轉換成定額現金，且價值變動風險甚小之短期並具高度流動性之投資，係用於滿足短期現金承諾。

#### (六) 存 貨

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。存貨成本之計算採加權平均法。

#### (七) 不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備係以成本認列，後續以成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量。成本包括可直接歸屬於取得或建置資產之增額成本。直接可歸屬於取得、建造或生產符合要件之資產之借款成本，係作為該資產成本之一部分，直到該資產幾乎已達預定使用或出售狀態為止。除上述者外，所有其他借款成本係於發生當年度認列為損益。

建造過程中之不動產、廠房及設備係以成本減除累計減損損失後之金額認列。該等資產於完工並達預期使用狀態時，分類至不動產、廠房及設備之適當類別並開始提列折舊。

折舊係採直線法提列，於資產耐用年限內沖銷其成本減除殘值後之金額。折舊係按下列耐用年數計提：房屋及建築，3至32年；機器設備，3至8年；辦公設備，3至11年；租賃改良，3至16年；其他設備，3至11年。估計耐用年限、殘值及折舊方法於報導期間結束日進行檢視，並推延適用會計估計變動之影響，土地不提列折舊。

於處分或預期無法由使用或處分產生未來經濟效益時，將不動產、廠房及設備予以除列。不動產、廠房及設備除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

#### (八) 無形資產

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷及累計減損損失後之金額衡量。攤銷金額係依直線法按下列耐用年數計提：專門技術，20年；電腦軟體成本，3年；專利權，2年；其他，2至5年。估計耐用年限及攤銷方法於報導期間結束日進行檢視，任何估計變動值之影響係推延適用。

研究階段之支出於發生時認列為費用；發展階段之支出於符合規定條件時，認列為無形資產，採用直線法依其耐用年限分年攤銷，不符合規定條件之支出則列為當年度費用。

#### (九) 不動產、廠房及設備、使用權資產及無形資產之減損

本公司於每一資產負債表日評估是否有任何跡象顯示不動產、廠房及設備、使用權資產及無形資產可能已減損。若有任一減損跡象存在，則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額，本公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。若可按合理基礎分攤時，共用資產亦分攤至個別現金產生單位，反之，則分攤至按可依合理基礎分攤之最小現金產生單位群組。

可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者。個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於其帳面金額時，將該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額，減損損失係認列於損益。

因客戶合約所認列之存貨、不動產、廠房及設備及無形資產先依存貨減損規定及上述規定認列減損，次依合約成本相關資產之帳面金額超過提供相關商品或勞務預期可收取之對價剩餘金額扣除直接相關成本後之金額認列為減損損失，續將合約成本相關資產之帳面金額計入所屬現金產生單位，以進行現金產生單位之減損評估。

當減損損失於後續迴轉時，該資產、現金產生單位或合約成本相關資產之帳面金額調增至修訂後之可回收金額，惟增加後之帳面金額以不超過該資產、現金產生單位或合約成本相關資產若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額（減除攤銷或折舊）。減損損失之迴轉係認列於損益。

#### (十) 金融工具

金融資產與金融負債於本公司成為該工具合約條款之一方時認列於資產負債表。

原始認列金融資產與金融負債時，若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者，係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債之交易成本，則立即認列為損益／亦納入金融資產與金融負債原始認列金額。公允價值之決定方式，請參閱附註二八。

#### (十一) 金融資產

金融資產分類係於金融資產原始認列時視其性質及目的而決定。符合慣例交易金融資產之認列與除列，依相同金融資產種類分別採交易日會計處理。

##### 1. 金融資產種類及衡量

本公司所持有之金融資產種類為透過損益按公允價值衡量之金融資產及按攤銷後成本衡量之金融資產。

##### (1) 透過損益按公允價值衡量之金融資產

係未能符合避險會計條件之衍生金融工具，以公允價值衡量，任何因再衡量產生之利益或損失係認列為損益。

## (2) 按攤銷後成本衡量之金融資產

本公司投資金融資產若同時符合下列兩條件，則分類為按攤銷後成本衡量之金融資產：

- A. 係於某經營模式下持有，該模式之目的係持有金融資產以收取合約現金流量；及
- B. 合約條款產生特定日期之現金流量，該等現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

按攤銷後成本衡量之金融資產（包括現金及約當現金、按攤銷後成本衡量之應收帳款及其他應收款項）於原始認列後，係以有效利息法決定之總帳面金額減除任何減損損失之攤銷後成本衡量，任何外幣兌換損益則認列於損益。

## 2. 金融資產及合約資產之減損

本公司於每一資產負債表日按預期信用損失評估按攤銷後成本衡量之金融資產（含應收帳款）及合約資產之減損損失。

應收帳款按存續期間預期信用損失認列備抵損失。其他金融資產係先評估自原始認列後信用風險是否顯著增加，若未顯著增加，則按 12 個月預期信用損失認列備抵損失，若已顯著增加，則按存續期間預期信用損失認列備抵損失。

預期信用損失係以發生違約之風險作為權重之加權平均信用損失。12 個月預期信用損失係代表金融工具於報導日後 12 個月內可能違約事項所產生之預期信用損失，存續期間預期信用損失則代表金融工具於預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

本公司為內部信用風險管理目的，在不考量所持有擔保品之前提下，判定下列情況代表金融資產已發生違約：

- (1) 有內部或外部資訊顯示債務人已不可能清償債務。
- (2) 逾期超過 90 天，除非有合理且可佐證之資訊顯示延後之違約基準更為適當。

所有金融資產之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額。

### 3. 金融資產之除列

本公司僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

按攤銷後成本衡量之金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價間之差額係認列於損益。

## (十二) 金融負債及權益工具

### 1. 金融負債或權益工具之分類

本公司發行之債務及權益工具係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義分類為金融負債或權益。

### 2. 權益工具

權益工具係指表彰本公司於資產減除其所有負債後剩餘權益之任何合約。本公司發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

### 3. 金融負債

金融負債係按有效利息法計算之攤銷後成本或透過損益按公允價值作後續衡量。

透過損益按公允價值衡量之金融負債係未能符合避險會計要件之衍生金融工具，以公允價值衡量，任何因再衡量產生之利益或損失係認列為損益。

金融負債非屬持有供交易目的且未指定為透過損益按公允價值衡量者，於後續報導期間結束日係按攤銷後成本衡量。

### 4. 金融負債之除列

本公司僅於義務解除、取消或到期時，始將金融負債除列。除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額之差額認列為損益。

### (十三) 衍生金融工具

本公司簽訂之衍生工具包括遠期外匯合約，用以管理本公司之匯率風險。

衍生工具於簽訂衍生工具合約時，原始以公允價值認列，後續於資產負債表日按公允價值再衡量，後續衡量產生之利益或損失直接列入損益，然指定且為有效避險工具之衍生工具，其認列於損益之時點則將視避險關係之性質而定。當衍生工具之公允價值為正值時，列為金融資產；公允價值為負值時，列為金融負債。

### (十四) 負債準備

本公司因過去事件負有現時義務（法定或推定義務），且很有可能須清償該義務，並對該義務金額能可靠估計時，認列負債準備。

認列為負債準備之金額係考量義務之風險及不確定性，而為資產負債表日清償義務所須支出之最佳估計。若負債準備係以清償該現時義務之估計現金流量衡量，其帳面金額係為該等現金流量之現值。

### (十五) 收入認列

#### 1. 封裝服務收入

本公司於客戶封裝服務合約辨認履約義務後，於滿足各履約義務時認列收入。

封裝服務係依客戶約定規格製造商品，由於客戶於封裝服務過程中即對商品取得控制，故本公司係隨時間逐步認列收入。封裝服務收入係按已收或應收對價之公允價值衡量，並扣除估計之客戶退貨、折扣及其他類似之折讓。

#### 2. 測試服務收入

本公司於履行測試合約時，客戶同時取得並耗用本公司履約所提供之效益，本公司對迄今已完成履約之款項具有可執行之權利，故本公司係隨時間逐步認列測試合約之收入。

本公司基於歷史經驗及考量不同之合約條件，以估計可能發生之銷貨退回及折讓，據以認列退款負債（帳列應付費用及其他流動負債）。

本公司對客戶之授信期間原則上為月結 30 天至 60 天，部分客戶則為發票日後 30 天。封裝及測試服務收入之對價為短期應收款，因折現效果不重大，故按原始發票金額衡量。

## (十六) 租賃

本公司於合約成立日評估合約是否係屬（或包含）租賃。

### 1. 本公司為出租人

當租賃條款係移轉附屬於資產所有權之幾乎所有風險與報酬予承租人，則將其分類為融資租賃。所有其他租賃則分類為營業租賃。

營業租賃下，減除租賃誘因後之租賃給付係按直線基礎於相關租賃期間內認列為收益。

### 2. 本公司為承租人

除適用認列豁免之低價值標的資產租賃及短期租賃之租賃給付係按直線基礎於租賃期間內認列為費用，其他租賃皆於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債。

使用權資產原始按成本（包含租賃負債之原始衡量金額、租賃開始日前支付之租賃給付減除收取之租賃誘因、原始直接成本及復原標的資產之估計成本）衡量，後續按成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量，並調整租賃負債之再衡量數。使用權資產係單獨表達於資產負債表。

使用權資產採直線基礎自租賃開始日起至耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者提列折舊。

租賃負債原始按租賃給付（包含固定給付及取決於指數之變動租賃給付）之現值衡量。若租賃隱含利率容易確定，租賃給付使用該利率折現。若該利率並非容易確定，則使用承租人增額借款利率。

後續，租賃負債採有效利息法按攤銷後成本基礎衡量，且利息費用係於租賃期間分攤。若租賃期間、用於決定租賃給付之指數變動導致未來租賃給付有變動，本公司再衡量租賃負債，並相對調整使用權資產，惟若使用權資產之帳面金額已減至零，

則剩餘之再衡量金額認列於損益中。租賃負債係單獨表達於資產負債表。

租賃協議中非取決於指數或費率之變動租金於發生當年度認列為費用。

#### (十七) 員工福利

##### 1. 短期員工福利

短期員工福利相關負債係以換取員工服務而預期支付之非折現金額衡量。

##### 2. 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務期間將應提撥之退休金數額認列為費用。

確定福利退休計畫之確定福利成本（含服務成本、淨利息及再衡量數）係採預計單位福利法精算。服務成本（含當年度服務成本）及淨確定福利負債（資產）淨利息於發生時認列為員工福利費用。再衡量數（含精算損益及扣除利息後之計畫資產報酬）於發生時認列於其他綜合損益並列入保留盈餘，後續期間不重分類至損益。

淨確定福利負債（資產）係確定福利退休計畫之提撥短絀（剩餘）。淨確定福利資產不得超過從該計畫退還提撥金或可減少未來提撥金之現值。

#### (十八) 股份基礎給付協議

本公司對於轉換日前已既得之員工認股權，選擇適用國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務報導準則」之豁免。

本公司於101年1月1日後給與之員工認股權，係以給與日員工認股權之公允價值衡量。員工認股權係按給與日所決定之公允價值及預期既得員工認股權之最佳估計數量，於既得期間內以直線基礎認列費用，並同時調整資本公積—員工認股權。後續資訊顯示預期既得之認股權數量與估計不同時，則修正原估計數。若其於給與日立即既得，係於給與日全數認列費用。

本公司給與之現金交割股份基礎給付協議，係認列為取得商品或勞務所產生之負債，並以所承擔負債之公允價值作為原始衡量。該負債係於清償前之每一資產負債表日及清償日再衡量其公允價值，並將公允價值變動認列為損益。

本公司發行限制員工權利股票時，係於給與日認列其他權益（員工未賺得酬勞），並同時調整資本公積－限制員工權利股票。若屬有償發行，且約定員工離職時須退還價款者，應認列相關應付款。若員工於既得期間內離職無須返還已領取之股利，於宣告發放股利時認列費用，並同時調整保留盈餘及資本公積－限制員工權利股票。

本公司於每一資產負債表日修正預期既得之限制員工權利股票估計數量。若有修正原估計數量，其影響數係認列為損益，使累計費用反映修正之估計數，並相對調整資本公積－限制員工權利股票。

#### (十九) 所得稅

所得稅費用係當年度所得稅及遞延所得稅之總和。

##### 1. 當年度所得稅

依中華民國所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵所得稅，係於股東會決議年度認列。

以前年度應付所得稅之調整，列入當年度所得稅。

##### 2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。

遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列，而遞延所得稅資產則於很有可能有課稅所得以供可減除暫時性差異、虧損扣抵或購置機器設備、研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減使用時認列。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視，並針對已不再很有可能有足夠之課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者，亦於每一資產負債表日予以重新檢視，並在未來很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當年度之稅率衡量，該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映本公司於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債帳面金額之方式所產生之租稅後果。

### 3. 當年度及遞延所得稅

當年度及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當年度及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

## 五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本公司於採用附註四所述之會計政策時，對於不易自其他來源取得相關資訊者，管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

本公司於發展重大會計估計值時，將通貨膨脹及市場利率波動可能之影響，納入對現金流量推估、成長率、折現率、獲利能力等相關重大會計估計之考量，管理階層將持續檢視估計與基本假設。若估計之修正僅影響當年度，則於修正當年度認列；若會計估計之修正同時影響當年度及未來期間，則於修正當年度及未來期間認列。

### 重大會計判斷

#### (一) 收入認列

本公司依照客戶合約之約定及所適用之相關法規，評估履約義務係隨時間逐步滿足，其條件如附註四、(十五)所述。相關銷貨退回及折讓之估列係基於歷史經驗及考量不同合約條件，以估計可能發生之產品退回及折讓，於當年度滿足各履約義務時認列為營業收入之減項，且管理階層定期檢視估計之合理性。

### 估計及假設不確定性之主要來源

#### (一) 存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低者計價，故本公司必須運用判斷及估計決定報導期間結束日存貨之淨變現價值。

由於科技快速變遷，本公司評估報導期間結束日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能產生重大變動。

#### 六、現金及約當現金

	112年12月31日	111年12月31日
現金及銀行存款	\$ 3,692,965	\$ 3,466,150
附買回條件公司債	<u>27,000</u>	<u>44,000</u>
	<u>\$ 3,719,965</u>	<u>\$ 3,510,150</u>

#### 七、透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債

	112年12月31日	111年12月31日
衍生金融資產		
遠期外匯合約	<u>\$ 20,932</u>	<u>\$ 4,551</u>
衍生金融負債		
遠期外匯合約	<u>\$ -</u>	<u>\$ 5,174</u>

本公司從事衍生金融工具交易之目的，主要係為規避因匯率波動所產生之風險。本公司上述之衍生金融工具因不符合有效避險條件，故不適用避險會計。

本公司尚未到期之遠期外匯合約如下：

	到	期	期	間	合	約	金	額	(	仟	元	)
<u>112年12月31日</u>												
Sell USD/ Buy NTD	113年1月	~	113年2月		USD	37,930/	NTD	1,187,166				
<u>111年12月31日</u>												
Sell USD/ Buy NTD	112年1月	~	112年3月		USD	46,070/	NTD	1,414,325				

#### 八、應收帳款

	112年12月31日	111年12月31日
<u>非關係人</u>		
應收帳款	\$ 178,633	\$ 247,922
備抵損失	( <u>172</u> )	( <u>220</u> )
應收帳款淨額	<u>178,461</u>	<u>247,702</u>
<u>關係人</u>		
應收帳款	1,020,153	1,047,375
備抵損失	<u>-</u>	<u>-</u>
應收帳款淨額	<u>1,020,153</u>	<u>1,047,375</u>
合計	<u>\$ 1,198,614</u>	<u>\$ 1,295,077</u>

本公司對客戶之授信期間原則上為月結 30 天至 60 天，部分客戶則為發票日後 30 天。本公司參考歷史經驗及考量個別客戶現時財務狀況及未來展望（如參考客戶所處產業展望以及未來一定期間之採購需求變化等），除個別客戶實際發生信用減損提列減損損失外，將個別客戶區分為不同風險群組並依各群組之預期損失率認列備抵損失；另針對逾期超過 90 天且無其他信用保證方式之應收帳款係認列 100%備抵損失。

除已提列減損者，其餘應收帳款金額於報導期間結束日之帳齡分析請參閱下表。本公司針對已逾期但未提列減損之應收帳款，經評估其信用品質並未發生重大改變且相關帳款仍可回收，故尚無減損疑慮。

#### 應收帳款淨額之帳齡分析

	112年12月31日	111年12月31日
未逾期亦未減損	\$ 1,198,614	\$ 1,294,632
逾期 30 天	-	445
合 計	<u>\$ 1,198,614</u>	<u>\$ 1,295,077</u>

應收帳款備抵損失之變動資訊如下：

	112年度	111年度
年初餘額	\$ 220	\$ 280
加：本年度迴轉減損損失	( 48)	( 60)
年底餘額	<u>\$ 172</u>	<u>\$ 220</u>

#### 九、存 貨

	112年12月31日	111年12月31日
原 物 料	<u>\$211,195</u>	<u>\$273,986</u>

本公司與存貨相關之營業成本中，分別包括下列收益及費損：

	112年度	111年度
存貨跌價損失	(\$ 5,708)	(\$ 4,978)
出售下腳收入	<u>\$ 441</u>	<u>\$ 1,930</u>

十、不動產、廠房及設備

	112年12月31日	111年12月31日
自用	\$ 4,278,575	\$ 3,789,034
營業租賃出租	<u>62,445</u>	<u>64,299</u>
	<u>\$ 4,341,020</u>	<u>\$ 3,853,333</u>

(一) 自用

	土	地	房屋及建築	機器設備	辦公設備	租賃改良	其他設備	未完工程及 待驗設備	合 計
<u>成 本</u>									
112年1月1日餘額	\$ 795,897	\$ 3,222,111	\$ 8,978,864	\$ 288,199	\$ 663,290	\$ 1,471,972	\$ 628,525	\$ 16,048,858	
增 加	-	16,137	227,069	16,343	-	6,784	834,146	1,100,479	
出售或報廢	-	-	( 96,032)	( 81)	( 821)	( 50)	-	( 96,984)	
112年12月31日餘額	<u>\$ 795,897</u>	<u>\$ 3,238,248</u>	<u>\$ 9,109,901</u>	<u>\$ 304,461</u>	<u>\$ 662,469</u>	<u>\$ 1,478,706</u>	<u>\$ 1,462,671</u>	<u>\$ 17,052,353</u>	
<u>累計折舊及減損</u>									
112年1月1日餘額	\$ -	\$ 1,719,628	\$ 8,714,072	\$ 234,265	\$ 601,009	\$ 990,850	\$ -	\$ 12,259,824	
折 舊	-	273,346	165,423	19,444	18,179	134,546	-	610,938	
出售或報廢	-	-	( 96,032)	( 81)	( 821)	( 50)	-	( 96,984)	
112年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,992,974</u>	<u>\$ 8,783,463</u>	<u>\$ 253,628</u>	<u>\$ 618,367</u>	<u>\$ 1,125,346</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 12,773,778</u>	
112年12月31日淨額	<u>\$ 795,897</u>	<u>\$ 1,245,274</u>	<u>\$ 326,438</u>	<u>\$ 50,833</u>	<u>\$ 44,102</u>	<u>\$ 353,360</u>	<u>\$ 1,462,671</u>	<u>\$ 4,278,575</u>	
<u>成 本</u>									
111年1月1日餘額	\$ 789,515	\$ 3,138,349	\$ 8,984,834	\$ 262,952	\$ 667,293	\$ 1,450,295	\$ 231,622	\$ 15,524,860	
增 加	6,382	84,903	150,496	25,247	10,497	27,980	396,903	702,408	
出售或報廢	-	( 1,141)	( 156,466)	-	( 14,500)	( 6,303)	-	( 178,410)	
111年12月31日餘額	<u>\$ 795,897</u>	<u>\$ 3,222,111</u>	<u>\$ 8,978,864</u>	<u>\$ 288,199</u>	<u>\$ 663,290</u>	<u>\$ 1,471,972</u>	<u>\$ 628,525</u>	<u>\$ 16,048,858</u>	
<u>累計折舊及減損</u>									
111年1月1日餘額	\$ -	\$ 1,428,622	\$ 8,647,590	\$ 217,505	\$ 571,146	\$ 836,367	\$ -	\$ 11,701,230	
折 舊	-	292,147	222,921	16,760	42,248	160,786	-	734,862	
出售或報廢	-	( 1,141)	( 156,439)	-	( 12,385)	( 6,303)	-	( 176,268)	
111年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,719,628</u>	<u>\$ 8,714,072</u>	<u>\$ 234,265</u>	<u>\$ 601,009</u>	<u>\$ 990,850</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 12,259,824</u>	
111年12月31日淨額	<u>\$ 795,897</u>	<u>\$ 1,502,483</u>	<u>\$ 264,792</u>	<u>\$ 53,934</u>	<u>\$ 62,281</u>	<u>\$ 481,122</u>	<u>\$ 628,525</u>	<u>\$ 3,789,034</u>	

本公司建築物之重大組成部分主要有廠房主建物、機電動力設備及無塵潔淨室等，分別按其耐用年限 18 至 32 年、7 至 11 年及 10 至 11 年提列折舊；機器設備之重大組成部分主要有蝕刻機、濺鍍機等，按其耐用年限 3 至 8 年提列折舊。

(二) 營業租賃出租

	房屋及建築	辦公設備	其他設備	合 計
<u>成 本</u>				
112年1月1日及12月 31日餘額	<u>\$ 155,399</u>	<u>\$ 2,009</u>	<u>\$ 21,909</u>	<u>\$ 179,317</u>
<u>累計折舊</u>				
112年1月1日餘額	\$ 92,974	\$ 2,009	\$ 20,035	\$ 115,018
折舊費用	<u>1,124</u>	<u>-</u>	<u>730</u>	<u>1,854</u>
112年12月31日餘額	<u>\$ 94,098</u>	<u>\$ 2,009</u>	<u>\$ 20,765</u>	<u>\$ 116,872</u>
112年12月31日淨額	<u>\$ 61,301</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,144</u>	<u>\$ 62,445</u>

(接次頁)

(承前頁)

	房屋及建築	辦公設備	其他設備	合計
成本				
111年1月1日及12月31日餘額	\$ 155,399	\$ 2,009	\$ 21,909	\$ 179,317
累計折舊				
111年1月1日餘額	\$ 90,291	\$ 1,987	\$ 18,345	\$ 110,623
折舊費用	2,683	22	1,690	4,395
111年12月31日餘額	\$ 92,974	\$ 2,009	\$ 20,035	\$ 115,018
111年12月31日淨額	\$ 62,425	\$ -	\$ 1,874	\$ 64,299

本公司部分廠房及廠務設施以營業租賃方式出租予采鈺科技股份有限公司（采鈺公司），租約內容係由租賃雙方協議決定，租賃期間為1~2年，並有延展租期之選擇權，租金按月收取，租金收入及出租資產折舊帳列其他營業收益及費損項下。承租人於租賃期間結束時，對該資產不具有承購權。與采鈺公司之出租合約係依實際產能調整租賃給付。

營業租賃出租自有建築物之未來將收取之租賃給付總額如下：

	112年12月31日	111年12月31日
不超過1年	\$ 69,525	\$ 81,528
1~5年	-	70,275
	\$ 69,525	\$ 151,803

本公司以營業租賃出租建築物係按其耐用年限2至5年予以計提折舊。

## 十一、租賃協議

### (一) 使用權資產

	112年12月31日	111年12月31日
使用權資產帳面金額		
房屋及建築	\$ 208,335	\$ 208,108
	112年度	111年度
使用權資產之增添（減少）	\$ 39,301	(\$ 7,927)
使用權資產之折舊費用		
房屋及建築	\$ 39,074	\$ 37,914

(二) 租賃負債

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
租賃負債帳面金額		
流    動	\$ 39,507	\$ 33,157
非 流 動	\$172,609	\$178,104

租賃負債之折現率區間如下：

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
房屋及建築	0.84%~2.25%	0.84%~2.25%

(三) 重要承租活動及條款

本公司承租建築物做為廠房、辦公室使用，租賃期間為 5~15 年。於中壢工業區建築物租賃合約約定依消費者物價指數調整租賃給付。另於租賃期間終止時，本公司對所租賃之土地及建築物並無優惠承購權，並約定未經出租人同意，本公司不得將租賃標的之全部或一部轉租或轉讓。

(四) 其他租賃資訊

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
低價值資產租賃費用	\$ 23,002	\$ 9,097
租賃之現金流出總額	\$ 65,629	\$ 48,579

本公司選擇對符合低價值資產租賃之其他設備適用認列之豁免，不對該等租賃認列相關使用權資產及租賃負債。

十二、無形資產

	<u>專 門 技 術</u>	<u>電 腦 軟 體 成 本</u>	<u>專 利 權 及 其 他</u>	<u>合 計</u>
<u>成    本</u>				
112年1月1日餘額	\$ 113,340	\$ 91,065	\$ 204,251	\$ 408,656
增    加	<u>-</u>	<u>1,499</u>	<u>3,276</u>	<u>4,775</u>
112年12月31日餘額	\$ 113,340	\$ 92,564	\$ 207,527	\$ 413,431
<u>累計攤銷</u>				
112年1月1日餘額	\$ 113,340	\$ 85,344	\$ 178,709	\$ 377,393
增    加	<u>-</u>	<u>3,023</u>	<u>12,231</u>	<u>15,254</u>
112年12月31日餘額	\$ 113,340	\$ 88,367	\$ 190,940	\$ 392,647
112年12月31日淨額	\$ -	\$ 4,197	\$ 16,587	\$ 20,784

(接次頁)

(承前頁)

	專 門 技 術	電 腦 軟 體 成 本	專 利 權 及 其 他	合 計
<u>成 本</u>				
111年1月1日餘額	\$ 113,340	\$ 87,225	\$ 200,476	\$ 401,041
增 加	<u>-</u>	<u>3,840</u>	<u>3,775</u>	<u>7,615</u>
111年12月31日餘額	<u>\$ 113,340</u>	<u>\$ 91,065</u>	<u>\$ 204,251</u>	<u>\$ 408,656</u>
<u>累計攤銷</u>				
111年1月1日餘額	\$ 113,340	\$ 82,330	\$ 167,253	\$ 362,923
增 加	<u>-</u>	<u>3,014</u>	<u>11,456</u>	<u>14,470</u>
111年12月31日餘額	<u>\$ 113,340</u>	<u>\$ 85,344</u>	<u>\$ 178,709</u>	<u>\$ 377,393</u>
111年12月31日淨額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 5,721</u>	<u>\$ 25,542</u>	<u>\$ 31,263</u>

本公司未有將上述無形資產提供設定質押作為擔保。

#### 十三、其他流動資產

	112年12月31日	111年12月31日
預付費用	\$ 47,824	\$ 41,252
暫付款	5,248	4,195
預付貨款	1,386	6,196
應收退稅款	<u>-</u>	<u>2,198</u>
	<u>\$ 54,458</u>	<u>\$ 53,841</u>

#### 十四、負債準備

	112年12月31日	111年12月31日
<u>非流動</u>		
除役成本	<u>\$404,913</u>	<u>\$368,483</u>
		<u>除 役 成 本</u>
<u>112 年度</u>		
年初餘額		\$368,483
本年度提列		<u>36,430</u>
年底餘額		<u>\$404,913</u>
<u>111 年度</u>		
年初餘額		\$339,703
本年度提列		39,497
本年度沖銷		( 2,115)
本年度迴轉		( <u>8,602</u> )
年底餘額		<u>\$368,483</u>

除役成本負債準備係拆卸、移除相關設備及復原其所在地點所產生之除役負債準備，其金額以預期清償義務之現金流量估計折現值衡量，於報導期間結束日進行適當之評估及調整。

#### 十五、應付費用及其他流動負債

	112年12月31日	111年12月31日
應付委外加工費	\$107,339	\$110,549
應付電費	47,251	38,069
應付勞健保	28,910	31,947
退款負債	26,337	45,600
應付退休金	15,551	15,607
應付防治污染處理費	9,624	9,602
應付租金	2,370	2,461
其他	<u>174,215</u>	<u>177,622</u>
	<u>\$411,597</u>	<u>\$431,457</u>

#### 十六、退職後福利計畫

##### (一) 確定提撥計畫

本公司依「勞工退休金條例」訂定之員工退休計畫，係屬確定提撥退休辦法。本公司依員工每月薪資6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。依上述相關規定，本公司於112及111年度於綜合損益表認列為費用之金額分別為52,287仟元及51,009仟元。

##### (二) 確定福利計畫

本公司依「勞動基準法」訂定之員工退休辦法，係屬確定福利退休辦法。依該辦法之規定，員工退休金係按服務年資及退休前6個月之平均薪資計算。本公司按員工每月薪資總額2%提撥員工退休金基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶，本公司依據勞工退休準備金提撥及管理辦法第五條規定，已暫停提撥勞工退休準備金。

列入資產負債表之確定福利計畫金額列示如下：

	112年12月31日	111年12月31日
確定福利義務現值	\$ 48,268	\$ 50,416
計畫資產公允價值	( <u>57,515</u> )	( <u>57,281</u> )
淨確定福利資產	( <u>\$ 9,247</u> )	( <u>\$ 6,865</u> )

淨確定福利資產變動如下：

	確 定 福 利 義 務 現 值	計 畫 資 產 公 允 價 值	淨 確 定 福 利 負 債 ( 資 產 )
112年1月1日	\$ 50,416	(\$ 57,281)	(\$ 6,865)
利息費用(收入)	677	( 770)	( 93)
認列於損益	677	( 770)	( 93)
再衡量數			
計畫資產報酬	-	( 441)	( 441)
精算損失—人口統			
計假設變動	9	-	9
精算損失—財務假			
設變動	261	-	261
精算利益—經驗調			
整	( 2,118)	-	( 2,118)
認列於其他綜合損益	( 1,848)	( 441)	( 2,289)
雇主提撥	-	-	-
福利支付	( 977)	977	-
112年12月31日	\$ 48,268	(\$ 57,515)	(\$ 9,247)
111年1月1日	\$ 51,048	(\$ 52,904)	(\$ 1,856)
利息費用(收入)	355	( 374)	( 19)
認列於損益	355	( 374)	( 19)
再衡量數			
計畫資產報酬	-	( 4,039)	( 4,039)
精算利益—人口統			
計假設變動	( 10)	-	( 10)
精算利益—財務假			
設變動	( 909)	-	( 909)
精算損失—經驗調			
整	602	-	602
認列於其他綜合損益	( 317)	( 4,039)	( 4,356)
雇主提撥	-	( 634)	( 634)
福利支付	( 670)	670	-
111年12月31日	\$ 50,416	(\$ 57,281)	(\$ 6,865)

確定福利計畫認列於損益之金額依功能別彙總如下：

	112年度	111年度
管理費用	(\$ 93)	(\$ 19)

本公司因「勞動基準法」之退休金制度曝露於下列風險：

1. 投資風險：勞動部勞動基金運用局透過自行運用及委託經營方式，將勞工退休基金分別投資於國內（外）權益證券與債務證

券及銀行存款等標的，惟本公司之計畫資產得分配金額係以不低於當地銀行 2 年定期存款利率計算而得之收益。

2. 利率風險：政府公債之利率下降將使確定福利義務現值增加，惟計畫資產之債務投資報酬亦會隨之增加，兩者對淨確定福利負債之影響具有部分抵銷之效果。
3. 薪資風險：確定福利義務現值之計算係參考計畫成員之未來薪資。因此計畫成員薪資之增加將使確定福利義務現值增加。

本公司之計畫資產及確定福利義務現值，係由合格精算師進行精算。精算評價於衡量日之主要假設如下：

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
折現率	1.3%	1.35%
薪資預期增加率	3.00%	3.00%

若重大精算假設分別發生合理可能之變動，在所有其他假設維持不變之情況下，將使確定福利義務現值增加（減少）之金額如下：

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
折現率		
增加 0.25%	(\$ 1,284)	(\$ 1,386)
減少 0.25%	<u>\$ 1,335</u>	<u>\$ 1,441</u>
薪資預期增加率		
增加 0.25%	<u>\$ 1,310</u>	<u>\$ 1,414</u>
減少 0.25%	(\$ 1,266)	(\$ 1,367)

由於精算假設可能彼此相關，僅單一假設變動之可能性不大，故上述敏感度分析可能無法反映確定福利義務現值實際變動情形。

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
預期 1 年內提撥金額	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
確定福利義務平均到期期間	10 年	11 年

未折現之退休金福利支付到期分析

不超過 1 年	\$ 562	\$ 467
1~5 年	8,423	7,601
超過 5 年	<u>46,309</u>	<u>50,718</u>
	<u>\$ 55,294</u>	<u>\$ 58,786</u>

## 十七、權益

### (一) 普通股股本

	112年12月31日	111年12月31日
額定股數(仟股)	<u>400,000</u>	<u>400,000</u>
額定股本	<u>\$ 4,000,000</u>	<u>\$ 4,000,000</u>
已發行且付清股款之股數(仟股)	<u>271,364</u>	<u>271,364</u>
已發行股本	<u>\$ 2,713,643</u>	<u>\$ 2,713,643</u>

已發行之普通股每股面額為 10 元，每股享有一表決權及收取股利之權利。

額定股本中供發行員工認股權憑證所保留之股本為 12,000 仟股。

### (二) 資本公積

	112年12月31日	111年12月31日
<u>得用以彌補虧損、發放現金或撥充股本(註)</u>		
股票發行溢價—普通股溢價	<u>\$396,424</u>	<u>\$396,424</u>

註：依照法令規定，超過票面金額發行普通股股票溢額所產生之資本公積得用以彌補虧損，亦得於公司無虧損時，用以發放現金股利或撥充股本，惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。

### (三) 保留盈餘及股利政策

依本公司章程規定之盈餘分派政策，年度決算如有盈餘，應先依法完納稅捐，彌補累積虧損後，次提撥百分之十為法定盈餘公積，如法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，得不提列，其餘再依法令或主管機關規定應提列及迴轉特別盈餘公積後；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議分派之。

另本公司章程規定之員工及董事酬勞分派政策，請參閱附註二五。

本公司股利發放政策係依據公司資本預算、中長期營運規劃及財務狀況，依下列原則經股東會決議後分派之：

1. 本公司得依財務、業務及經營面等因素之考量將當年度可分配盈餘全數分派。盈餘之分派得以股票股利或現金股利之方式為之，但因本公司目前正處於營運成長期，未來將視擴充計劃及投資資金之需求，於分派當年度可分配盈餘時，現金股利分派之比例以不低於股利總額之 50%。
2. 於當年度公司無盈餘可分派，或雖有盈餘但盈餘數額遠低於公司前一年度實際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或一部分依法令或主管機關規定分派。

上述盈餘分派案應於翌年召開股東常會時予以決議承認。

法定盈餘公積應提撥至其總額達公司實收股本總額為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損；公司無虧損者，得以法定盈餘公積超過實收股本總額 25% 之部分按股東原有股份之比例發給新股或現金。

本公司分派盈餘時，必須依法令規定就當年底之股東權益減項淨額（如現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具損益等累計餘額）提列特別盈餘公積。嗣後股東權益減項金額如有減少，可就減少金額自特別盈餘公積轉回未分配盈餘。

本公司於 111 年 5 月 26 日舉行股東常會，決議 110 年度之盈餘分派案如下：

	110年度
	<u>盈 餘 分 派 案</u>
年初未分配盈餘	\$ 1,036,440
確定福利計劃之再衡量數	2,051
110 年度淨利	1,877,082
法定盈餘公積	( 187,914)
現金股利	( <u>814,093</u> )
年底未分配盈餘	<u>\$ 1,913,566</u>
每股現金股利（元）	<u>\$ 3</u>

本公司於 112 年 5 月 29 日舉行股東常會，決議 111 年度之盈餘分派案如下：

	<u>111年度</u>
	<u>盈 餘 分 派 案</u>
年初未分配盈餘	\$ 1,913,566
確定福利計劃之再衡量數	4,356
111 年度淨利	1,983,736
法定盈餘公積	( 198,809)
現金股利	( <u>814,093</u> )
年底未分配盈餘	<u>\$ 2,888,756</u>
每股現金股利 (元)	<u>\$ 3</u>

本公司 113 年 2 月 6 日董事會擬議 112 年度盈餘分派案如下：

	<u>112年度</u>
	<u>盈 餘 分 派 案</u>
年初未分配盈餘	\$ 2,888,756
確定福利計劃之再衡量數	2,289
112 年度淨利	1,375,774
法定盈餘公積	( 137,806)
現金股利	( <u>542,729</u> )
年底未分配盈餘	<u>\$ 3,586,284</u>
每股現金股利 (元)	<u>\$ 2</u>

有關 112 年度之盈餘分派案，尚待預計於 113 年 5 月 30 日召開之股東常會決議。

## 十八、營業收入

### (一) 客戶合約之說明

#### 晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝

依客戶約定規格提供商品封裝服務產生之收入，由於客戶於封裝服務過程中即對商品取得控制，故本公司封裝服務合約係隨時間逐步認列收入。

#### 晶圓測試

本公司於履行測試合約時，客戶同時取得並耗用本公司履約所提供之效益，本公司對迄今已完成履約之款項具有可執行之權利，故本公司係隨時間逐步認列測試合約之收入。

(二) 客戶合約收入之細分

產 品 別	112年度	111年度
晶圓級尺寸封裝	\$ 4,178,957	\$ 5,484,537
晶圓測試	1,700,493	1,528,126
晶圓級後護層封裝	428,283	616,837
其 他	79,135	102,297
	<u>\$ 6,386,868</u>	<u>\$ 7,731,797</u>

地 區 別	112年度	111年度
亞 洲	\$ 5,377,139	\$ 6,023,165
美 國	978,623	1,634,665
歐 洲	31,106	73,967
	<u>\$ 6,386,868</u>	<u>\$ 7,731,797</u>

客 戶 別	112年度	111年度
晶圓廠代工公司	\$ 5,076,877	\$ 5,772,030
IC 設計公司	1,309,991	1,959,767
	<u>\$ 6,386,868</u>	<u>\$ 7,731,797</u>

產 品 應 用 別	112年度	111年度
消費性電子	\$ 5,467,386	\$ 6,523,185
車用電子	919,482	1,208,612
	<u>\$ 6,386,868</u>	<u>\$ 7,731,797</u>

(三) 合約餘額

	112年12月31日	111年12月31日	111年1月1日
非關係人			
合約資產	\$ 39,146	\$ 61,018	\$ 68,440
備抵損失	( 39)	( 60)	( 68)
合約資產淨額	<u>39,107</u>	<u>60,958</u>	<u>68,372</u>
關 係 人			
合約資產	136,662	99,763	329,555
備抵損失	-	-	-
合約資產淨額	<u>136,662</u>	<u>99,763</u>	<u>329,555</u>
合 計	<u>\$ 175,769</u>	<u>\$ 160,721</u>	<u>\$ 397,927</u>

合約資產之變動主要係來自滿足履約義務之時點與客戶付款時點之差異。

112 及 111 年度迴轉預期信用損失之金額分別為(21)仟元及(8)仟元。

合約資產備抵損失之變動資訊如下：

	112年度	111年度
年初餘額	\$ 60	\$ 68
加：本年度迴轉減損損失	( 21)	( 8)
年底餘額	<u>\$ 39</u>	<u>\$ 60</u>

(四) 部分完成之客戶合約

尚未全部滿足之履約義務受攤之交易價格及預期認列為收入之時點如下：

	112年12月31日	111年12月31日
封裝服務		
113年第1季履行	\$175,769	\$ -
112年第1季履行	<u>\$ -</u>	<u>\$160,721</u>

十九、其他營業收益及費損淨額

	112年度	111年度
出租資產收益(費損)		
租金收入	\$ 82,192	\$ 79,752
出租資產折舊	( 1,854)	( 4,395)
其他	( 16,476)	( 13,927)
	63,862	61,430
處分不動產、廠房及設備淨益	3,728	31,926
其他	-	8,730
	<u>\$ 67,590</u>	<u>\$102,086</u>

二十、利息收入

	112年度	111年度
利息收入		
銀行存款	<u>\$ 49,242</u>	<u>\$ 19,040</u>

二一、財務成本

	112年度	111年度
利息費用		
租賃負債之利息	\$ 4,090	\$ 4,419
銀行借款	3	-
	<u>\$ 4,093</u>	<u>\$ 4,419</u>

## 二二、其他利益及損失

	112年度	111年度
外幣兌換淨(損)益	(\$ 10,925)	\$135,117
透過損益按公允價值衡量之金融工具淨益(損)	10,561	( 109,397)
其他	625	1,956
	<u>\$ 261</u>	<u>\$ 27,676</u>

## 二三、所得稅

### (一) 認列於損益之所得稅

本年度認列於損益之所得稅組成如下：

	112年度	111年度
當年度所得稅		
當年度產生者	\$291,328	\$450,609
未分配盈餘加徵	42,326	41,156
以前年度之調整	2,991	( 5,834)
遞延所得稅		
與暫時性差異產生及迴轉有關	38,083	31,331
認列於損益之所得稅費用	<u>\$374,728</u>	<u>\$517,262</u>

會計所得與當年度所得稅費用之調節如下：

	112年度	111年度
稅前淨利	<u>\$ 1,750,502</u>	<u>\$ 2,500,998</u>
稅前淨利按法定稅率計算之所得稅費用	\$ 350,100	\$ 500,199
調節項目之所得稅影響數		
決定課稅所得時應予調減之項目	( 38,083)	( 31,331)
未分配盈餘加徵	42,326	41,156
當年度抵用之投資抵減及虧損扣抵	( 20,689)	( 18,259)
暫時性差異之產生及迴轉	38,083	31,331
以前年度之當期所得稅費用於本年度之調整	2,991	( 5,834)
認列於損益之所得稅費用	<u>\$ 374,728</u>	<u>\$ 517,262</u>

## (二) 遞延所得稅

資產負債表中之遞延所得稅資產分析如下：

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
暫時性差異		
折 舊	\$ 5,978	\$ 37,659
退款負債	5,267	9,120
未實現存貨損失	9,103	7,961
其 他	<u>1,952</u>	<u>5,643</u>
	<u>\$ 22,300</u>	<u>\$ 60,383</u>

遞延所得稅資產之變動如下：

	<u>年 初 餘 額</u>	<u>認列於(損)益</u>	<u>年 底 餘 額</u>
<u>112 年度</u>			
暫時性差異			
折 舊	\$ 37,659	(\$ 31,681)	\$ 5,978
退款負債	9,120	( 3,853)	5,267
未實現存貨損失	7,961	1,142	9,103
其 他	<u>5,643</u>	<u>( 3,691)</u>	<u>1,952</u>
	<u>\$ 60,383</u>	<u>(\$ 38,083)</u>	<u>\$ 22,300</u>
<u>111 年度</u>			
暫時性差異			
折 舊	\$ 77,718	(\$ 40,059)	\$ 37,659
退款負債	4,607	4,513	9,120
未實現存貨損失	6,965	996	7,961
其 他	<u>2,424</u>	<u>3,219</u>	<u>5,643</u>
	<u>\$ 91,714</u>	<u>(\$ 31,331)</u>	<u>\$ 60,383</u>

## (三) 所得稅核定情形

本公司截至 110 年度止之所得稅申報案件，業經稅捐稽徵機關核定。各年度經國稅局核定之各項投資抵減稅額差額，業已適當調整入帳。

## 二四、每股盈餘

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
基本每股盈餘	<u>\$ 5.07</u>	<u>\$ 7.31</u>
稀釋每股盈餘	<u>\$ 5.03</u>	<u>\$ 7.21</u>

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下：

	金額 (分子)	股數 (分母) ( 仟 股 )	每 股 盈 餘 ( 元 )
<u>112年度</u>			
基本每股盈餘			
屬於普通股股東之本年度淨利	\$ 1,375,774	271,364	\$ <u>5.07</u>
具稀釋作用潛在普通股之影響	<u>-</u>	<u>2,100</u>	
稀釋每股盈餘			
屬於普通股股東之本期淨利加潛在普通股之影響	\$ <u>1,375,774</u>	<u>273,464</u>	\$ <u>5.03</u>
<u>111年度</u>			
基本每股盈餘			
屬於普通股股東之本年度淨利	\$ 1,983,736	271,364	\$ <u>7.31</u>
具稀釋作用潛在普通股之影響	<u>-</u>	<u>3,604</u>	
稀釋每股盈餘			
屬於普通股股東之本期淨利加潛在普通股之影響	\$ <u>1,983,736</u>	<u>274,968</u>	\$ <u>7.21</u>

若本公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則於計算稀釋每股盈餘時，係假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

## 二五、費用性質之額外資訊

本年度淨利（損）係包含以下項目：

	112年度	111年度
(一) 不動產、廠房及設備暨使用權資產之折舊		
認列於營業成本	\$ 614,853	\$ 743,954
認列於營業費用	35,159	28,822
認列於其他營業收益及費損	<u>1,854</u>	<u>4,395</u>
	\$ <u>651,866</u>	\$ <u>777,171</u>

	112年度	111年度
(二) 無形資產之攤銷		
認列於營業成本	\$ 10,311	\$ 10,535
認列於營業費用	<u>4,943</u>	<u>3,935</u>
	<u>\$ 15,254</u>	<u>\$ 14,470</u>
(三) 發生即認列為費用之研究及發展支出	<u>\$ 369,092</u>	<u>\$ 321,463</u>
(四) 員工福利費用		
退職後福利計畫 (參閱附註十六)		
確定提撥計畫	\$ 52,287	\$ 51,009
確定福利計畫	( <u>93</u> )	( <u>19</u> )
	52,194	50,990
其他員工福利	<u>1,567,548</u>	<u>1,711,818</u>
	<u>\$ 1,619,742</u>	<u>\$ 1,762,808</u>
員工福利費用依功能別彙總		
認列於營業成本	\$ 1,248,498	\$ 1,378,146
認列於營業費用	<u>371,244</u>	<u>384,662</u>
	<u>\$ 1,619,742</u>	<u>\$ 1,762,808</u>

本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞，且董事酬勞給付之對象不包括擔任本公司經理人之董事，員工酬勞及董事酬勞應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依規定比例提撥員工酬勞及董事酬勞。有關員工酬勞部分，其對象得包括從屬公司員工，其條件及分配方式，授權董事會決定之。

本公司 112 及 111 年度估列之員工酬勞、董事酬勞及報酬分別為 232,570 仟元及 328,407 仟元 (含獨立董事報酬分別為 3,566 仟元及 2,520 仟元)，係以稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之利益為基礎按比率估列。其中 112 及 111 年度估列之員工酬勞及董事酬勞分別於 113 年 2 月 6 日及 112 年 2 月 9 日經董事會決議如下：

估列比例

	112年度	111年度
員工酬勞	11.47%	11.47%
董事酬勞	0.10%	0.06%

金 額

	112年度		111年度	
	現	金	現	金
員工酬勞		\$227,024		\$324,207
董事酬勞		1,980		1,680

年度財務報告通過發布日後若金額有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

本公司於 112 年 2 月 9 日經董事會決議發放之 111 年度員工酬勞、董事酬勞及報酬為 328,407 仟元(含獨立董事報酬 2,520 仟元)，前述決議配發金額與本公司 111 年度財務報告認列之金額並無差異。

本公司於 111 年 2 月 10 日經董事會決議發放之 110 年度員工酬勞、董事酬勞及報酬為 290,141 仟元(含獨立董事報酬 2,520 仟元)，前述決議配發金額與本公司 110 年度財務報告認列之金額並無差異。

上述有關本公司員工及董事酬勞相關資訊，請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

二六、資本管理

本公司資本管理係以確保能夠繼續經營之前提下，藉由維持債務及權益餘額之平衡及最適化，以使股東報酬極大化。本公司之資本管理乃確保具有足夠之財務資源，以支應未來 12 個月內之營運資金需求、資本支出、研究發展活動支出、股利支出、債務償還及其他營業需求。

二七、現金流量資訊

來自籌資活動之負債變動如下：

112 年 12 月 31 日

	112年1月1日	現金流量	非現金之變動		112年12月31日
			租賃變動	其他(註)	
租賃負債	\$ 211,261	(\$ 42,536)	\$ 39,301	\$ 4,090	\$ 212,116

111 年 12 月 31 日

	111年1月1日	現金流量	非現金之變動		111年12月31日
			租賃變動	其他(註)	
租賃負債	\$ 255,393	(\$ 40,496)	(\$ 8,055)	\$ 4,419	\$ 211,261

註：其他係租賃負債之財務成本。

## 二八、金融工具

### (一) 金融工具之種類

	112年12月31日	111年12月31日
<u>金融資產</u>		
透過損益按公允價值衡量	\$ 20,932	\$ 4,551
按攤銷後成本衡量 (註1)	<u>4,937,125</u>	<u>4,818,735</u>
	<u>\$ 4,958,057</u>	<u>\$ 4,823,286</u>
<u>金融負債</u>		
透過損益按公允價值衡量	\$ -	\$ 5,174
按攤銷後成本衡量 (註2)	<u>776,015</u>	<u>618,371</u>
	<u>\$ 776,015</u>	<u>\$ 623,545</u>

註1：餘額係包含現金及約當現金、應收帳款(含關係人)、其他金融資產及存出保證金等按攤銷後成本衡量之金融資產。

註2：餘額係包含應付帳款、應付工程及設備款、應付費用及其他流動負債等按攤銷後成本衡量之金融負債。

### (二) 財務風險管理目的

本公司致力於確保公司於必要時具有足夠且具成本效益之營運資本。本公司積極管理與營運活動相關之外幣匯率風險、信用風險及流動性風險等，以降低市場之不確定性對公司財務績效之潛在不利影響。

本公司之重要財務規劃，均經董事會依相關規範及內部控制制度進行覆核。本公司財務部門於執行財務計劃時，均恪遵關於整體財務風險管理及權責劃分之相關財務操作程序。

### (三) 市場風險

本公司曝露於外幣匯率變動之市場風險，並使用衍生金融工具以管理相關風險。

#### 1. 外幣匯率風險

本公司營運活動主要係以外幣進行交易，因此產生外幣匯率風險。為避免因匯率變動造成外幣資產價值下跌及未來現金流量之波動，本公司使用遠期外匯合約等衍生金融工具來規避

匯率風險。此類衍生金融工具之使用，可協助本公司減少但仍無法完全排除外幣匯率變動所造成之影響。

有關外幣匯率風險之敏感性分析，主要係針對報導期間結束日之外幣貨幣性項目，因匯率變動產生之不利影響計算。當新台幣對外幣產生不利之變動達百分之十，本公司於 112 及 111 年度之稅後淨利將分別增加 38,212 仟元及 18,276 仟元，上述數字業已考慮避險合約及被避險項目之影響。

#### (四) 信用風險管理

信用風險係指交易對方違反合約義務並對本公司造成財務損失之風險。本公司之信用風險，主要係來自於營運活動產生之應收款項與投資活動產生之銀行存款。截至資產負債表日，本公司可能因交易對方未履行義務造成財務損失之最大信用風險曝險係資產負債表所認列之金融資產帳面價值。

##### 1. 營運相關信用風險

本公司流通在外之應收帳款主要係來自於全球之客戶群，且大部分應收帳款並未提供擔保品或信用保證。雖然本公司訂有相關程序監督管理並減少應收帳款之信用風險，但並不能保證該程序可以完全有效排除信用風險並避免損失。

本公司之信用風險主要係集中於本公司之前二大客戶。截至 112 年及 111 年 12 月 31 日止，應收帳款及合約資產合計數來自前述客戶之比率分別為 97% 及 95%。

##### 2. 財務信用風險

本公司定期根據市場狀況以及履約交易對象之財務及信用狀況調整交易額度。此外，本公司亦透過挑選信用良好之金融機構作為交易對象以降低信用風險。

#### (五) 流動性風險管理

本公司管理流動性風險之目標，係為確保本公司有足夠之流動資金以支應未來營運需求。本公司係透過維持適當之資金及銀行額度，以支應各項合約義務。

銀行借款對本公司而言係為一項重要流動性來源。截至 112 年及 111 年 12 月 31 日止，本公司未動用之銀行融資額度分別為 3,856,136 仟元及 2,380,130 仟元。

下表係按到期日及未折現之到期金額（含本金及利息）彙總列示本公司已約定還款期間之金融負債分析：

	112年12月31日					合計
	短於 1 年	2 至 3 年	4 至 5 年	5 年 以上		
<b>非衍生金融負債</b>						
應付帳款	\$ 155,227	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155,227	
應付工程及設備款	217,275	-	-	-	217,275	
應付費用及其他流動負債	403,513	-	-	-	403,513	
租賃負債	<u>43,206</u>	<u>84,463</u>	<u>53,418</u>	<u>43,414</u>	<u>224,501</u>	
	<u>819,221</u>	<u>84,463</u>	<u>53,418</u>	<u>43,414</u>	<u>1,000,516</u>	
<b>衍生金融負債(資產)</b>						
遠期外匯合約						
流出	1,166,234	-	-	-	1,166,234	
流入	( <u>1,187,166</u> )	-	-	-	( <u>1,187,166</u> )	
	( <u>20,932</u> )	-	-	-	( <u>20,932</u> )	
	<u>\$ 798,289</u>	<u>\$ 84,463</u>	<u>\$ 53,418</u>	<u>\$ 43,414</u>	<u>\$ 979,584</u>	

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	短於 1 年	1 ~ 5 年	5 ~ 10 年	10 年 以上
租賃負債	<u>\$ 43,206</u>	<u>\$ 137,881</u>	<u>\$ 43,414</u>	<u>\$ -</u>

	111年12月31日					合計
	短於 1 年	2 至 3 年	4 至 5 年	5 年 以上		
<b>非衍生金融負債</b>						
應付帳款	\$ 173,781	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173,781	
應付工程及設備款	21,004	-	-	-	21,004	
應付費用及其他流動負債	423,586	-	-	-	423,586	
租賃負債	<u>36,950</u>	<u>68,840</u>	<u>59,302</u>	<u>61,122</u>	<u>226,214</u>	
	<u>655,321</u>	<u>68,840</u>	<u>59,302</u>	<u>61,122</u>	<u>844,585</u>	
<b>衍生金融負債(資產)</b>						
遠期外匯合約						
流出	1,414,948	-	-	-	1,414,948	
流入	( <u>1,414,325</u> )	-	-	-	( <u>1,414,325</u> )	
	<u>623</u>	-	-	-	<u>623</u>	
	<u>\$ 655,944</u>	<u>\$ 68,840</u>	<u>\$ 59,302</u>	<u>\$ 61,122</u>	<u>\$ 845,208</u>	

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	短於 1 年	1 ~ 5 年	5 ~ 10 年	10 年 以上
租賃負債	<u>\$ 36,950</u>	<u>\$ 128,142</u>	<u>\$ 61,122</u>	<u>\$ -</u>

## (六) 金融工具之公允價值

### 1. 按攤銷後成本衡量金融工具之公允價值

本公司按攤銷後成本衡量之金融資產及金融負債於財務報表中之帳面金額趨近公允價值。

### 2. 認列於資產負債表之公允價值衡量

本公司以公允價值衡量之金融資產及金融負債，其衡量方式依照相關輸入值之可觀察程度及重要性分為第 1 等級至第 3 等級：

(1) 第 1 等級輸入值：係指於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價（未經調整）。

(2) 第 2 等級輸入值：係指除第 1 等級之報價外，資產或負債直接（亦即價格）或間接（亦即由價格推導而得）之可觀察輸入值。

(3) 第 3 等級輸入值：係指資產或負債之不可觀察之輸入值。

### 3. 公允價值資訊－以重複性基礎按公允價值衡量之金融工具

#### 公允價值衡量層級

本公司以重複性基礎按公允價值衡量之金融資產及金融負債，其公允價值層級如下：

	112年12月31日			
	第 1 等級	第 2 等級	第 3 等級	合 計
<u>透過損益按公允價值衡量</u>				
<u>之金融資產</u>				
衍生金融工具	\$ _____	\$ 20,932	\$ _____	\$ 20,932

<u>透過損益按公允價值衡量</u>				
<u>之金融負債</u>				
衍生金融工具	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____

	111年12月31日			
	第 1 等級	第 2 等級	第 3 等級	合 計
<u>透過損益按公允價值衡量</u>				
<u>之金融資產</u>				
衍生金融工具	\$ _____	\$ 4,551	\$ _____	\$ 4,551

<u>透過損益按公允價值衡量</u>				
<u>之金融負債</u>				
衍生金融工具	\$ _____	\$ 5,174	\$ _____	\$ 5,174

本公司於 112 及 111 年度均未有第 1 等級與第 2 等級公允價值衡量間移轉之情形。

本公司於 112 及 111 年度均未有取得或處分以第 3 等級公允價值衡量之金融資產等情形。

#### 衡量公允價值所採用之評價技術及假設

本公司金融資產及金融負債之公允價值之決定，係使用下列方法及假設為之：

- (1) 遠期外匯合約公允價值係以遠期匯率報價及相對應之殖利率曲線衡量。

### 二九、關係人交易

除已於其他財務報表附註揭露者外，本公司與關係人間之交易明細揭露如下。

#### (一) 關係人名稱及其關係

<u>關 係 人 名 稱</u>	<u>與 本 公 司 之 關 係</u>
台灣積體電路製造股份有限公司 (台積公司)	具重大影響之投資者
采鈺科技股份有限公司(采鈺公司)	其他關係人

#### (二) 營業收入

<u>關 係 人 名 稱</u>	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
台積公司	<u>\$ 5,076,877</u>	<u>\$ 5,772,030</u>

本公司與關係人之銷貨交易，其交易價格與收款條件與非關係人並無重大差異。

#### (三) 製造費用

<u>關 係 人 名 稱</u>	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
采鈺公司	<u>\$642,664</u>	<u>\$791,322</u>

本公司委託關係人之加工費用，係依據雙方議定之條件為之。

#### (四) 租金收入

<u>關 係 人 名 稱</u>	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
采鈺公司	<u>\$ 81,528</u>	<u>\$ 79,604</u>

本公司出租不動產、廠房及設備予關係人，租約內容係由租賃雙方協議決定，租金按月收取，相關之租金收入帳列其他收益及費損項下。

(五) 合約資產

關係人名稱	112年12月31日	111年12月31日
台積公司	<u>\$136,662</u>	<u>\$ 99,763</u>

112 及 111 年度因關係人產生之合約資產並未提列備抵損失。

(六) 應收關係人款項（不含合約資產）

關係人名稱	112年12月31日	111年12月31日
台積公司	<u>\$ 1,020,153</u>	<u>\$ 1,047,375</u>

流通在外之應收關係人款項未收取保證。112 及 111 年度應收關係人款項並未提列備抵損失。

(七) 其他流動資產

關係人名稱	112年12月31日	111年12月31日
采鈺公司	<u>\$ 73</u>	<u>\$ 77</u>

(八) 應付費用及其他流動負債

關係人名稱	112年12月31日	111年12月31日
采鈺公司	<u>\$107,339</u>	<u>\$110,549</u>

本公司與關係人交易，若無相關同類交易可循，其交易條件係由雙方協商決定。

(九) 主要管理階層薪酬

本公司 112 及 111 年度對董事及其他主要管理階層成員之薪酬總額如下：

	112年度	111年度
短期員工福利	<u>\$ 45,223</u>	<u>\$ 56,475</u>
退職後福利	<u>660</u>	<u>665</u>
	<u>\$ 45,883</u>	<u>\$ 57,140</u>

董事及其他主要管理階層之薪酬係由薪酬委員會依照個人績效及市場趨勢決定。

### 三十、重大或有負債及未認列之合約承諾

除已於其他附註揭露者外，本公司於資產負債表日尚有下列重大或有負債及未認列之合約承諾：

(一) 本公司承諾購置之不動產、廠房及設備合約總價約為 1,284,568 仟元。

### 三一、具重大影響之外幣資產及負債資訊

本公司具重大影響之外幣金融資產及負債資訊如下：

單位：各外幣仟元

	外	幣	匯率 (註)	帳面金額
<u>112年12月31日</u>				
<u>外幣資產</u>				
貨幣性項目				
美金	\$	60,302	30.747	\$ 1,854,115
日幣		64,545	0.2172	14,019
瑞士法郎		99	36.49	3,611
歐元		3	33.98	106
<u>外幣負債</u>				
貨幣性項目				
美金		6,837	30.747	210,226
日幣		64,569	0.2172	14,024
瑞士法郎		99	36.49	3,611
歐元		3	33.98	105
<u>111年12月31日</u>				
<u>外幣資產</u>				
貨幣性項目				
美金		58,361	30.713	1,792,432
日幣		34,271	0.2324	7,964
瑞士法郎		90	33.21	2,985
歐元		41	32.72	1,343
<u>外幣負債</u>				
貨幣性項目				
美金		4,843	30.713	148,754
日幣		35,461	0.2324	8,241
瑞士法郎		90	33.21	2,985
歐元		41	32.72	1,343

註：匯率係每單位外幣兌換為新台幣之金額。

本公司於 112 及 111 年已實現及未實現外幣兌換損益合計數請詳綜合損益表，由於外幣交易之功能性貨幣種類繁多，故無法按各重大影響之外幣分別揭露兌換損益。

### 三二、營運部門資訊

#### (一) 營運部門資訊

經依據主要營運決策者定期覆核用以分配資源及績效衡量之營運結果，本公司係屬單一營運部門。營運部門損益、資產及負債之衡量基礎與財務報表編製基礎相同，相關營運部門資訊請參閱前述之財務報表，收入細分資訊請參閱附註十八「營業收入」。

#### (二) 重要客戶資訊如下：

佔本公司營業收入淨額百分之十以上之客戶明細如下：

客 戶	112年度		111年度	
	金 額	所佔比例 (%)	金 額	所佔比例 (%)
甲 公 司	\$ 5,076,877	79	\$ 5,772,030	75
乙 公 司	958,343	15	1,346,116	17

### 三三、附註揭露事項

#### (一) 重大交易事項：

1. 資金貸與他人：無。
2. 為他人背書保證：無。
3. 期末持有有價證券情形：無。
4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣 3 億元或實收資本額 20% 以上：無。
5. 取得不動產之金額達新台幣 3 億元或實收資本額 20% 以上：無。
6. 處分不動產之金額達新台幣 3 億元或實收資本額 20% 以上：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣 1 億元或實收資本額 20% 以上：

單位：新台幣仟元

進(銷)貨之公司	交易對象	關係	交 易 情 形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨金額	佔總進(銷)之比率	授信期間	單 價	投 信 期 間	餘 額	佔總應收(付)票據、帳款之比率		
本公司	台積公司	對本公司採權益法評價之投資公司	銷 貨	\$5,076,877	79%	月結 60 天	參閱附註二九	參閱附註二九	\$1,020,153	85%	-

8. 應收關係人款項達新台幣 1 億元或實收資本額 20% 以上：

單位：新台幣仟元

帳列應收款項之公司	交易對象	關係	應收關係人款項餘額	週轉天數	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵呆帳金額
					金額	處理方式		
本公司	台積公司	對本公司採權益法評價之投資公司	\$ 1,020,153	74	\$ -	-	\$ 507,223	\$ -

9. 從事衍生性金融商品交易：請詳附註七。

(二) 轉投資事業相關資訊：無。

(三) 大陸投資資訊：無。

(四) 主要股東資訊：

1. 股權比例達 5% 以上之股東名稱、持股數額及比例：

主要股東名稱	股份	
	持有股數	持股比例
台積公司	11,281,925	41%

註 1：本表主要股東資訊係由集保公司以當季季底最後一個營業日，計算股東持有公司已完成無實體登錄交付（含庫藏股）之普通股及特別股合計達 5% 以上資料。本公司財務報告所記載股本與實際已完成無實體登錄交付股數，可能因編製計算基礎不同或有差異。

註 2：上開資料如屬股東將持股交付信託，係以受託人開立信託專戶之委託人個別分戶揭示。至於股東依據證券交易法令辦理持股超過 10% 之內部人股權申報，其持股包括本人持股加計其交付信託且對信託財產具有運用決定權股份等，有關內部人股權申報資料請參閱公開資訊觀測站。

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告：無。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，有無發生財務週轉困難情事，及其對本公司財務狀況之影響：無。

## 柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況：

國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

項目	112	111 年度	差異	
			金額	變動比率
流動資產	5,385,219	5,299,966	85,253	1.61
不動產、廠房及設備	4,341,020	3,853,333	487,687	12.66
無形資產	20,784	31,263	(10,479)	(33.52)
其他資產	254,142	287,224	(33,082)	(11.52)
資產總額	10,001,165	9,471,786	529,379	5.59
流動負債	1,469,496	1,535,022	(65,526)	(4.27)
非流動負債	577,522	546,587	30,935	5.66
負債總額	2,047,018	2,081,609	(34,591)	(1.66)
股本	2,713,643	2,713,643	-	-
資本公積	396,424	396,424	-	-
保留盈餘	4,844,080	4,280,110	563,970	13.18
其他權益	-	-	-	-
權益總額	7,954,147	7,390,177	563,970	7.63
重大變動項目說明(變動達 20%以上者)：				
1.無形資產減少主要係專利權減少 8,955 仟元。				

## 二、財務績效：

### 1.最近二年度經營結果分析

國際財務報導準則：

單位：新台幣仟元

項目	年度	112 年度	111 年度	增減金額	變動比例 (%)
營業收入淨額		6,386,868	7,731,797	(1,344,929)	(17.39)
營業成本		4,207,658	4,864,697	(657,039)	(13.51)
營業毛利		2,179,210	2,867,100	(687,890)	(23.99)
營業費用		541,708	510,485	31,223	6.12
其他營業收益及費損淨額		67,590	102,086	(34,496)	(33.79)
營業淨利		1,705,092	2,458,701	(753,609)	(30.65)
營業外收入及支出		45,410	42,297	3,113	7.36
稅前淨利		1,750,502	2,500,998	(750,496)	(30.01)
所得稅費用		374,728	517,262	(142,534)	(27.56)
稅後淨利		1,375,774	1,983,736	(607,962)	(30.65)
說明：(變動達 20%以上者)：					
1.營業毛利、營業淨利、稅前淨利、所得稅費用及稅後淨利減少，主要係營業收入減少，使獲利衰退所致。					
2.其他營業收益及費損淨額減少主要係處分不動產、廠房及設備淨益減少 28,198 仟元。					

### 2.預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務可能影響及因應計劃

本公司長期致力於開發新型態之各類感測器之晶圓級封裝及後護層技術，如106年導入智慧型行動裝置品牌市場，於109年量產12吋晶圓測試，為公司帶來新的營收主力及穩定成長。於112年也將導入12吋CIS特殊加工技術，預期113年將帶來新的營利項目。

未來本公司仍將積極與客戶策略合作，共同開發創新技術，拓展消費性產品，行動裝置，車用電子，工業及醫療市場應用。其中車用電子產品、工業及醫療產品具有高技術門檻、較長的產品生命週期及營收與毛利穩定等特性，本公司將持續擴大與客戶的合作項目。

### 三、現金流量：

#### (一) 最近一年度流動性分析

單位：新台幣仟元

項目	年度	112 年度	111 年度	增 ( 減 ) 金 額	變 動 比 例 ( % )
營業活動		1,887,859	3,006,449	(1,118,590)	(37.21)
投資活動		(821,412)	(753,991)	(67,421)	8.94
籌資活動		(856,632)	(854,589)	(2,043)	0.24
合 計		209,815	1,397,869	(1,188,054)	(84.99)
1. 本期營業活動之淨現金流入較上期減少，主要係本期稅前淨利減少 750,496 仟元及支付所得稅增加 302,883 仟元。 2. 本期投資活動之淨現金流出較上期增加，主要係資本支出增加 69,852 仟元。 3. 本期籌資活動之淨現金流出較上期增加，主要係租賃本金償還增加 2,365 仟元。					

#### (二) 流動性不足之改善計畫

本公司資金需求將以自有資金支應，尚無流動性不足之疑慮。

#### (三) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	預計全年來自 營業活動淨現 金流量(2)	預計全年現 金流出量(3)	預計現金 剩餘(不足) 之數額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	籌資計畫
3,719,965	1,525,469	(1,555,029)	3,690,405	—	銀行借款
1. 未來一年度現金流量變動情形分析： (1) 營業活動淨現金流入主要來自於營業收現。 (2) 現金流出主要係資本支出、發放現金股利並扣除舉借之長期借款。 2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：以銀行借款因應。					

#### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

112 年度資本支出主要係用於擴建新廠辦大樓、研發機台及 8 吋晶圓級封裝之廠務設施及機台，本公司係以自有資金支應，故對本公司之財務業務應無重大不利之影響。

#### 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

無。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施。

1.利率變動風險方面：

本公司之中期銀行借款利率係採浮動利率，利率變動將會影響未來現金流量，但不影響公允價值。本公司將持續關注利率變化，或向銀行承作利率交換交易，以規避利率波動之風險，降低融資成本之不確定性。

2.匯率變動風險方面：

本公司營運活動主要係以外幣進行交易，因此產生外幣匯率風險。為避免因匯率變動造成外幣資產價值下跌及未來現金流量之波動，本公司使用遠期外匯合約等衍生金融工具來規避匯率風險。此類衍生金融工具之使用，可協助本公司減少但仍無法完全排除外幣匯率變動所造成之影響。有關衍生性商品交易細節，請參考本年報第 128 頁。

3.通貨膨脹風險方面：

本公司除密切掌握原物料供需狀況，積極尋求兼具品質和價格競爭力的替代來源外，並致力於庫存管理、製程改良、良率改善及效率提升的成本縮減活動，以減少物價上漲的影響。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司最近年度並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及背書保證之情形。本公司所從事之衍生性商品交易主要為規避外幣資產及負債之匯率風險。為了控管財務交易風險，本公司已依據相關法令及規定，訂定了以健全財務及營運為基礎的內部管理辦法及作業程序。這些管理辦法包括「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」以及「取得或處分資產處理程序」(包括衍生性商品交易處理程序)。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

因應市場及客戶對感應器的需求，持續提供新一代改良矽穿孔封裝(TSV CSP)、三維晶片封裝技術(3D IC package)等晶圓級封裝技術在各式感測器元件的應用，並以創新之晶圓級封裝技術服務將產品線擴展至微機電(MEMS)、功率場效電晶體、電源控制及類比元件等產品，並將現行技術擴展到 12 吋產品線。113 年度預計投入之研發費用為新台幣 365,633 仟元。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司的經營團隊一直密切注意任何可能會影響公司業務及營運的政策與法令。112 年相關法令的變化對本公司的營運並無重大影響。

(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司的經營團隊一直密切注意任何科技改變及產業變化之相關訊息及趨勢，未來也積極投入研發以提昇競爭力；同時本公司亦會持續推動資通安全相關計畫，降低資通安全風險，以達持續營運之目標。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司參加櫃買中心舉辦之公司治理評鑑結果，105 年至 110 年均列於前 5%，111 年列於 6%~10%。112 年本公司榮獲桃園市金牌企業卓越獎、愛地球獎、性平獎、桃園市環境永續企業環保獎及桃園市企業河川認養優良獎。本公司中壢三廠則連續第 2 年榮獲國家企業環保銅級獎佳績，顯現本公司在公司治理、環境保護及企業永續等方面努力成果及重視。為有效管理企業形象，本公司重視災害發生時的緊急應變準備（例如：颱風、地震、環境污染、資訊系統服務中斷、罷工、原物料或水電氣公用設施短缺等天然或人為災難），並建立周全的應變計畫，包括在災難發生時成立專案應變小組的流程與步驟。本公司常設緊急應變中心，並 24 小時駐有值班人員，即時因應各種可能造成環境污染緊急事故，有利於在環境事故初期啟動應變機制、採取應變措施，抑制並防止故災害持續擴大，降低事故嚴重程度。另外，本公司訂有緊急應變管理程序，其中涵蓋空氣污染、氣體或化學物質洩漏等環境污染事件應變流程，並每年制訂緊急應變演練計畫，採用實兵推演方式由單位主管擔任指揮官執行緊急應變演練，透過實際演練強化應變小組應變量能。整合各廠區相關單位進行緊急應變定期演練並持續改善通報及運作程序，以確保危機處理時與利害關係人的溝通管道暢通，並統一由發言人對外代表發言。本公司截至年報刊印日止並無重大影響正常營運及企業形象的風險事項發生。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：請參閱本年報第 140 頁。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司儘可能向不同供應商採購原物料，以確保原物料供應無虞，並降低集中採購風險。雖然本公司仍有從單一供應商取得部份原物料之情形，但本公司仍將持續找尋其他購買方式以降低購買集中的風險。

112 年度最大客戶台積電集團佔本公司銷貨淨額為 79%，本公司未來將積極開發新市場及新客戶，並與原有客戶保持良好的合作關係，持續降低風險。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險及因應措施：

現有股東所持有本公司股票之價格可能會因大股東出售持股而受影響。台積公司仍是本公司最大股東，持有約 41% 股權。台積公司將持續在影像感測元件與微機電系統及晶圓測試等領域與本公司保持密切合作。

(十一) 經營權之改變對公司之影響及風險：無。

(十二) 訴訟或非訟事件：

1. 公司最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉案當事人及目前處理情形：

(1) 訴訟事件：無。

(2) 非訟或行政爭訟事件：無。

2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：

本公司董事台灣積體電路製造股份有限公司(以下簡稱台積公司)最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件如下：

如半導體產業其他多數公司常見的情形，台積公司不定期會接獲第三人的通知，主張台積公司的技術、製程或台積公司製造之半導體產品的設計或客戶之使用，有侵害他人專利或其他智慧財產權之虞。這些主張有時導致雙方間的訴訟(台積公司或為原告或為被告)及台積公司支付和解金。無論這些第三人主張是否於法有據，或多或少可能造成台積公司訴訟費用之負擔或可能對公司之營運造成不利之影響。此外，台積公司亦須遵守相關地區競爭法的規範並受到主管機關之監理，該等競爭法主管機關對台積公司發動之執法程序若其結果對台積公司不利，可能會損害台積公司之業務或影響台積公司之營運策略，從而對台積公司營運成果或展望造成負面影響，並使台積公司面臨潛在高度法律責任。

目前台積公司重大的法律事件如下：

Daedalus Prime LLC (Daedalus) 於 111 年 9 月，在美國國際貿易委員會 (ITC) 及美國東德州地方法院對台積公司、TSMC North America 及其他公司就四件美國專利提起專利權侵害調查及訴訟。ITC 於 111 年 10 月立案調查。Daedalus 於 112 年 6 月，在 ITC 撤銷其中兩件美國專利權侵害調查。同年 6 月並在美國東德州地方法院對台積公司就其它五件美國專利提起專利權侵害訴訟。ITC 於 9 月依雙方共同請求准許暫停 ITC 調查程序，雙方完成和解協議後將再申請終結 ITC 調查及其他訴訟案件。雙方於 10 月共同請求 ITC 終結專利權侵害調查，以及共同請求美國東德州地方法院撤銷相關訴訟。ITC 專利權侵害調查已於 11 月終結，美國東德州地方法院之相關訴訟亦已於同月撤銷。

除前述法律案件之外，截至年報刊印日止，並無其他台積公司為案件主體的重大法律案件。

上述董事-台積公司之訟訴事件係屬法人董事之商業行為所致，且與本公司並無關係，故對本公司股東權益或證券價格並無重大影響。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

## 捌、特別記載事項

- 一、關係企業相關資料：無。
- 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
- 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：不適用。
- 四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。
- 五、其他必要補充說明事項：無。

精材科技股份有限公司



負 責 人：陳 家 湘

